

業 務

概覽

我們是中國泛半導體行業智能製造軟件解決方案（「IMSS」）提供商。我們專注於為泛半導體行業的先進製造量身定制的IMSS的研發與商業化。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計算，我們在中國泛半導體IMSS市場排名第三，且我們是中國泛半導體IMSS市場第二大本土提供商，於2025年佔總市場份額約12%。中國泛半導體IMSS市場為中國IMSS市場的細分市場，按銷售收入計，於2025年約佔整體市場的4.4%。根據弗若斯特沙利文的資料，中國IMSS市場相對分散，於2025年，前五大參與者佔據25.8%的市場份額。於2025年，按IMSS收入計，我們在中國IMSS市場排名第16位，市場份額為0.5%。

我們設計並開發的IMSS與泛半導體行業的製造流程及工藝相整合，且可以應對泛半導體行業涉及眾多步驟與各類精密設備，要求實時協調、系統穩定、高精度的複雜製造流程。高精度通常要求達到亞微米級，重點在於極嚴格的公差控制、材料純度和結構穩定性。關鍵要素包括精確的運動控制、真空兼容性、熱穩定性，以及防止缺陷並確保高良率的高純度材料。因此，相關製造流程需要精密的軟件解決方案來管理其複雜的先進製造系統。我們的解決方案涵蓋從生產數據採集、設備連接、生產流程管理到大數據分析及人工智能應用的整個價值鏈，這使我們的泛半導體行業客戶能夠實現數字化製造，實現精確控制、提高良率、無縫數據流動和集成以及降低成本。

我們的IMSS能夠實現泛半導體行業多個細分領域製造設施的全自動化，涵蓋設備連接、整個製造過程的自動化及工廠層級的物流控制，以此優化生產流程，提高中央控制人員的執行效率及協助關鍵決策。自成立以來，我們戰略聚焦半導體行業，運用人工智能、物聯網、大數據分析及自動化等新技術，為客戶提供量身定制的IMSS。

我們向客戶銷售的產品為構成IMSS的軟件產品。視乎客戶的需求，我們透過提供可單獨購買或以跨不同平台的多種軟件產品組合形式購買的軟件產品，為客戶提供軟件解決方案。我們根據軟件產品的主要功能、技術及其不同客戶目標使用場景，將其歸類為五大平台。我們的五大平台即：(i)生產運營平台；(ii)集成自動化平台；(iii)智控數字平台；(iv)智能大數據引擎平台；及(v)數字化設備平台。

我們的生產運營平台及集成自動化平台包括構成CIM系統的軟件產品。通過使用物聯網、實時數據及優化算法，我們的CIM系統得以實現整個生產流程的自動化，並全面集成生產流程中的各種功能，包括物料控制、生產計劃及排程、物流管理、生產設備及生產線自動化到質量控制流程。

AI技術廣泛應用於我們智控數字平台的軟件產品中，遠程控制技術及深度學習模型的採用使設備能夠透過系統指令自主執行任務，從而大幅減少對現場人員監察或人工監督運作的需求。因此，該平台下的軟件產品旨在提高升級現有生產流程的效率。

業 務

我們的智能大數據引擎平台採用關鍵技術，包括統計及機器學習算法以及大數據分析。為針對性升級現有生產流程，我們的智能大數據引擎平台收集並分析來自我們生產運營平台及集成自動化平台的數據，以優化生產良率及質量控制，實現實時故障檢測，並協助預測設備故障。

我們的數字化設備平台採用模塊系統，實現設備數據轉換的內部控制，從而實現生產流程中的設備生產控制自動化，並與我們的CIM系統實現集成及互通。

自我們於2007年成立以來，我們的創始人孫先生把握半導體行業的發展機遇，帶領我們成為擁有自主研發的CIM系統的IMSS提供商。於2010年，我們首次上線了8寸半導體製造執行系統。於2023年初，我們成功交付了12寸前道18納米工藝含核心製造執行系統的國產CIM系統。我們實現了12寸CIM整合交付的技術突破，消除了關鍵供應鏈依賴性，並透過高自動化執行率優化製造流程，在多座頂尖晶圓廠中，展現出經實證的可擴展性。

近年來，我們藉助人工智能的發展，不斷優化和提升IMSS。憑藉在泛半導體行業的研究和專業知識，我們推出了面向泛半導體行業各類製造場景的人工智能賦能IMSS。我們的人工智能模型持續從生產及運營數據中學習，實現自感知、自學習、輔助決策，幫助產線提升產能和品質，同時降低損耗成本。通過融合計算機視覺和深度學習技術，我們提供控制解決方案，利用對系統某一部分的反饋，不斷改進和優化另一部分，形成實時數據集成與糾正措施的循環，從而提升工廠效率。

我們在IMSS市場的豐富經驗已為我們贏得許多獎項及榮譽，且我們為整個泛半導體行業的多元化客戶群提供服務。於往績記錄期間各年度，我們分別與採購我們的IMSS產品的134家、147家及198家客戶建立了業務關係。此外，我們還與泛半導體行業的領先及中小型製造企業維持業務關係。於往績記錄期間各年度，我們來自五大客戶的收入分別為人民幣89.7百萬元、人民幣116.2百萬元及人民幣69.4百萬元，分別佔我們各相應年度收入的54.2%、46.7%及23.1%。

於往績記錄期間，我們絕大部分收入來自IMSS，其次是維護服務。我們的收入由2023年的人民幣165.5百萬元增加至2024年的人民幣248.9百萬元，並進一步增加至2025年的人民幣300.3百萬元，其中，來自IMSS的收入分別佔各相應年度總收入的99.0%、99.1%及99.3%。我們的CIM系統下的軟件解決方案分別在2023年、2024年以及2025年佔我們總收入的82.7%、78.5%及71.6%。我們已證明了我們成功商業化解決方案及服務的能力。

我們為一家上市規則第十八C章先進製造子類別所界定的已商業化公司。我們的五大平台的IMSS利用了物聯網、統計及機器學習算法、大數據分析、深度學習模型及遠程控制技術等技術，使泛半導體行業的客戶能夠實現數字化製造。

業 務

我們開發的五大平台中的IMSS涵蓋了先進製造的所有主要特徵（即自動化、計算、軟件、傳感及／或網絡）。有關我們的解決方案如何屬於上市規則第十八C章所界定的特專科技行業的可接納領域的更多資料，請參閱「業務 — 上市規則第十八C章項下的特專科技產品」。

我們的市場機會

中國IMSS市場按銷售收入計由2021年的人民幣403億元增加至2025年的人民幣555億元，複合年增長率為8.4%，並預期將於2030年達到人民幣934億元，複合年增長率為12.0%。在中國IMSS市場中，中國泛半導體IMSS市場於2021年為人民幣13億元，之後增加至2025年的人民幣25億元，複合年增長率為17.2%。預期該市場到2030年將達到人民幣72億元，反映2026年至2030年期間的複合年增長率為25.0%。

泛半導體行業作為技術進步的主要驅動力增長迅速，為我們創造重大發展機遇。從行業前景看，當中的半導體、顯示面板、PCB和光伏等行業擁有廣闊的市場機會。中國的半導體市場由2021年的人民幣13,480億元增加至2025年的人民幣18,740億元，複合年增長率為8.6%，並預計在2030年達到人民幣36,330億元，複合年增長率為12.9%。中國顯示面板行業的市場規模經歷了顯著增長，由2021年的人民幣0.6萬億元增加至2025年的人民幣1.4萬億元，複合年增長率為24.2%，2030年將達到人民幣5.4萬億元，複合年增長率為32.0%。中國的PCB行業產值由2021年的人民幣373億元達到2025年的人民幣536億元，複合年增長率為9.5%。預計2030年將達到人民幣744億元，複合年增長率為6.0%。在光伏行業，中國的累計光伏裝機容量已由2021年的321.7 GW大幅增至2025年的1,200.0 GW，複合年增長率為39.0%，並將於2030年達到7,862.4 GW，複合年增長率為49.8%。

數據驅動的人工智能大模型將更廣泛和深入地應用到泛半導體行業的製造相關的IMSS中。國內製造商在產品穩定性和技術綜合性方面不斷取得突破，抓住自研及穩定性的必然趨勢。為應對市場需求，行業正在從傳統生產向應用人工智能生產的整體解決方案過渡，中國製造商加快走出去的步伐，不斷開拓新興市場。中國泛半導體IMSS市場規模由2021年的人民幣13億元增至2025年的人民幣25億元，複合年增長率為17.2%。預計到2030年，市場規模將增至人民幣72億元，反映了於2026年至2030年複合年增長率為25.0%。我們將把握此發展趨勢，快速響應客戶需求，深耕各類應用場景，從而把握泛半導體行業變革帶來的顯著增長潛力。

我們的優勢

為泛半導體行業提供國產自研IMSS的提供商，涵蓋開發軟件應用程序的整套技術及層面

我們是中國泛半導體行業IMSS提供商。中國泛半導體IMSS市場為中國IMSS市場的細分市場，按銷售收入計，於2025年約佔整體市場的4.4%。於2025年，按IMSS收入計，我們在中國IMSS市場排名第16位，市場份額為0.5%。我們專注於為泛半導體行業的先進製造而量身定制的IMSS的研發與商業化。我們的IMSS用途廣泛，適用於各種場景，其收入於往績記錄期間佔我們總收入的相當大一部分。於2023年、2024

業 務

年及2025年，我們分別錄得IMSS收入為人民幣163.8百萬元、人民幣246.6百萬元及人民幣298.2百萬元，分別佔我們於各相應年度總收入的99.0%、99.1%及99.3%。根據弗若斯特沙利文報告，於2025年，按泛半導體IMSS產生的收入計，我們在中國泛半導體IMSS市場排名第三，且在中國市場的國內泛半導體IMSS提供商中排名第二，於2025年佔總市場份額約12%。中國泛半導體IMSS市場為中國IMSS市場的細分市場，按銷售收入計，於2025年約佔整體市場的4.4%。於2025年，按IMSS收入計，我們在中國IMSS市場排名第16位，市場份額為0.5%。

近年來，中國IMSS市場成長迅速，全球及東南亞泛半導體IMSS市場保持強勁且前景看好。根據弗若斯特沙利文報告，中國IMSS市場於2021年至2025年的複合年增長率為8.4%，並預計2026年至2030年的複合年增長率為12.0%。中國泛半導體IMSS的市場規模有所增加，2021年至2025年的複合年增長率為17.2%，預計2026年至2030年的複合年增長率為25.0%，顯著高於歷史增長率。全球泛半導體IMSS市場規模有所增加，2021年至2025年的複合年增長率為11.2%，預計2026年至2030年的複合年增長率為21.0%。東南亞泛半導體IMSS市場規模有所增加，2021年至2025年的複合年增長率為15.1%，預計2026年至2030年的複合年增長率為26.1%。

我們相信我們在IMSS技術方面的專業知識使我們能夠提供涵蓋整個價值鏈的整合人工智能、大數據、行業知識和自動化的服務。我們是國內僅有的三家能夠提供涵蓋開發軟件應用程序的全套技術及層級（包括跨整個泛半導體行業價值鏈的前端（用戶界面）及後端（服務器、數據庫及應用邏輯）組件）的IMSS提供商之一，根據弗若斯特沙利文報告，這意味著產品或系統的所有組件及層級均為內部開發。與從外部購買的獨立軟件模塊相比，內部自研解決方案具備控制整個技術棧的優勢，能夠實現所有組件的無縫整合和優化。從外部購買的模塊相比之下可能缺乏模塊之間的整合和連貫性。內部自研的解決方案還能實現更多功能，例如內部設備決策和人工智能仿真，而不僅僅是生產計劃和自動化。憑藉我們對市場機會的洞察力、解決方案開發技術以及管理層的前瞻性戰略眼光，於往績記錄期間各年度，我們已為採購我們的IMSS產品的134家、147家及198家客戶提供服務。我們的研發能力，加上我們IMSS的穩定性及可靠性以及我們對於提供卓越用戶體驗的承諾幫我們贏得了廣泛的客戶群體。我們的業務範圍已從半導體行業延伸至顯示面板、PCB及光伏領域。我們致力於不斷開發及提供基於特定、真實世界場景及／或用例設計及開發的IMSS。隨著我們的解決方案在商業應用中不斷獲得青睞，我們的收入已從2023年的人民幣165.5百萬元迅速增長至2024年的人民幣248.9百萬元，並進一步增長至2025年的人民幣300.3百萬元。

我們的IMSS矩陣旨在涵蓋所有生產階段，提供多維應用場景。在泛半導體企業數字化藍圖中，我們的解決方案涵蓋設備層、控制層、營運管理層、數據儲存與分析層及決策層，提供覆蓋製造管理整個生命週期的支持。

通過內部研發實現技術創新和突破

我們已建立IMSS的自主研發，專注於技術的不斷迭代與創新，提升核心競爭力。自成立以來，我們始終致力於創新，我們的業務里程碑包括交付多個行業領先的項目。

業 務

在本公司開發的IMSS中，我們已開發出一系列軟件解決方案，主要產品包括MESwell®、EAPwell®及BC（區塊控制），助力我們提升了市場競爭力。MESwell®自2007年起經持續研發，作為連接企業規劃層和生產設備層的關鍵紐帶，通過實時監控、數據採集及過程控制，實現對涵蓋生產初始階段至最終產出的製造過程的綜合數字化管理。自2008年推出以來，MESwell®積累了無數成功經驗，涉及的領域橫跨半導體、顯示面板及相關先進製造領域。我們在全自動12寸晶圓廠解決方案方面展現出特別的專業知識，展示了高效的項目執行及成功的系統驗證。EAP作為上游系統與生產設備交互的關鍵橋樑，結合了在低代碼平台上開發的多個子系統模塊。我們的EAPwell®於2012年推出，共進行了9個主要版本升級，是一個旨在通過直接與設備連接來加強生產過程管理的系統。該系統有利於實時監控生產狀態、收集設備數據及就設備異常發出警報。EAPwell®及BC已經在客戶的半導體顯示面板及PCB行業多樣化的項目中廣泛測試和實施，支持多種通信協議和運營協作模式。

中國泛半導體IMSS市場一直由外資服務提供商主導。自成立以來，我們已發掘市場機遇，開發適合本地客戶需求並為其量身定制的國產軟件產品。憑藉我們於2020年交付首個顯示面板前道CIM系統國產替代的經驗，我們預期半導體行業亦將出現類似的趨勢及市場機遇。依託我們於顯示面板行業開發全自動化CIM系統所積累的經驗，我們於2021年承接一個半導體項目，為12寸前道18納米製程提供具備核心MES的全自動化CIM系統國產替代方案，該項目已於2023年初成功交付。

根據弗若斯特沙利文的資料，12寸前道CIM系統作為全自動化、高精度的工廠「大腦」，具備100%全自動化、毫秒級高頻數據採集及多層架構等特點，以處理複雜的納米級製程。其透過管理1,000至1,500個納米級製程步驟及逾300種設備類型處理極高的複雜性，從而支持全無人化的「黑燈」工廠。12寸前道CIM系統具備卓越的超高頻、全參數數據接入能力（以100毫秒間隔處理TB級的每日數據），以保證實現納米級的缺陷追溯及99.9%以上的目標良率。12寸前道CIM系統的技術門檻極高，要求通過SEMI國際標準認證，並須與全球領先半導體製造設備供應商的頂尖國際設備兼容。

需要12寸前道CIM系統的客戶及潛在客戶均為高度資本密集型的高科技半導體製造商（例如先進邏輯及存儲晶圓製造商），其採用納米級製程進行運作，或要求生產過程全面可追溯，任何人為錯誤或者效率或良率的輕微下降均會導致重大損失。

此外，我們憑藉技術創新、廣泛的應用場景、優化的用戶體驗、系統整合能力和研發實力，成為國內首家在高級仿真領域成功佈局的企業。我們的製程仿真技術主要應用於智能製造與工業設計，提供高精度虛擬仿真環境，協助產品設計與製程優化。例如，我們於2024年12月推出的仿真平台取得了重大突破。該平台下的兩個旗艦系統模塊electron track及beam sculpt產品已整合至最新國產可變形電子束光刻系統中，實現了sub-1nm的光刻精準度，這對於填補國內電子束光刻仿真和校正市場的空白具有里程碑意義。

業 務

我們通過內部研發以及與知名外部資源的合作實現了上述成就。在我們的董事長兼創始人孫先生的指導下，截至2025年12月31日，我們的研發團隊由148名成員組成，其中18.9%的研發團隊成員擁有碩士或以上學位。我們的研發總監／首席技術官王先生擁有超20年的深厚行業專業知識，引領我們的創新工作。此外，我們還與國內多所知名大學和頂尖科研院所建立了合作研發關係。詳情請參閱「－研發－研發能力及中心」一節。

截至最後實際可行日期，我們於中國取得38項專利、18項商標及173項軟件著作權，並已申請11項海外專利。我們的專利組合涵蓋核心技術領域，以半導體為中心，延伸至顯示面板、PCB及光伏等應用領域，形成了覆蓋整個價值鏈的業務網絡。

通過創新和迭代研發，我們整合IMSS，解決了關鍵技術難題，填補了國內長期以來的技術空白。通過建立知識產權基礎，我們鞏固了在智能製造領域的地位，力求交付的解決方案能使我們的客戶實現卓越營運，並使軟件解決方案在國內及全球市場上保持競爭優勢。

戰略性客戶關係和穩固的客戶基礎

憑藉超過18年的深厚行業經驗，我們與泛半導體行業的領先及中小型製造企業維持業務關係。於往績記錄期間各年度，我們分別與採購我們的IMSS產品的134家、147家及198家客戶建立了業務關係。

我們相信我們的核心競爭優勢在於能夠識別客戶痛點，並將我們的工業軟件解決方案與特定的應用場景無縫結合，從而提高不同客戶的生產效率。除了技術研發，我們還強調對市場趨勢的分析、對未來發展的預見以及對客戶需求的高度敏銳。我們認為，這些因素促使我們不斷優化解決方案，擴大產品供應，並加速更廣泛範圍內IMSS的商業化。

自創立以來，我們一直提供綜合服務，涵蓋從生產初期到最終產出的各階段，包括售前諮詢、解決方案設計和售後服務支援，力求確保從技術採用到實際應用的無縫整合。我們建立了高效率的客戶反饋和問題解決機制，能夠快速回應客戶需求，並提高客戶滿意度。此外，我們還提供詳細的技術培訓和操作指導，使客戶能夠最大限度地發揮我們產品的價值。

我們的IMSS屬高度定制化性質，並與客戶現有的系統深度整合，因此會造成客戶考慮和選擇其他供應商產生重大轉換成本，因為改用新供應商需要大量的時間和資源。此外，客戶在使用我們的產品時可能累積了數據和營運專業知識，遷移到另一家供應商可能涉及複雜的數據傳輸過程，並且需要重新學習新系統。

業 務

我們的產品矩陣涵蓋開發軟件應程序的全套技術及層級（包括前端（用戶界面）及後端（服務器、數據庫及應用邏輯）組件），可滿足我們客戶營運每個階段的需求。通過高度整合的技術和監控流程，利用對系統某一部分的反饋，不斷改進和優化另一部分，形成實時數據集成和糾正措施的循環，我們可以快速發現並解決生產問題，為客戶提升良率、降低成本及人力需求，以增強市場競爭力。

此外，我們與上下游企業、研究機構建立了廣泛的合作關係，增強了我們作為客戶長期合作夥伴的吸引力。我們積極參與行業標準制定，在技術規範的制定上佔據主導地位，保持了市場競爭優勢，進一步增強了與客戶的關係。

以AI為導向的LOFA產品群，提升生產效率

隨著人工智能、大數據及自動化技術的進步，人與智能硬件之間的觸控互動變得越來越重要。我們已推出我們的人工智能產品LOFA，這是一款專為工業4.0製造業設計的智控數字平台產品。依托我們在半導體、面板行業的豐富經驗，LOFA整合了遠端集中控制、人工智能、工業視覺等技術，可實現缺陷位置的精準識別，並通過遠程控制管理進行遠端自動化修復操作。

我們的LOFA部署使製造商能夠實現生產流程的實時優化，減少對人工干預的依賴並最大限度地減少停機時間。LOFA的解決方案利用人工智能技術，例如文字辨識、物體偵測、影像分類和模板匹配等，來執行自動缺陷分類、缺陷位置偵測和界面字符辨識等關鍵任務。通過集中控制和利用人工智能驅動的洞察力，LOFA提高了良率、改善了產品品質並提高了成本效益。通過智能機器人流程自動化技術，LOFA實現了缺陷檢測和修復的高水準、精準、無人化的實時自動化流程，徹底改變了營運效率。

我們的LOFA產品體現了「一座工廠，一套系統」的願景。通過整合LOFA應用模塊、商業智能及知識管理，LOFA成為工廠的智能中控AI大腦，並輔以大規模模型元件，實現角色專屬能力。LOFA可以替代或協助不同角色的人員，顯著提高工廠決策效率和勞動生產力。LOFA開發的黑燈工廠模式可從根本上改變工廠的運營。其將生產人員需要在現場工作的傳統場景轉變為一個集中式遙控中心，在該中心內，將需要操作的設備界面遠程集中，將重複性工作自動化。通過由人工智能驅動的智能助理提供支持，LOFA能夠快速部署大屏幕監控、自動化營運、影像偵測、大數據分析、智能反向控制等多種功能，並可根據特定的業務需求定制解決方案。

我們憑藉研發和創新能力，有別於傳統的工業軟件供應商。根據弗若斯特沙利文報告，我們已成為知名的以AI為導向的IMSS提供商。我們將人工智能技術與實際工業應用相結合的能力使我們處於智能製造革命的前沿。

業 務

經驗豐富且對行業有深入了解的管理團隊

我們由一支經驗豐富的管理團隊率領，彼等致力於推動突破，鞏固我們在先進製造領域的競爭力。我們的管理團隊由董事長兼創始人孫先生領導。自2007年成立本公司以來，孫先生始終主持著本公司整體運營與發展方向，其一直專注於大數據分析、人工智能技術發展及泛半導體解決方案的發展方向，帶領團隊實現了面板行業全系列大數據及數據應用產品的整合。彼曾參與開發本集團多項核心技術專利及建立我們的智能大數據引擎平台。多年來，孫先生在通過計算機集成製造(CIM)系統與人工智能(AI)應用進行生產管理及質量改善方面積累了經驗，從而奠定了本集團CIM+AI的核心競爭力。孫先生憑藉著其對半導體生產流程的專業理解及其項目管理及軟件開發流程管理能力，帶領團隊實現多項關鍵技術突破。有關孫先生及我們其他董事及高級管理層成員的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層」。

我們管理團隊的遠見卓識和卓越的執行力使我們能夠吸引和聚集頂級人才。這些專業人員擁有行業專業知識，不斷推動我們在技術前沿的進步。他們的貢獻對於鞏固我們的競爭力至關重要。該團隊大部分成員於軟件、技術及半導體行業擁有超過15年的經驗，可將技術創新、產品開發和商業部署無縫整合。在創始人和管理團隊的帶領下，我們突破了技術壁壘，在半導體製造的多個關鍵階段取得了歷史性的里程碑。

我們的管理團隊擁有領導力、專業知識以及對行業趨勢的敏銳洞察，為實現我們的使命、戰略目標和業務目標提供了明確的方向和支持。他們在推動技術創新、創造商業價值、推動行業發展等方面做出的貢獻，贏得了我們所處行業的認可和讚譽。我們堅信，我們的管理團隊將持續帶領本集團在IMSS領域開拓新邊界，為股東和利益相關者創造可持續的長期價值。

我們的策略

我們的使命是幫助企業建立和提升其生產優勢，故我們打算實施以下成長策略：

使用12寸MES解決方案+AI的CIM開發，加強以客戶為導向的市場影響力

我們旨在通過專注於以客戶為導向的解決方案來增強我們的市場影響力。我們將加強業務拓展力度，鞏固我們在智能製造領域的地位，利用現有產品組合的競爭優勢，為客戶提供精準定制化的解決方案。認識到客戶不同的發展階段和獨特的工廠特點，我們將專注於持續的產品迭代和服務提升，以提供符合其不斷演變的需求的解決方案。鑒於半導體行業對生產管理有著嚴格而細緻的要求，量身定制的解決方案至關重要，且有關方案必須與不同半導體細分領域的具體特性相契合。我們相信，通過開發滿足客戶確切需求的產品及建立長期合作關係，我們預期可提升客戶滿意度並建立強大的市場地位，促進重複購買的循環，加深客戶信任並確保長期合作。

業 務

作為為客戶提供定制化解決方案策略的核心，我們旨在進一步提升CIM能力，包括開發及增強整合人工智能技術的12寸MES解決方案。透過將我們在CIM系統交付方面的經驗與人工智能驅動的功能相結合，我們旨在提供高度適應性、數據驅動及高效生產管理系統，以滿足半導體製造嚴格及複雜的要求。

我們計劃應用[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元(相當於約[編纂]%)，以提升我們的CIM產品能力及解決方案，旨在打造適用於國內外客戶的國產12寸前道CIM系統，並確保我們的CIM系統穩定運行及廣泛採用。

為圍繞核心產品實施經營策略，我們將加強市場推廣力度，通過加強網絡營銷力度吸引新客戶並獲得更多項目，從而提高品牌知名度和客戶獲取率，以及深化行業內的戰略合作夥伴關係，提高我們的市場滲透率。

針對我們的戰略合作夥伴計劃，我們將通過與行業價值鏈的上下游參與者建立及培養合作夥伴關係，積極尋求以我們的核心產品為中心的合作機會。通過該等合作，我們的目標是整合互補的行業資源、擴大我們的產品供應及擴大我們的潛在客戶基礎。此外，我們將培育與設備製造商、軟件供應商及研究機構的共同開發模式，共同開發滿足新興市場需求的創新解決方案。該等舉措將提升我們的技術能力、推動規模經濟並增強我們於泛半導體及相關領域的競爭力。

通過戰略性地專注於我們的核心產品，加上市場擴張和戰略合作，我們旨在推動可持續增長，擴大我們的影響力，並鞏固我們作為智能製造業值得信賴的合作夥伴的地位。我們相信此多方位策略將使我們能夠利用市場機會、加強客戶關係並在快速發展的技術環境中取得可持續發展。

推進及加速我們解決方案及服務中人工智能驅動的開發

我們的目標是制定全面的AI驅動的發展戰略，以推進我們的產品及解決方案產品，將人工智能技術深度整合到我們的現有平台及軟件解決方案中。這需要與行業顧問及客戶合作，以設計、開發及實施針對半導體行業特定特徵的人工智能解決方案，解決生產系統效率低下的問題，同時建立人工智能專業知識以支持該等解決方案的持續改進。

我們人工智能業務發展的戰略願景是利用人工智能和設備控制技術作為核心驅動，整合我們的軟件解決方案套件。該戰略的核心是開發人工智能驅動的智能制造系統，我們的LOFA平台被定位為全廠數據收集、整合和傳輸的中心樞紐。通過與工廠內的自動化物流控制系統及其他生產平台連接，LOFA將可實現不同系統之間的連接，構建統一的智能制造平台。為了實現這一願景，我們計劃進一步通過我們的LOFA產品增強對所有生產階段的人工智能賦能，將它們轉變為能夠自主運作、進行實時數據分析、異常檢測和智能決策的智能型設備。這將促進跨設備數據互通性和協作操作，創建一個設備通訊和協同運行的環境。通過建立這些相互關聯，我們的目標是建立一個以自動化和智能控制為特徵，涵蓋從生產初期到最終產出的各階段的全廠智能制造環境。

業 務

我們計劃將[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元（相當於約[編纂]%）用於建立我們在泛半導體行業人工智能應用的能力，專注於我們的LOFA AI產品。

此外，我們將通過在數字化設備平台以及機械與自動化物料搬運系統領域推進AI驅動的高端製程設計與仿真技術研發，擴展我們的應用場景矩陣。我們此舉旨在建構涵蓋半導體行業價值鏈各個階段（從材料和加工到組件、組裝及下游應用）的全面產品組合，同時在市場上建立強大的技術壁壘與差異化優勢。

我們計劃將[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元（相當於約[編纂]%）用於建立高端製程設計與仿真解決方案開發的研發能力。

除半導體行業外，我們打算通過利用我們的LOFA產品、GloryIGI及相關平台的多功能性，將我們AI賦能的智能製造解決方案的應用擴展至其他行業。通過與行業領導者、研究機構和技術合作夥伴的戰略合作關係，我們旨在共同開發適用於更廣泛行業用例的創新解決方案，鞏固我們的競爭優勢，並通過人工智能和自動化主導的轉型推動可持續增長。

利用我們的智能製造技術加速海外佈局

我們的全球化旨在通過將自身定位為智能製造領域的知名提供商來釋放廣闊的成長機會。在初期階段，我們將專注於服務中國企業的海外業務需求，特別是拓展國際市場的企業。通過深化與國際客戶的合作，我們旨在深入了解不同的區域市場需求和行業趨勢，從而優化我們的產品供應並增強我們的服務能力。

為推動我們的海外擴張，我們在新加坡設立了海外事業部和附屬公司，為全球業務拓展奠定了基礎。我們已將越南、馬來西亞、泰國、新加坡、印度及中東確定為我們的主要海外目標市場，根據弗若斯特沙利文的資料，該等市場對光伏、PCB及半導體產業的全球轉移至關重要。我們相信，憑藉我們在中國IMSS市場的豐富經驗及穩固的客戶基礎，我們有將業務版圖擴展至目標地區的能力。

我們的海外擴張策略主要是關注海外現有客戶，同時建立本地化交付能力，我們的發展方向包括三個方面。首先，我們旨在利用光伏、PCB及半導體封裝／測試行業的主要客戶，隨著彼等擴大產能將我們的服務延伸至海外。其次，我們將利用新加坡附屬公司作為區域總部及在該地區提供服務的中心。第三，我們將以已獲證明的項目作為突破口，藉此複製成功模式並於該地區擴展業務，目前我們已於光伏、PCB及半導體封裝及測試行業物色到活躍商機。

為支持我們全球目標的實現，我們將投資本地化的研發和技術支持團隊，以確保我們的解決方案適應區域監管要求、行業標準和市場偏好。我們相信與當地經銷商、技術供應商和研究機構建立戰略合作夥伴關係將進一步增強我們的市場滲透力，並能夠共同開發針對特定區域需求的創新解決方案。

通過加速海外擴張，我們不僅將推動我們的收入增長和市場份額，而且還將有助於全球認可中國在製造業領域的創新。我們計劃將[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元（相當於約[編纂]%）用於尋求國內外戰略聯盟、投資以及併購機會，並將同樣金額的[編纂][編纂]淨額用於通過擴展國內外銷售與服務網絡提升我們的商業化能力。

業 務

吸引頂尖及潛在行業人才，深化泛半導體領域研發

泛半導體智能製造業人才壁壘較高，需要具備深厚的下游行業專業知識。由於人才是我們成功的基石，我們已優先建立一支高素質的國內及全球團隊來維持我們的競爭優勢。

未來，我們將加強引進具有豐富行業經驗的頂尖技術人才和研發人才，拓寬並強化人才儲備。我們的招募策略將專注於尋找在人工智能、大數據、自動化和泛半導體製造工藝方面具有專業知識及經驗的人才，使我們能夠應對製造業的複雜挑戰。

在人才招聘的同時，我們亦培養充滿活力、注重成長的企業文化，促進持續學習和專業發展。通過培育以學習為中心的團隊氛圍，我們將促使員工充分發揮其潛力，推動創新和卓越營運。我們對人才發展的投資包括持續的培訓計劃、跨學科知識共享和職業發展機會，確保我們的員工在快速發展的行業中保持敏捷和適應性。例如，我們通過「雛鷹計劃」等舉措，實施結構性的訓練和考核框架，持續培養和打造該領域的高技能專業人才。通過建立可持續及全面的人才獲取機制，我們將推動持續創新，增強我們的產品組合，為我們的客戶提供變革性價值，並推動未來增長。

上市規則第十八C章項下的特專科技產品

泛半導體行業客戶的性質及要求

於往績記錄期間，我們的所有客戶均來自泛半導體行業，包括半導體、顯示面板、印刷電路板及光伏。泛半導體行業的先進製造需要納米至微米級的精度、嚴格的公差控制、真空及熱穩定性、高純度材料以及缺陷預防。根據弗若斯特沙利文的資料，下表列出了半導體行業(就晶圓製造而言)的CIM系統與其他行業(如汽車、通用機械及製藥)的CIM系統的關鍵特徵比較。

	半導體CIM	其他行業的CIM
生產模式及工藝 複雜度.....	半導體製造為一個高度複雜且精密的過程，涉及大量緊密相互依存的加工步驟—通常超過1,000步。工藝環節之間的強耦合以及對偏差的極小容忍度使得錯誤恢復變得困難。生產返工在商業上不可行。	其他行業主要採用離散或線性流水線生產，工藝步驟較少且更具順序性，返工或修復在商業上可行。

業 務

	半導體CIM	其他行業的CIM
系統架構及 核心模塊.....	該架構由緊密集成的系統組成，共同實現實時控制，其中來自系統某一部分的反饋被用於持續改進及優化另一部分，從而創建一個與設備及工藝邏輯深度嵌入的實時數據集成及糾正措施循環。	該架構通常以MES為中心並輔以其他支持系統，整合較為鬆散，功能側重於協助人員進行執行及監控。
實時性能及 自動化水平.....	系統需要超高的響應速度，約99%的關鍵操作在一秒內完成，並支持高達約每秒2,000次交易的數據吞吐量，從而實現高度自動化、近乎無人值守的運作。	系統在中等實時要求下運行，通常為秒級或分鐘級響應時間，並透過結合自動化及人工干預來支持較低的數據吞吐量。
平台穩定性及 可靠性.....	平台需要維持持續運作，並具備約99.9%的無故障性能，因為即使是輕微的中斷亦可能直接影響良率及生產連續性。	平台穩定性要求相對較低，計劃內停機及局部系統故障屬可接受，且可進行管理而不會產生重大影響。
數據規模及數據 驅動邏輯.....	系統處理整個生產過程中產生的大量、高頻數據。該等數據主要透過優化用於提高良率及控制缺陷。	系統管理相對有限的數據集，主要用於追蹤生產、設備狀態及質量結果，以支持效率及成本控制。
設備連接性及 控制深度.....	設備集成高度標準化，允許CIM系統直接管理及發送工藝參數，並實現對設備行為的嚴密控制。	設備連接依賴於通用協議，系統主要執行監控及基本控制，對內部工藝參數的影響有限。
質量及良率管理....	質量管理的核心是透過實時監控及控制來最大化良率，缺陷可追溯至微觀層面的特定工藝步驟。	質量管理側重於合格率及穩定性，依賴於檢驗及統計方法，通常由後工藝分析推動改進。
行業壁壘及定制化..	該行業具有極高的進入壁壘，需要深度整合工藝專長、設備控制及數據能力，從而導致高度定制化及複雜的實施。	該行業具有相對較低的壁壘，具有更標準化及可配置的系統，可以靈活部署且實施週期較短。

業 務

我們的IMSS專門針對泛半導體行業高度複雜的先進製造的極端要求而量身定制。我們滿足泛半導體行業的先進製造需求，因為我們的IMSS連接了全廠的設備、工藝、材料、物流、數據採集以及分析與決策。我們的軟件產品協同運作，協調整條生產線的生產執行，從晶圓傳送及配方控制到調度及良率監控。藉助人工智能賦能，我們具備人工智能功能的IMSS從生產及營運數據中學習，並將該等數據轉化為可執行的決策，以協助排程、異常檢測及決策支持。對於泛半導體的先進製造，我們的IMSS支持前道及後道場景，並與高度專業化的設備及工藝流程緊密集成，從而帶來更好的可見性、更少的人工交接以及更穩定的生產控制。這對於泛半導體行業尤為重要，因為其良率損失昂貴，且微小的工藝偏差可迅速傳播至下游。

上市規則第十八C章項下的先進製造特徵

我們五大平台下的IMSS透過將自動化、計算、軟件、傳感及網絡（「十八C特徵」）結合成一個協調的工廠控制層，以滿足泛半導體行業的先進製造需求，此乃歸因於生產活動及數字化製造（傳感器及3D視覺技術於製造過程中的應用）技術之發展，屬於上市規則第十八C章所定義的特專科技行業中「先進製造」的可接納領域，詳情闡述如下：

- **自動化：**我們的IMSS包含自動化特徵，因為其以最少的人工干預協調設備、生產流程及工廠物流，確保「無干預」運作，減少錯誤且具備高可重複性。在泛半導體製造中，這有助於標準化工序，減少人為錯誤，並在眾多步驟及工具中保持大批量工藝的穩定。它亦支持涵蓋從生產初始階段至最終產出的全面執行，從批次派工至控制物料傳送以及管理生產排程。
- **計算：**我們的IMSS使用計算模型處理大量的生產、設備及質量數據，以便泛半導體工廠能夠更快地應對異常、瓶頸或良率風險。我們IMSS的計算能力允許處理來自現代工具的海量激增數據，將原始信號轉化為可用於提高良率的具備行動指導意義的情報。藉助人工智能及分析，IMSS亦能支持預測性決策及持續優化，而不僅僅是事後報告。
- **軟件：**軟件是將整個晶圓廠連接在一起的協調媒介。在泛半導體領域，IMSS軟件通常涵蓋生產執行、設備連接、工藝管理、可追溯性及大數據／人工智能應用。我們五大平台中的軟件產品為泛半導體行業的先進製造需求實現了不同的目的。
- **傳感：**我們的IMSS具備傳感能力，可捕捉機器、材料及工藝環境的實時狀況及參數。半導體晶圓廠依賴對溫度、壓力、振動及工藝狀態等變量的精確監控，以便及早發現偏差並保障質量。透過將該等傳感器數據輸入分析及控制系統，IMSS有助於維持先進製造所需的精度及穩定性。

業 務

- **網絡：**網絡連接工廠內的設備、系統及決策者。在泛半導體工廠中，這種連接對於在平台及設備控制器之間同步軟件至關重要，以便數據及指令無延遲地流動。我們IMSS中的網絡亦實現了全廠可見性、實時協調及工藝控制（其中來自系統某一部分的反饋被用於持續改進及優化另一部分，從而創建一個實時數據集成及糾正措施的循環），這對於高產量及高良率生產是必不可少的。

我們IMSS的十八C特徵

我們的每一個平台均屬於「先進製造」的可接納領域，因為每個平台均具備自動化、計算、軟件、傳感及／或網絡的十八C特徵，因此符合上市規則第十八C章項下的特專科技產品資格。下表列出了我們五大平台各自的十八C特徵：

生產運營平台

十八C特徵	描述
• 自動化	在CIM系統中，MES作為核心系統，支持超過1,000個複雜生產工藝控制，包括自動發出工單及自動化流程。透過與綜合自動化平台協作，MES及RTD需要自動化操作以實現整個生產流程的高效管理。
• 計算	該平台中的軟件處理大量生產數據及複雜的生產控制流程，這需要計算能力來支持實時生產排程及優化。該平台中的軟件產品處理參數計算及生產排程優化計算，可於一秒內完成99%的半導體關鍵操作要求，信息吞吐量達每秒2,000次交易。
• 軟件	該平台中基於軟件的產品以99.9%的無故障半導體穩定性實現整個製造執行。
• 網絡	網絡實現了該平台下操作的實時數據傳輸及共享。整個生產環節緊密相連，確保生產過程的協調及監控。

集成自動化平台

• 自動化	在CIM系統中，生產運營平台下的MES作為生產流程的中央樞紐。MES分發用於生產的工藝指令，而該平台下的EAP則自動執行機器動作。
• 計算	該平台中的軟件處理物流數據並優化物流路線，這需要計算能力來支持智能派單及路線規劃。該平台中的軟件產品處理參數計算，可於一秒內完成98%的半導體關鍵操作要求，信息吞吐量達每秒2,000次交易。

業 務

十八C特徵	描述
• 軟件 • 傳感 • 網絡	該平台中基於軟件的產品實現了設備及生產線物流管理。 該平台中的軟件產品旨在透過連接生產設備傳感器數據的設備，以獲取設備生產狀態及物流設備狀態。 網絡實現了該平台下操作的實時數據傳輸及共享。連接各種生產及物流設備與系統，確保生產及物流過程的協調與監控。
智控數字平台	
• 自動化 • 計算 • 軟件 • 網絡	LOFA-Bots/RPA及LOFA-AI/ADC能夠實現業務自動化以取代部分工作流程中的人工，並自動檢測缺陷。該平台中的自動化特徵實現了集中監控、遠程控制、異常警報及自動化操作。 該平台下的軟件產品處理大量生產數據以及設備數據及圖像，進行數據分析及AI圖像識別，這需要計算能力來支持智能決策。該平台中軟件產品的計算功能支持在生產檢測過程中對晶圓缺陷進行詳細分類，實現98%的準確率。 該平台中基於軟件的產品實現了智能工廠管理及智能控制，亦能實現工廠營運的數字化呈現及移動協作。 網絡實現了該平台下操作的實時數據傳輸及共享。連接生產設備及系統，以協作及監控該平台下的智能工廠，並實現從中央控制室對設備進行遠程集中控制。
智能大數據引擎平台	
• 計算 • 軟件 • 網絡	該平台的核心功能是處理及分析大量數據，這需要計算能力來支持數據挖掘及機器學習算法。該平台中基於AI的機器學習算法可實現良率預測、故障診斷、虛擬測量，並支持高精度生產良率，將生產線良率穩定提升至98%以上。 該平台中基於軟件的產品實現大數據收集及處理，並支持PB級數據量。 網絡實現了該平台下操作的實時數據傳輸及共享。各種數據源及分析系統的網絡連接確保了數據傳輸的完整性及及時性。該平台中的網絡功能整合了整個工廠的多源數據，以建立統一的數據平台。

業 務

十八C特徵

描述

數字化設備平台

- 自動化 該平台的核心功能是實現設備的自動化運作及管理，包括自動化生產設備及自動化檢測設備。
- 計算 該平台中的軟件產品處理設備數據並優化設備性能，這需要計算能力來支持智能診斷及優化。PDS下的工藝糾錯計算滿足28納米半導體工藝的要求。
- 軟件 該平台中基於軟件的產品實現智能設備數據交換及設備自動化控制。
- 傳感 該平台中基於軟件的產品旨在透過傳感器獲取設備的狀態及性能數據，以實現自動化監控及診斷。
- 網絡 該平台的網絡功能支持通用半導體連接協議。iEQ網關整合了不同設備品牌的協議，實現了統一通信。

總括而言，該等特徵使我們的IMSS能夠支持完整的先進製造鏈：我們的軟件產品可實現自動化執行、透過計算進行數據驅動控制、實時傳感以及透過網絡進行互聯決策。對於泛半導體製造商而言，實際成果是確保高精度、更高良率、更快應對異常、更強的工藝穩定性及更低的營運成本。

下文呈列兩個我們為客戶提供的IMSS項目說明性案例研究，證明我們的IMSS符合上市規則第十八C章項下的特專科技產品資格。

案例研究1：

於2023年，我們向客戶AA提供IMSS服務，即MES二期項目，提供包括MES、EAP及BI(商業智能)的CIM解決方案。該項目旨在滿足客戶在以下方面的要求：(1)實現與設備的通信連接，實現設備數據的信息化及自動化；(2)收集設備的各種生產參數及設備報警信息；(3)實現生產可追溯性；(4)實現鑽孔生產程序的自動計算及下發；及(5)實現裝置的系統化管理。

根據與客戶AA的合約，我們受聘建立一個標準的企業MES，該MES應支持MES模型及ISA-95標準，符合國際、國家及行業標準，並具備高產品成熟度。

如下文所示，該項目體現了自動化、計算及網絡的十八C特徵。我們的服務需要透過網絡連接鉗鑽孔機及電氣測試設備，以實現程序**自動化**。掃描工單後，MES計算程序或參數公式，並自動發送至機器控制電腦，該工作流程可在一秒內完成(完成率達98%)。系統收集生產過程中所需的各種參數，例如材料編號信息、加工進度、加工時間、鑽孔數量、工具信號點及報警信息。系統根據設備的運作狀態計算設備利用率，並在儀表板上呈列實時狀態、加工數據、加工進度及反饋信息，以進行實時機器監控。其亦可匯總生產數據進行統計分析，以追蹤生產及排除故障，從而提高生產效率。

業 務

MES系統提供生產物料、工藝管理及產能信息的信息化管理，有助於制定客觀、合理及準確的生產計劃，以滿足生產過程的實際需求。

案例研究2：

於2025年，我們向客戶BB提供數字化設備平台下的軟件產品CTF。如下文所示，該項目體現了自動化、網絡及傳感的十八C特徵。

該項目涉及我們基於數字化設備平台為客戶BB的全自動旋塗及顯影機提供的軟件服務。我們的軟件服務實現了客戶控制機器組件（如門、閥門、機械臂及輸送設備）並收集傳感器信息（如溫度、壓力、功率等）以自動完成旋塗及顯影工藝（**自動化**）的目的，符合半導體工藝標準。系統採用EtherCAT實時工業以太網總線架構進行連接及控制（**網絡**）。透過工業網絡連接，其收集設備傳感器信息以監控及顯示狀態（**傳感**）。其收集設備傳感器信號以進行環境監控及顯示。其亦能根據傳感器信息設定工藝參數的報警值，並將此信息納入工藝參數管理中。

我們的五大平台及提供的解決方案

泛半導體行業作為技術進步的主要驅動力增長迅速。泛半導體製造的主要痛點包括(i)泛半導體行業涉及數以千計的高精製造步驟，(ii)信息系統和運營技術之間的脫節造成數據孤立，及(iii)資本密集型投資及漫長的研發週期令盈利能力承壓。泛半導體IMSS具有精準管控及提升良率、無縫數據流轉及集成以及降低成本等優勢，有效解決行業痛點。

我們為泛半導體行業的客戶提供量身定制的IMSS。我們的集成平台覆蓋整個價值鏈，從生產數據採集、製程管理，到大數據分析、AI應用，該能力使客戶能夠優化運營效率、提升生產質量及精度，並在整個製造環境中充分利用智能決策系統。

我們根據客戶需求，依託我們的解決方案平台，為客戶提供多種軟件產品的選擇：

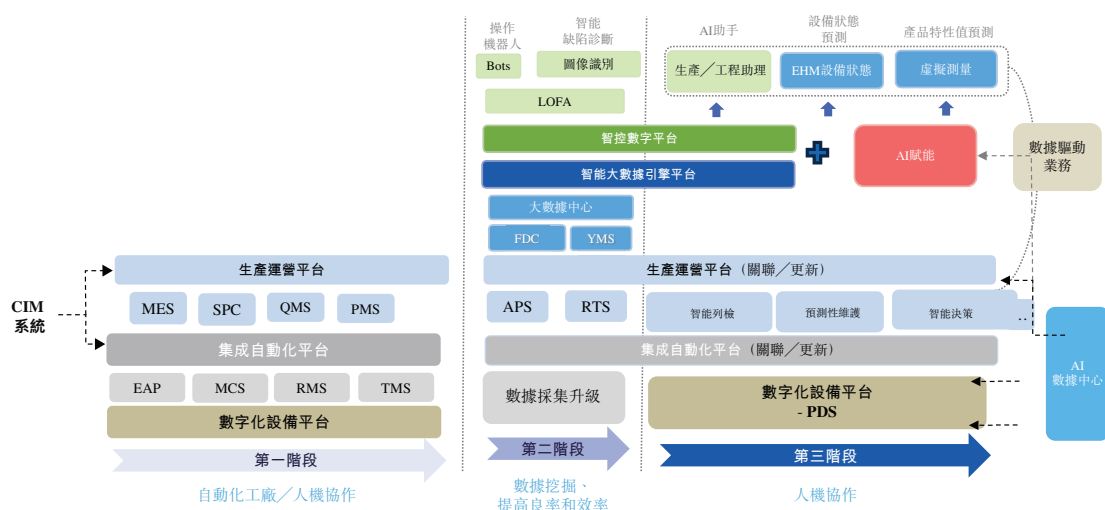
- (i) **生產運營平台及集成自動化平台。**這兩個平台的若干軟件產品構成了CIM系統。生產運營平台的軟件可實現對整個生產過程的精益管控，結合集成自動化平台，實現全工廠自動化，涵蓋設備和生產過程層面。各種功能（包括物料及設備控制、倉庫管理、生產計劃、排程及執行）以及質量控制流程均可整合，以實現工廠全自動化及整條生產線的自動化質量監控。
- (ii) **智控數字平台：**通過使用遠程控制技術，該平台中的軟件產品有助於為自動化設施建立中央控制室。透過統一入口平台（訪問所有系統的單一門戶登錄入口），人員可監控工廠車間，並通過遠程集中系統執行任務，以提高中控人員的執行效率，協助管理者決策。

業 務

- (iii) **智能大數據引擎平台**：以智能算法、大數據分析及機器學習為核心，收集及分析來自CIM系統的數據，以進一步優化流程，從而提升精確度及良率。應用場景包括設備異常調查、質量問題分析及參數優化。
- (iv) **數字化設備平台**：我們在該平台中向客戶提供的核心軟件產品用於並應用於該等設備，以實現設備數據交換及轉換，並實現設備的自動化控制。我們的客戶所製造的設備並未內置固有軟件，該等設備製造商（即我們的客戶）購買並將我們的軟件產品嵌入及安裝於彼等的產品（即該等設備）中，以便啟動及運行該等設備。我們的軟件產品對設備製造商（即我們的客戶）的增值在於協助其開發更符合半導體行業國際標準的國產設備，並確保其泛半導體行業下游客戶（即採購內置我們軟件產品的設備的客戶）在營運生產線時，能夠實現與CIM系統的順暢整合、兼容及互操作。

五大平台的協調與主要區別

圖1：下圖概述我們的五大平台及其關係以及在智能工廠中的應用場景。



我們的五大平台由一套專業軟件模塊組成，旨在優化各類生產與運營管理流程。各平台下的解決方案以項目為基礎，客戶可選擇性為新建及／或現有設施部署個別軟件模塊，或採用多平台軟件集成解決方案套件進行設施升級或開發。

CIM系統包括來自生產運營平台及集成自動化平台的若干軟件產品，構成我們泛半導體客戶初步設立工廠或生產線的基礎。雖然各智控數字平台及智能大數據引擎平台下的軟件產品並非用於初始設立工廠或生產線，該等軟件產品可由我們以獨立基礎提供，以便對現有工廠或生產線進行有針對性的升級。數字化設備平台項下的軟件產

業 務

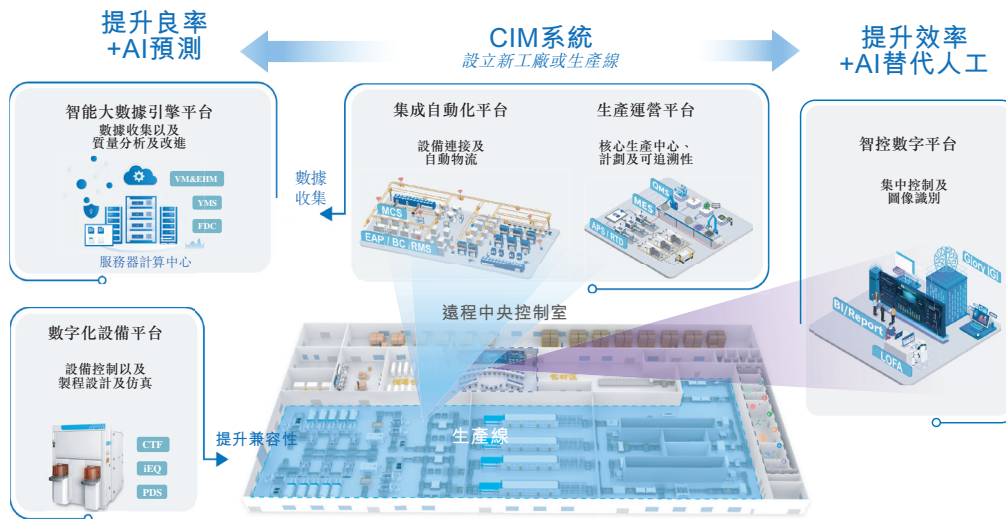
品乃針對設備（而非整條生產線或整個工廠）而設並應用於設備，服務對象為設備製造商，而其下游客戶則為購買該等設備以建設或升級其工廠或生產線的客戶。按工廠或生產線的開發階段劃分，我們五大平台項下的軟件產品可分為以下三個階段：

- **第一階段：**就我們泛半導體客戶的智能工廠或生產線的初始建設而言，我們的CIM系統（由生產運營平台及集成自動化平台項下的若干軟件產品組成）通常為自動化新工廠或生產線進行初始建設及設立所必需。泛半導體行業的設備製造商客戶亦可能於其設備開發過程中需要我們數字化設備平台項下的軟件產品，從而使有關設備與智能工廠的CIM系統具備更佳兼容性。
- **第二階段：**倘若我們的若干客戶有意升級其現有工廠或生產線，彼等或會需要我們智控數字平台項下的軟件產品，以與其現有CIM系統進行整合，從而提升效率及／或需要我們智能大數據引擎平台項下的軟件產品，以便對自CIM系統收集的大數據進行分析，從而提高良率。
- **第三階段：**客戶的現有工廠／生產線或設備可能會透過以下三個平台中任意一個或多個平台的軟件產品的AI賦能作進一步升級：我們計劃開發並推出智控數字平台下的軟件產品，該等產品可能為客戶所需，以實現AI替代人工，從而提高營運效率並減少人為錯誤；我們亦計劃開發並推出智能大數據引擎平台下的軟件產品，該等產品可能為客戶所需，以實現AI預測，從而進一步提升良率及質量。目前，我們提供數字化設備平台下的軟件產品，該等產品為我們的設備製造商客戶所需，以透過採用AI技術實現高端製程設計及仿真（其模擬半導體製造步驟以在實際製造前探索更多設計或製程選項）。

因此，單一客戶在其工廠或生產線開發的不同階段可能需要我們的一個或整合我們的多個平台，或需要該等平台中的一個軟件解決方案或整合我們的多個軟件解決方案。就收入貢獻而言，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們IMSS的CIM軟件解決方案所產生的收入分別佔我們總收入的82.7%、78.5%及71.6%。有關詳情，請參閱下文「－收入、毛利及毛利率明細」。

業 務

圖2：下圖列出部署於客戶工廠內的五大平台之互動情況



附註：

1. 每個平台使用的硬件包括：
 - a. 生產運營平台：服務器及網絡基礎設施
 - b. 集成自動化平台：服務器、通信盒、工業個人電腦、網絡基礎設施、自動物料搬運系統（如儲料器、自動引導車、OHT等）
 - c. 智控數字平台：服務器、通信盒、工業個人電腦及KVM
 - d. 智能大數據引擎平台：服務器及網絡基礎設施
 - e. 數字化設備平台：服務器、通信盒、工業個人電腦、工藝設備、運動控制器（PLC、運動控制板）
2. 收入及成本確認：就我們的五大平台各自而言，收入及成本一般於客戶驗收後確認。
3. 定價政策：就我們的五大平台各自而言，特定解決方案或解決方案組合的定價考慮了多種因素，如研發投資、營運成本、市場狀況及軟件解決方案功能。
4. 收費基準：
 - a. 在生產運營平台、集成自動化平台、智能大數據引擎平台及智控數字平台各自項下，我們主要按項目基準收費，據此，軟件解決方案的價格或服務費是固定的，取決於項目複雜度、涉及的工作量及人力、涉及的軟件產品以及客戶提出的定制要求等。
 - b. 在數字化設備平台項下，我們通常就設備特定軟件包收取前期許可費及首台設備開發合作費，其後收取每台許可使用費及與產量掛鉤的技術服務費。
5. 於往績記錄期間，我們各平台下項目的平均合約金額（不含稅）為：
 - a. CIM系統（包括生產運營平台及集成自動化平台）：約人民幣0.82百萬元
 - b. 智控數字平台：約人民幣1.4百萬元
 - c. 智能大數據引擎平台：約人民幣0.95百萬元
 - d. 數字化設備平台：約人民幣0.97百萬元

業 務

五大平台之間的差異

研發及商業化階段：截至最後實際可行日期，除GloryIGI及VM&EHM外，我們五個平台下的所有軟件模塊均已商業化，並從客戶處確認了收入；有關我們的CIM軟件解決方案及其他平台產生的收入，請參閱本節下文「收入、毛利及毛利率明細」。

計費依據：根據客戶的要求，我們的軟件解決方案可以獨立購買，也可以跨不同平台的各種解決方案組合購買。就提供定製解決方案及服務而言，軟件解決方案的價格或服務費用乃根據其各自的協議釐定。對於我們的數字化設備平台，我們通常收取設備專用軟件包的前期許可費、首台設備開發合作費、以及每台設備的許可使用費及與產量掛鉤的技術服務費。

為客戶及應用場景帶來的增值：有關我們在五大平台下的解決方案模塊的應用場景及為客戶帶來的增值，請參閱下表以及下文「一 我們系統模塊的應用場景」。

下表載列五大平台之間的其他差異：

	生產運營平台	集成自動化平台	智控數字平台	智能大數據引擎平台	數字化設備平台
關鍵特徵及服務範圍.....	生產運營平台下的軟件產品歸類於我們的CIM系統。該平台用於管理及控制整個生產過程。	集成自動化平台下的軟件產品歸類於我們的CIM系統。該平台用於實現全廠自動化以及設備與物料控制的互聯。	智控數字平台下的軟件產品有助於為自動化設施建立中央控制室，實現CIM系統的遠程集中管理。	智能大數據引擎平台下的軟件產品收集及分析數據，以優化及升級生產過程。	數字化設備平台下的軟件產品實現工業設備之間的數據交換及數據轉換，從而能夠在生產過程中控制設備並確保與CIM系統的兼容性。
角色.....	作為CIM系統的「大腦」，該平台中的軟件產品為核心生產中央系統。	作為設備通信的橋樑，該平台中的軟件產品為生產過程的執行者(接收來自生產運營平台的生產指令)。	其作為一個集中監控中心及智能營運指揮中心。	作為全廠的數據中心，該平台在大數據支持下促進質量決策。	其作為設備的數字基礎及設備控制引擎。

業務

生產運營平台	集成自動化平台	智控數字平台	智能大數據引擎平台	數字化設備平台
應用場景及目的 該平台的若干核心軟件產品在初始設置及建立階段應用於整條生產線。 其用於全面管理整個生產過程，包括物料及質量可追溯性、人員執行記錄、生產流程及執行。 該平台應用於上述圖1中的第一階段開發。	該平台的若干核心軟件產品在初始設置及建立階段應用於整條生產線。	該平台中的軟件產品在現有工廠升級階段應用於整個工廠。	該平台中的軟件產品在現有工廠升級階段應用於整個工廠。	該平台中的軟件產品在設備研發階段應用於設備級別（即由我們的設備製造商客戶用於其設備的內部工藝控制、數據接口及模擬）。
	該平台中的軟件接收來自生產運營平台的生產指令以分發至現場設備，以實現生產過程控制及自動化的目的，從而提高設備利用率並減少人工干預。	透過應用AI深度學習及數字化轉型，達到優化產品參數的目的（在上述圖1的第二階段中），以提高生產效率。	該平台的軟件產品從CIM系統收集數據至大數據分析工具，分兩個階段升級現有工廠：	該平台應用於上述圖1中的第一階段（用於設備開發：實現與CIM系統的兼容性）及第三階段（用於採用AI技術設計及仿真的高端製程）。
	該平台應用於上述圖1中的第一階段開發。	透過應用AI智能體及AI大模型，實現替代人工的目的（例如替代生產人員處理設備故障、替代工程師進行設備調整、替代質控工程師檢測及修復產品以及協助管理層決策）（在上述圖1的第三階段中）。	透過應用AI智能體及生成式AI，實現預測、設備調整及優化建議的目的（在上述圖1的第三階段中）。	該平台應用於上述圖1中的第一階段（用於設備開發：實現與CIM系統的兼容性）及第三階段（用於採用AI技術設計及仿真的高端製程）。
	該平台應用於上述圖1中的第一階段開發。	該平台應用於上述圖1中的第二階段（用於實現效率）及第三階段（用於AI替代人工）。	該平台應用於上述圖1中的第二階段（用於提升良率）及第三階段（用於AI預測）。	

業 務

	生產運營平台	集成自動化平台	智控數字平台	智能大數據引擎平台	數字化設備平台
目標客戶.....	我們在生產運營平台下的客戶主要是半導體、PCB、太陽能、顯示面板行業的製造商（使用QMS、RTD）或（更廣泛而言）泛半導體行業的製造商（使用MES及APS）。	我們在集成自動化平台下的客戶主要是半導體、PCB、太陽能、顯示面板行業的製造商。	我們LOFA-AI/ADC的客戶包括需要高精度檢測微小缺陷的製造商，包括半導體及顯示面板行業的製造商。 LOFA-PCC/RCM及LOFA-Bots/RPA的客戶為半導體製造商。GloryIGI的客戶預期將包括PCB製造商及光伏製造商。	我們在智能大數據引擎平台下的客戶主要是半導體、光伏及顯示面板行業的製造商。	我們CTF及IEQ的客戶主要是半導體行業的設備製造商。我們PDS的客戶主要是研究機構及光掩膜。
對客戶的增值.....	我們為泛半導體行業客戶帶來的增值包括營運效率、納米至微米級精度的控制以及實時視覺分析能力。	我們為泛半導體行業客戶帶來的增值包括實現全廠自動化，將工廠從一系列昂貴機器的集合轉變為自動化及同步的系統，以達到更高效率的生產目的。	我們為泛半導體行業客戶帶來的增值包括提升人員效率及營運效率。	我們為泛半導體行業客戶帶來的增值包括提高精度及良率，透過(1)快速定位及分析質量異常，從而減少批量缺陷；及(2)透過預測及早終止生產異常。	我們為泛半導體行業的設備製造商客戶帶來的增值包括開發更符合半導體行業國際標準的國產設備，同時亦能與我們的CIM系統實現順暢整合及互操作，並預先嵌入設備操作系統中。
數據來源及用途.....	該平台下的數據來自ERP及EAP等系統、自動化設備及人工輸入，產生之數據用於推動當前的製造。	該平台下的數據來自MES等系統、自動化設備及傳感器，產生之數據用於推動當前的製造。	該平台下的數據包括來自各平台的匯總數據；設備狀態數據及生產營運數據。	該平台下的數據來自CIM系統、智控數字平台，以及工廠的其他系統。	該平台下的數據來自設備內置傳感器、設備控制系統及工藝參數。
		該等數據用於工序後分析及處理異常情況，從而提高生產效率。	該等數據用於工序後分析及處理異常情況，從而提高良率及CIM系統的穩定性。	該等數據用於工序後分析及處理異常情況，從而提高良率及CIM系統的穩定性。	

業 務

生產運營平台		集成自動化平台	智控數字平台	智能大數據引擎平台	數字化設備平台
技術及(如適用) AI整合	其採用數據庫架構、統一框架平台架構及主流企業級分佈式技術架構等技術，以實現邏輯生產計劃、可追溯性、穩定性、工藝整合及具有快速響應的精細化批次數據管理。	其採用工業互聯網技術實現連接設備的自動化控制及交付、標準化協議接口，並支持從設備進行毫秒級實時數據收集，以快速應對故障。	其實現軟硬件結合及自動化-AI整合，並採用遠程集中控制、視覺識別技術、機器人流程自動化等技術以實現人機交互界面，協助甚至替代人工，並支持跨平台控制設備數據，實現具備快速響應的「無人化」營運及維護場景。	其採用數據挖掘及分析及機器學習算法等技術實現設備及生產數據整合，並支持PB級數據存儲及處理。	其採用用於設備數據轉換的模塊系統，以實現設備組件通信控制及傳感器數據收集、設備營運調度及工藝精度控制。
		圖像AI應用於識別及判斷設備屏幕，從而驅動自動化操作流程。生成式AI將用於以下場景：提升LOFA的AI圖像識別能力－結合業務特定語言加強深度學習模型，提高精度並生成LOFA自動化操作流程－分析人員在設備屏幕上的操作以自動生成自動化操作序列。此外，在現有的LOFA自動化操作場景下，圖像AI用於識別及判斷設備屏幕以驅動操作流程。			
		數據AI（機器學習）結合歷史數據被用於推薦工藝參數以提高成功率。採用貫穿整個數據鏈的整合存儲，並由數據中心提供支持；從而實現數據應用、可視化、分析、預測及優化，並實現一個具備快速響應的生產過程（其中來自系統某一部分的反饋被用於持續改進及優化另一部分，從而創建一個實時的數據集成及糾正措施的循環）。 正在探索生成式AI，以透過提出方法及結論，在客戶投訴調查中實現引導式數據分析。			
		AI計劃主要採用物理模型以創建反映真實世界情況的模擬，從而在實際設備運作前實現工藝參數的重現計算及誤差校準。			

業 務

下表列出五大平台項下各項特專科技產品的開發階段、時間表、商業化可行性及障礙。同一平台項下的特專科技產品採用類似技術。請參閱上文列出五大平台之間差異的表格。

軟件產品	開發階段及商業化	開發時間表	
	可行性或障礙 (附註1及2)	發佈日期 (附註3)	收入確認日期
生產運營平台			
MES	已商業化	2008年10月	2011年5月
QMS	已商業化	2018年9月	2020年12月
RTD	已商業化	2020年9月	2023年4月
APS	已商業化	2009年9月	2024年11月
集成自動化平台			
EAP (附註4)	已商業化	2014年10月	2012年2月
RMS	已商業化	2017年5月	2022年11月
BC	已商業化	2012年8月	2018年10月
MCS	已商業化	2016年7月	2018年11月
智控數字平台			
LOFA-PCC/RCM	已商業化	2014年10月	2017年12月
LOFA-AI/ADC	已商業化	2020年3月	2024年8月
LOFA-Bots/RPA	已商業化	2020年10月	2021年5月
GloryIGI (附註6)	籌備中	2026年6月（預期）	2026年12月（預期）
智能大數據引擎平台			
YMS	已商業化	2016年6月	2024年5月
FDC	已商業化	2015年9月	2021年4月
VM&EHM (附註6)	籌備中	2026年6月（預期）	2026年12月（預期）
數字化設備平台			
CTF (附註4)	已商業化	2021年9月	2021年3月
iEQ	已商業化	2020年8月	2021年12月
PDS	已商業化	2024年12月	2025年6月

附註：

1. 已商業化的特專科技產品指已從客戶確認收入的軟件產品，且該等產品被視為具備商業化可行性。
2. 籌備中的特專科技產品指於往績記錄期間及直至最後實際可行日期處於研發階段的軟件產品。
3. 根據其計算機軟件著作權登記證書，發佈日期為該產品軟件著作權的首次發表日期。
4. 根據《計算機軟件保護條例》及《著作權法實施條例》，軟件著作權自軟件開發完成之日起自動產生。登記乃自願性質，且並非銷售軟件產品的先決條件。根據財政部與國家稅務總局聯合發佈並於2011年1月1日生效的《財政部、國家稅務總局關於軟件產品增值稅政策的通知》，取得軟件產業行政主管部門頒發的軟件產品登記證書或著作權行政管理部门頒發的計算機軟件著作權登記證書的自行開發軟件產品（在滿足其他條件及經主管稅務機關審批後），可適用增值稅即徵即退政策。

業 務

EAP (2014年10月) 及CTF (2021年9月) 的軟件著作權登記乃按自願基準完成，其晚於彼等各自的收入確認日期，主要目的是使該等軟件產品符合增值稅即徵即退政策的資格。

5. 通常，我們的軟件產品的推出日期與收入確認日期之間存在時間間隔，原因如下：(i) 於產品軟件著作權的首次發表日期 (即發佈日期) 後，我們不斷完善及升級產品，並在合適的市場條件下向客戶推廣該等產品。例如，我們於2020年左右開始擴大智能大數據引擎平台下產品的開發，而該平台下產品的軟件著作權已於數年前登記；(ii) 於往績記錄期間，我們的重大項目工期由約四個月至約44個月不等，而重大項目的平均工期約為20個月。一般而言，收入及成本於客戶驗收後確認。因此，於產品發佈日期後，後續產品完善、營銷及項目磋商、實施及驗收的過程將跨越數年。
6. 產品的商業化可行性由以下因素支持：
 1. 需要補充行業知識並建立行業知識庫。我們預期聘請行業顧問以建立或加強與先進製造客戶的業務合作；
 2. 需要增加用於模型迭代訓練的實驗室算力以及用於研發的模型託管服務器。本公司預期建立實驗室並購買算力以加強研發。

請參閱「未來計劃及[編纂]用途」，了解我們計劃將[編纂][編纂]淨額約[編纂]%用於建設我們在泛半導體行業的AI應用能力，重點為升級及優化AI產品。

基於(a)上文「特專科技行業」表格所列平台及解決方案模塊 (涵蓋「先進硬件及軟件」可接納領域的數字化製造中「先進製造業」項下的所有十八C特徵，即自動化、計算、軟件、傳感及網絡) 的適用性分析；及(b)下文「我們的五大平台及提供的解決方案」所詳述我們五大解決方案平台及核心系統模塊的特點、功能、技術及客戶需求驅動因素分析，並考慮到我們下游客戶 (即泛半導體行業) 的行業性質涉及複雜的製造工藝，其營運需要如我們所提供的精密軟件解決方案 (於「行業概覽」一節進一步闡述)，董事認為，且行業顧問 (弗若斯特沙利文) 亦認同，我們平台下的解決方案屬於上市規則第十八C章界定的特專科技行業「先進硬件及軟件」領域的「先進製造業」範疇，且就聯席保薦人所知，概無任何重大情況表明上述董事的意見不合理。

業務模式與營運流程

我們的平台由一套專業軟件模塊組成，旨在優化各類生產與運營管理流程，各平台均整合了硬件與軟件。我們的解決方案以項目為基礎，客戶可選擇性部署個別軟件模塊以強化新建及／或現有設施，或採用多平台軟件集成解決方案套件進行設施開發，所有配置均按照客戶的特定數字轉型及先進製造目標而量身打造。

作為IMSS服務提供商，我們以項目為基礎的模式為客戶提供全面的服務，將我們自主開發的軟件服務與外部採購的硬件及配套材料相結合。於往績記錄期間，我們自供應商採購的硬件及配套材料包括服務器、控制器、KVM、自動導引車及儲存設備等。網絡線材亦作為我們項目的配套材料採購，主要用以協助建設我們核心產品的數據傳輸渠道。

業 務

我們按項目制模式經營業務，原因是我們的服務涵蓋項目設計、諮詢及解決方案、軟件整合、現場實施、測試及維護。在項目制業務模式下，硬件及配套材料乃自外部採購，用於與我們的解決方案系統對接，並作為輔助載體以促進項目實施。所有自外部採購的硬件均與我們以軟件為核心的解決方案密不可分，原因在於該等硬件並非本公司供轉售的獨立產品－客戶所購買者為用於其生產或設備產品的一體化操作系統，而非單獨的設備。硬件作為實體執行層使用，我們的軟件產品須倚賴該執行層以感知、控制生產過程。我們的軟件產品透過協調數據、決策及工作流程創造價值（作為決策的「大腦」），而該等價值僅可透過硬件的信號及執行器（用於執行移動或動作）予以實現及落地。

儘管硬件乃向第三方供應商採購，惟該等硬件由本公司挑選，且通常由我們進行校準、修改及調整（詳情於下文進一步闡述），以嵌入我們的軟件產品及解決方案，故該等硬件成為我們向客戶銷售的一體化工程系統的一部分。倘無有關軟件，硬件將無法提供客戶付費購買的能力、功能及成果；倘無有關硬件，軟件將缺乏可供控制或分析的生產環境，以呈現或展示客戶所要求的規格。

根據弗若斯特沙利文的資料，基於市場參與者的公開資料及專家訪談，IMSS市場參與者通常以整合硬件及軟件的解決方案為基礎披露收入，此乃行業慣例，反映了彼等的業務性質，以及單獨披露純軟件收入並不切實際。

我們早在研發階段便採購硬件作研發用途（而非嵌入我們的軟件產品中向客戶出售的硬件），以便與我們的軟件解決方案及早進行快速整合及驗證。研發過程涉及預先挑選合適的硬件以進行開發及適配，使我們能夠制定一套硬件計算規則。藉此，我們能夠於早期階段識別兼容性問題（如驅動程序衝突、延遲或數據吞吐量瓶頸）。此舉可防止出現「軟硬件不匹配」的情況，否則有關問題可能僅會於項目實施階段方被發現及補救，繼而引致項目開發成本增加及項目交付延誤的風險。於研發階段經校準的硬件亦有助提升我們整體服務的質量與效能，此乃因為我們的研發團隊能夠根據測試及開發結果了解並釐清硬件要求，從而確保與我們的軟件產品實現無縫整合。研發完成後，我們將就特定硬件制定一套基準規則，以供於項目實施階段的銷售項目中採用及適配。

於項目實施階段，當我們獲客戶聘用，且須將特定硬件或特定規格的硬件整合至客戶的定制項目中時，我們會就特定項目採購硬件。根據我們於研發階段制定的基準規則，特定項目所需的硬件規格將由我們界定或計算，並根據客戶的工廠規模及其他要求為客戶量身定制。為落實並確保硬件與我們的軟件產品相互整合，作為與客戶項目藍圖設計的一部分，我們將建議或決定將予採購的具體硬件。

外部採購的硬件通常由我們的供應商直接交付至客戶指定的地點。交付至客戶現場後，倘我們認為有必要，我們的研發團隊或技術人員將對硬件進行進一步校準、調整及修改，以最能配合我們的軟件產品，從而滿足客戶的特定要求。硬件的核心定制校準、調整及修改通常包括以下各項：

1. **底層協議適配：**對工業控制主機、現場採集終端、工作站一體機及邊緣網關等硬件的底層驅動及串行／網絡通信模塊進行固件二次開發及定制修改。

業 務

2. **數據採集及控制功能集成：**設備及硬件將內置數據採集點、輸入／輸出控制接口及邊緣計算程序，以便與我們的CIM系統更好地集成以進行數據採集。
3. **物理適配：**可能對裝置、支架、外殼、佈線或工具頭進行修改，以適應客戶的工藝、空間或環境條件。

我們的軟件產品通常透過線上分發及實體物流交付予客戶，軟件產品會在客戶驗收前進行安裝、測試及優化。鑒於上述情況，我們為客戶提供的服務包括並涵蓋我們對外部採購硬件的增值。我們為客戶採用此軟硬件一體化解決方案的理由及優勢如下：

- **最大程度減少跨多供應商的兼容性問題：**硬件－軟件集成項目模式旨在彌合數字代碼與物理機械之間的差距，因為軟件協議應與設備和機械兼容。作為項目制服務供應商，我們確保硬件早在研發階段就已預先配置，以配合我們的軟件產品使用，避免通信故障或數據延遲；
- **性能優化：**針對特定軟件算法校準、修改或調整定制硬件，從而根據客戶的生產過程及其設備的性能優化軟件功能和用途；
- **簡化採購：**從項目談判過程中客戶的角度來看，彼等通常更喜歡一站式供應商，為他們的工廠設立或升級提供簡化的服務及產品採購，從而減輕行政負擔、簡化故障排除以及提高數據完整性及安全性；
- **預裝及測試：**我們於實驗室為研發目的構建、組裝及測試整個集成系統，而軟件產品則將通過線上分發或直接於客戶場地交付予客戶，以嵌入硬件，其後方會於客戶的廠區內推出及執行軟硬件一體化系統。該「即插即用」的模式最大程度地減少現場安裝時間和生產停機時間。

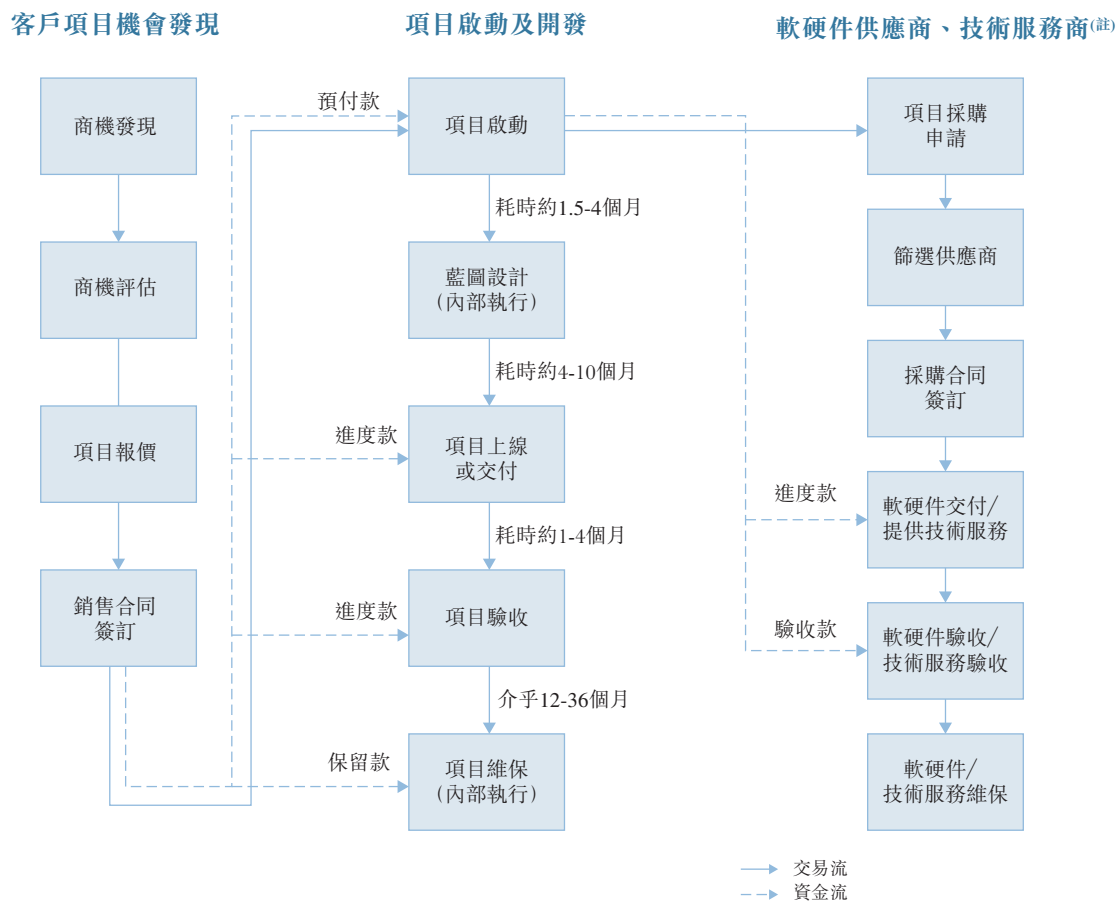
鑒於上文所述，本公司並未從事直接轉售自供應商購買的硬件。向客戶提供該等硬件及配套材料並未被劃分為獨立業務分部。

基於上述分析（即所有外部採購的硬件均不可與我們以軟件為中心的解決方案分割，且本公司並無從事直接轉售從供應商採購的硬件），我們的董事認為，IMSS符合上市規則第18C.03(4)條項下的特專科技業務分部資格，且聯席保薦人並不知悉任何重大情況顯示董事上述觀點屬不合理。

我們亦就我們的軟件解決方案向客戶提供維護服務，確保其持續穩定運作與進一步升級，包括提供交付IMSS產品及服務後的後續技術支持或其他客戶服務。維護服務基於客戶需求在線上或現場提供。

業 務

下圖顯示我們IMSS的運營流程及外包服務供應商的角色：



附註：我們自供應商採購軟硬件，包括服務器及存儲設備等硬件及設備，以及涉及外包非核心軟件模塊及提供現場技術服務的技術服務。詳情請參閱下文「我們的供應商」。

我們IMSS的項目涉及由我們的銷售人員發掘項目機會，其後進行商機評估及報價。與客戶簽訂銷售合同後，我們通常要求客戶預付協定百分比的項目費用。項目啟動後，我們通常需時1.5至4個月與客戶準備、協商、修改及落實項目藍圖計劃。於此階段，我們將啟動並與客戶討論項目藍圖計劃，當中採用我們挑選或推薦的解決方案及硬件。藍圖計劃可根據客戶的反饋進行更改或修改，在此過程中，我們可能向其推薦或比較我們軟件模塊及硬件的不同組合使用方案。項目通常在確認藍圖計劃後約4至10個月上線。根據協定藍圖計劃進行現場實施及測試通常需時1至4個月，在此期間，我們根據藍圖計劃為客戶設計、開發及採用我們的解決方案模塊。我們通常在藍圖或設計獲接納或項目上線或交付後要求支付進度款。驗收後，客戶須支付剩餘的合同金額（保留款（如有）除外）。一般而言，收入及成本於客戶驗收後確認。維護期（通常介乎12至36個月）將於驗收後開始，而剩餘的保留款將於維護期屆滿後支付。

業 務

我們主要按項目制模式向客戶收取IMSS產品及服務費用，據此，我們按項目基準向其收取固定的總價。我們解決方案的定價通常基於研發投資、營運成本、市場狀況及軟件解決方案功能而釐定。詳情請參閱下文「一定價」。

我們五大平台項下的核心軟件產品

生產運營平台

CIM系統中我們生產運營平台項下的軟件產品旨在對整個生產過程進行管理及控制。我們在該平台的核心解決方案包括：(i)製造執行系統(MES)；(ii)質量管理系統(QMS)；(iii)實時排產(RTD)及(iv)高級計劃排產(APS)。

製造執行系統(MESwell®)

MESwell®系統實時管理、監察、追蹤及控制車間內從原材料到製成品的製造運營。它充當智能工廠的中樞神經系統，連接機器、操作員和更高級別的業務系統，以便可以根據實時數據執行、控制和持續改進生產。就半導體企業而言，MESwell®可精確追溯各個晶圓的加工歷史並提供異常情況的解決方案，從而確保生產高效穩定。

質量管理系統(QMS)

QMS是一個用於標準化泛半導體行業的質量控制流程的系統，涵蓋供應商資質確認、來料檢驗、過程中質量控制、最終檢驗、出廠質量保證、不合格品處理，以及客戶投訴解決方案。

實時排產(RTD)

RTD是根據車間的當前、實時狀態自動、連續地將生產工作（訂單、批次、任務）分配和重新分配給機器和操作員。它專為8寸和12寸晶圓廠設計，實現生產運營中的自動化和智能管理。

通過預先錄入生產計劃／規則及排產規則至系統，RTD將生產數據與生產設備實時狀態相結合。當有生產調度需求時，RTD實時計算最優批次，自動生成調度命令（運輸指令），下發至物料控制系統(MCS)，實現全自動化生產調度及運輸。

高級計劃排產(APS)

APS是使用實時數據和高級算法的系統，根據機器、勞動力、材料和客戶需求等實際限制條件，創建切合實際、優化的生產計劃和短期計劃。該系統將生產績效與計劃整合，並根據製造執行反饋進行動態調整，從而制定合理的生產計劃。

集成自動化平台

CIM系統中我們集成自動化平台項下的軟件產品旨在實現全廠自動化及設備與物料控制的連通。我們集成自動化平台的核心解決方案包括：(i)設備自動化系統(EAP)、(ii)配方管理系統(RMS)、(iii)區塊控制系統(BC)及(iv)物料控制系統(MCS)。

業 務

設備自動化系統(EAPwell®)

EAPwell®是一套通過設備直連強化製程管理的系統。它將製造設備(機器、機器人、傳感器)與MES等更高級別系統之間的通信、控制和數據交換自動化，實現無縫集成和實時車間自動化。

主要功能包括採集生產參數、機器性能數據及檢測結果，實現製程自動化並減少人為失誤。

配方管理系統(RMS)

RMS是一個用於創建、存儲、版本控制及安全分發生產參數(配方、參數及工藝指令)至製造設備和MES系統的系統。其通過設備自動化系統(EAP)上載和驗證參數數據，並對照預定義標準交叉檢查參數規格，以防止因參數偏差而導致質量問題，從而確保精確的生產參數準確性。「黃金配方」功能可確保同類設備均應用最優參數。

區塊控制系統(BC)

BC連接流水線設備(如PLC和機械臂)，並實現流水線內生產的自動化控制。其協調並同步一個生產區塊(生產線的一個獨立部分)內的多台互連的機器或工作站。EAP專注於單個設備，實現單一機器或機器人的控制和數據交換自動化，而BC則管理一組設備(即一個區塊)，將多台互連的機器作為一個單元進行協調，從而使整個生產過程的流程和操作保持同步。

物料控制系統(MCS)

MCS跟蹤、管理並優化從參數設定到生產再到製成品的原材料、在製品和組件的流向，確保供應充足而無過量庫存。MCS作為物料控制的物流大腦，通過統一協議將來自多個供應商的跨品牌、跨類型的多種物料搬運設備進行集成，解決不同系統之間的互通性挑戰，實現全自動化、跨設備無縫協調，通過減少設備閒置時間及縮短生產週期優化物料流。

智控數字平台

我們的智控數字平台項下的軟件產品透過統一入口平台(訪問所有系統的單一門戶登錄入口)促進中央控制室的設立，人員可監控工廠車間，並通過遠程集中系統執行任務，以提高中控人員的執行效率，協助管理者決策。我們智控數字平台的核心解決方案包括：(i)黑燈工廠助理(LOFA)-PCC/RCM、(ii) LOFA-Bots/RPA及(iii) LOFA-AI/ADC。該平台項下的哥瑞利工業通用智能(GloryIGI)，預計將於2026年6月商業上線。

「黑燈工廠」並非指沒有實體照明的設施，而是象徵一種高度智能化的生產模式，其無需現場人員監控或人工巡檢。此模式的核心變革在於將人員從生產車間遷移至燈塔控制中心，通過自動化設備及自動化生產管理系統管理工廠運營，而工作人員則由中控中心遠程監控生產狀態並處理異常情況。

業 務

LOFA是全自動化工廠中控中心的統一入口，集成了可視化、控制、知識管理、技能組件、自動化流程執行及AI識別與分析等工廠管理需求，旨在打造工廠運營的智能中控人工智能樞紐。LOFA利用AI的圖像識別技術，如光學字符識別、目標檢測、圖像分類、模版匹配及圖像特徵識別、量測及定位，攻克了缺陷自動分類、缺陷位置檢測及界面字符識別等技術難題，最終在整個工作流程實現高精度無人實時自動運作，不干擾工作流，亦無數據外洩風險。

LOFA-PCC/RCM

遠程控制管理(RCM)能夠實時擷取來自人機界面(作為人與機器或系統之間的交互點)、視覺傳感器及物理控制終端的整體資料串流，以實現對工廠設備、流程及系統進行集中、遠程監控、診斷及控制。

LOFA-Bots/RPA

機器人流程自動化(RPA)旨在模仿人類行為以提供由生產初始階段至最終產出的業務自動化，依托智能化技術，「替代人」進行重複性、低價值及規則明確的工作流程，通過自動化執行固定流程提升運營效率並降低錯誤率。

LOFA-AI/ADC

自動缺陷分類(ADC)旨在自動定位和分析檢測工具中的缺陷圖像，以按類型、嚴重程度和根本原因對缺陷(如圖像中的劃痕、裂紋或變色)進行分類。其可應用於圖像相關檢測設備的生產流程，主要旨在透過機器學習取代人工審核，提升設備的缺陷檢出率，以及降低不良品及人力成本。

哥瑞利工業通用智能(GloryIGI)

GloryIGI是我們為泛半導體行業量身定制的解決方案，其旨在通過AI驅動的解決方案推動整體智能化轉型，其通過整合累積的行業知識、數據資產及整個系統互操作性，提升運營效率並加速創新。憑藉將技術與特定垂直場景相結合，GloryIGI旨在於從流程優化到決策智能的關鍵製造工作流程中實現精準價值。

智能大數據引擎平台

我們的智能大數據引擎平台項下的軟件產品以智能算法、大數據分析及機器學習為核心，收集及分析來自CIM系統的數據，以進一步優化流程，從而提升精度及良率；及為核心工業應用提供智能決策支持。我們的核心解決方案包括：(i)良率管理系統(YMS)、(ii)故障檢測與分類(FDC)系統。此外，於往績記錄期間，虛擬量測(VM)和設備健康管理(EHM)正在研發中，預計將於2026年6月商業上線。

業 務

良率管理系統(YMS)

YMS是一個收集、處理及分析生產數據(尤其是缺陷、計量及工藝指標)的分析系統，用於優化泛半導體行業的生產良率及質量控制。YMS利用人工智能驅動的大數據分析及與MESwell®集成，實時監控多站點運營的良率指標、缺陷模式和工藝偏差。該系統集成多源數據(例如設備參數、缺陷圖和測試結果)，將被動的質量管理轉變為主動的預測性洞察，確保符合嚴格的行業標準，同時盡量減少廢品和運營效率低下的情況。

故障檢測與分類(FDC)系統

FDC系統旨在監控設備傳感器數據(如溫度、壓力、振動)的穩定性，通過多源數據採集、統計分析、和建模實時檢測工藝偏差並自動識別其根本原因，旨在防止半導體晶圓廠的良率損失和停機。

FDC及ADC均與缺陷或故障檢測及分類有關，FDC和ADC針對半導體工作流程中的不同階段和數據類型，FDC專注於通過實時傳感器遙測檢測設備／工藝故障(如傳感器漂移)，以防止缺陷(在缺陷發生之前)，而ADC檢測物理缺陷(例如顆粒)並通過成像進行被動式缺陷分析(在缺陷發生之後)。

虛擬量測和設備健康管理(VM&EHM)

VM為一種AI驅動的軟件解決方案，旨在自MESwell®、FDC及EAP系統收集及處理設備參數(例如溫度、壓力)、工藝步驟及測量數據，以構建預測模型並通過將設備及工藝參數與統計及機器學習模型相結合，預測產品特性(如薄膜厚度、阻抗、線寬)，而無需執行完整的物理計量步驟。VM旨在實現對生產晶圓進行100%虛擬檢測，取代傳統的抽樣方法。

EHM是一個預測分析軟件產品，可通過實時參數分析持續監控設備性能指標(如振動、溫度、壓力、吞吐量)，以評估工具「健康狀況」(例如運行狀況)、預測設備性能下降及故障並優化維護計劃。

VM及EHM採用相同的底層建模工具，預計將於我們的智能大數據引擎平台內協同運作。VM通過虛擬化物理檢查和優化工藝參數專注於產品質量保證，而EHM旨在通過預測運行狀況管理確保設備可靠性。它們共同構成一個系統，當中系統某一部分的反饋將被用於持續改善及優化另一部分，從而創建實時數據整合及糾正措施的循環：VM的實時過程數據將提高EHM的預測準確性，而EHM的設備運行狀況洞察將保障VM的運營連續性。

數字化設備平台

我們數字化設備平台項下的軟件產品實現工業設備之間的數據交換及數據轉換，從而實現生產過程中的設備自動化控制。彼等協助設備製造商開發更符合半導體行業標準的設備，並可與我們的CIM系統順利整合及互通。我們的核心解決方案包括：(i) 集群工具架構(CTF)、(ii) 設備通訊轉換模塊(iEQ)及(iii) 工藝設計與仿真(PDS)。

業 務

集群工具架構(CTF)

CTF專為半導體設備設計，用於多台設備組成的生產線以整合及控制設備內的多項組件。

設備通訊轉換模塊(iEQ)

iEQ為泛半導體行業企業提供工業設備之間的數據交換服務。該軟件產品能夠將來自不同設備數據交換協議（例如PLC（可編程邏輯控制器））的原始數據實時轉換及翻譯為標準的SECS/GEM協議，同時與上層CIM系統建立無縫整合。

工藝設計與仿真(PDS)

PDS平台是一款用於優化半導體製造流程的仿真和校正工具。其指數字化模擬半導體製造步驟（注入、蝕刻、沉積、光刻、熱處理）的流程建模工具，以在實際運行前預測結果、優化產品參數並縮短開發週期。該平台可對工藝設計、設備整合和生產工作流程方面進行建模和分析，解決光刻和製造中的關鍵挑戰。

我們系統模塊的應用場景

為更充分說明泛半導體行業各領域客戶如何從我們覆蓋廣泛業務場景的行業專屬軟件解決方案服務中獲益，我們產品在客戶業務中的應用場景展示如下：

Glorysoft

案例研究：生產運營平台 + 集成自動化平台 + 智控數字平台

我們向客戶XX提供基於生產運營平台、集成自動化平台及智控數字平台的解決方案，帶來以下益處：

提高生產效率

我們的解決方案與客戶新設備的協同效應，使單台機器的運行效率實現質的飛躍。例如，新焊線機的作業速度從18線／秒提升至22線／秒，新固晶機上芯片框架產品的最大走線寬度由70毫米以下提升至100毫米。於生產高峰期的整體勞動生產力提高了14%。我們的解決方案使客戶的製造系統可適應不同規格芯片封裝的測試需求，可靈活調整生產任務而無需停機，從而進一步提升產線的整體經營效益。

業 務

優化成本及交付週期

該客戶於生產高峰期實現18%的節能成效，顯著降低芯片封裝與測試等高耗能生產階段的能源支出。訂單履約方面，封裝訂單週期縮短45%，能迅速回應無人機與新能源汽車等產業對功率元件的緊急訂單需求，從而加強下游客戶協作與忠誠度。

加強產品質量控制

產品質量可準確追溯至物料、工具／夾具、設備、人員及生產時間等關鍵要素。這種由生產初始階段至最終產出的全面追溯能力可以快速識別質量問題的根本原因並減少瑕疵產品。客戶的精益生產管理及質量精準追溯場景入選2023年工業和信息化部智能製造優秀場景名單。

管理模式數字化轉型

客戶的生產流程已實現可視化與數字化管理。其員工可直接在電腦屏幕上查看實時數據，無需穿梭整個車間即可進行生產監控與問題排除，大幅降低管理難度，並將管理中的人為錯誤減至最低。



案例研究：集成自動化平台 + 智能大數據引擎平台

我們協助客戶YY建立5G+工業專用網絡及工業互聯網平台，整合系統打造智能工廠，幫助客戶在生產效率、成本管控、產品品質及協同效應方面獲得效益。具體效益如下：

生產與研發效率的雙重提升

新顯示設備智能製造工業互聯網平台提升該客戶的生產效率。同時，藉助5G+工業互聯網的「1+1+N」體系，智能產線及設備維護效率亦提升，消除了長期停機維修狀況，並確保產線穩定運行。

研發方面，取得重大成果：通過智能平台的數據協同，產品開發週期縮短15%。經客戶YY確認，採用我們的解決方案，加上其在研發上的投入，有助於其在新顯示領域的關鍵核心技術方面實現突破。

業 務

加強產品質量及生產控制

通過我們的解決方案，客戶YY實施5G工業高清可視化質量檢測等應用，使產品不良率下降，並將產線良率穩定提升至98%以上。

同時，基礎設備通過BC與我們的其他解決方案進行數據互聯，實現從設計、生產、質檢等環節的全面數據可追溯性。透過FDC數據模擬進行質檢，快速識別品質問題得以實現，同時利用動態產線調度等功能，靈活適應生產需求。這從根本上改變了傳統的被動生產控制方法。



案例研究：數字化設備平台

我們向客戶ZZ（一家半導體光刻設備製造商，其終端客戶包括芯片廠）提供我們數字化設備平台CTF及iEQ。其在國產替代半導體設備中應用我們的解決方案，實現設備自主。

該客戶在設備研發階段購買我們的解決方案。客戶ZZ在使用我們的平台前，為其設備購買了我們競爭對手的解決方案產品，該產品的功能與CTF類似。客戶選擇購買我們的解決方案，是考慮到本集團具有成本效益促進國內生產的能力，以及我們提供符合客戶需求的技術支持。

我們的平台應用於客戶的先進面板級封裝設備（包括雙機械臂）。客戶ZZ在實施我們的解決方案後，取得以下效率：(i)在實施中控方面，雙機械臂的複雜度高於傳統的單機械臂，並調整了三機械臂的版本，實現更大的實用性；(ii)應用我們的平台可實現對客戶設備的多模組集成控制；及(iii)我們的平台滿足客戶的設備傳輸效率要求及其封裝效率。

該客戶已通過比較成本預算數據與最終利潤計算進行成本效益分析。其亦透過比較競爭對手之一（即客戶ZZ的另一供應商）所提供的軟件對生產效率改善作出分析。據客戶ZZ確認，與使用競爭對手的產品相比，其取得約30%的成本效益優勢。

業 務

收入、毛利及毛利率明細

按貨品及服務類型劃分的收入、毛利及毛利率

下表載列於往績記錄期間按貨品及服務類型（即IMSS及維護服務）劃分的收入、毛利及毛利率明細，以所示年度的絕對金額及佔總收入百分比列示：

	截至12月31日止年度											
	2023年				2024年				2025年			
	收入		毛利		收入		毛利		收入		毛利	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
IMSS												
—CIM軟件解決方案 ^{附註}	136,875	82.7	29,978	21.9	195,477	78.5	45,203	23.1	214,931	71.6	32,240	15.0
—智控數字平台.....	20,505	12.4	1,587	7.7	44,657	17.9	10,624	23.8	41,379	13.8	3,956	9.6
—智能大數據引擎平台.	217	0.1	14	6.5	3,052	1.2	1,488	48.8	23,566	7.8	6,890	29.2
—數字化設備平台.....	6,180	3.8	200	3.2	3,412	1.5	(656)	(19.2)	18,359	6.1	7,762	42.3
IMSS小計.....	163,777	99.0	31,779	19.4	246,598	99.1	56,659	23.0	298,235	99.3	50,848	17.0
維護服務.....	1,717	1.0	1,240	72.2	2,293	0.9	534	23.3	2,106	0.7	860	40.8
總計.....	165,494	100.0	33,019	20.0	248,891	100.0	57,193	23.0	300,341	100.0	51,708	17.2
虧損合約撥備淨額.....			(3,057)				(9,196)				(1,741)	
存貨減值虧損淨額.....			(24,258)				(15,247)				(7,327)	
總計.....			5,704	3.4			32,750	13.2			42,640	14.2

附註：包括生產運營平台及集成自動化平台

按客戶經營所在下游領域劃分的收入、毛利及毛利率

下表載列於往績記錄期間按客戶經營所在下游領域劃分的收入、毛利及毛利率明細，以所示年度的絕對金額及佔總收入百分比列示：

	截至12月31日止年度											
	2023年				2024年				2025年			
	收入		毛利		收入		毛利		收入		毛利	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
半導體.....	76,552	46.3	10,864	14.2	78,591	31.6	17,050	21.7	124,803	41.6	22,688	18.2
顯示面板.....	54,125	32.7	15,123	27.9	104,882	42.1	26,529	25.3	83,697	27.9	20,950	25.0
印刷電路板.....	15,652	9.4	6,248	39.9	48,155	19.3	9,132	19.0	64,580	21.5	6,462	10.0
光伏.....	19,165	11.6	784	4.1	17,263	7.0	4,482	26.0	27,261	9.1	1,608	5.9
總計.....	165,494	100.0	33,019	20.0	248,891	100.0	57,193	23.0	300,341	100.0	51,708	17.2

業 務

	截至12月31日止年度											
	2023年				2024年				2025年			
	收入		毛利		收入		毛利		收入		毛利	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
虧損合約撥備淨額.....			(3,057)				(9,196)				(1,741)	
存貨減值虧損淨額.....			(24,258)				(15,247)				(7,327)	
總計			<u>5,704</u>	3.4			<u>32,750</u>	13.2			<u>42,640</u>	14.2

按客戶地理位置劃分的收入、毛利及毛利率

下表載列於往績記錄期間按客戶地理位置劃分的收入、毛利及毛利率明細，以所示年度的絕對金額及佔總收入百分比列示：

	截至12月31日止年度											
	2023年				2024年				2025年			
	收入		毛利		收入		毛利		收入		毛利	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
中國內地.....	164,583	99.4	32,203	19.6	246,554	99.1	56,123	22.8	296,339	98.7	49,467	16.7
其他*	911	0.6	816	89.6	2,337	0.9	1,070	45.8	4,002	1.3	2,241	56.0
總計	<u>165,494</u>	<u>100.0</u>	<u>33,019</u>	<u>20.0</u>	<u>248,891</u>	<u>100.0</u>	<u>57,193</u>	<u>23.0</u>	<u>300,341</u>	<u>100.0</u>	<u>51,708</u>	<u>17.2</u>
虧損合約撥備淨額.....			(3,057)				(9,196)				(1,741)	
存貨減值虧損淨額.....			(24,258)				(15,247)				(7,327)	
總計			<u>5,704</u>	3.4			<u>32,750</u>	13.2			<u>42,640</u>	14.2

* 主要包括東南亞及中國台灣地區。

有關我們的收入、毛利及毛利率波動的原因，請參閱「財務資料－綜合損益表的主要組成部分」及「經營業績的期間比較」。

業 務

本集團解決方案的軟件及硬件組件的收入、毛利及毛利率

下表載列於往績記錄期間所示年度，按本集團解決方案的軟件及硬件組件劃分的收入、毛利及毛利率明細。誠如本文件「業務－我們的五大平台及提供的解決方案－業務模式與營運流程」一節所披露，我們以項目為基礎的模式開展業務，據此我們從外部各方採購硬件及配套材料，並將其與我們的解決方案系統對接，作為輔助載體以促進項目實施。所有外部採購的硬件與本集團以軟件為中心的解決方案不可分割，因為該等硬件並非本公司作轉售用途的獨立產品。下表乃基於下文附註所載的假設編製，僅供說明：

截至12月31日止年度																	
2023年						2024年						2025年					
收入			毛利		毛利率	收入			毛利		毛利率	收入			毛利		毛利率
人民幣千元	%		人民幣千元	%	%	人民幣千元	%		人民幣千元	%	%	人民幣千元	%		人民幣千元	%	%
硬件 ...	45,988	27.8	3,822	11.6	8.3	77,028	30.9		6,986	12.2	9.1	60,824	20.3		4,985	9.6	8.2
軟件 ...	119,506	72.2	29,197	88.4	24.4	171,863	69.1		50,207	87.8	29.2	239,517	79.7		46,723	90.4	19.5
總計 ...	165,494	100.0	33,019	100.0	20.0	248,891	100.0		57,193	100.0	23.0	300,341	100.0		51,708	100.0	17.2

附註：

為呈列本集團解決方案內硬件及軟件組件的收入、毛利及毛利率明細，我們基於以下數據層級應用了一致的分配方法：

1. 合約規格：收入首先根據我們與客戶訂立的若干相關服務合約中明文規定的硬件組件特定費用進行分配；
2. 項目預測：對於服務合約中未有明確訂明硬件費用，但在委聘開始時已編製內部項目預算或收入預測的項目，收入乃根據內部項目預算或收入預測所訂明的硬件組件價格佔項目預算總價的比例進行分配；及
3. 成本加成估計：在缺乏特定合約定價或內部項目預測的情況下，硬件組件的收入按成本加成法得出。這涉及對各項目產生的實際硬件成本應用合理的估計利潤率（參考上文附註1及2所計算於往績記錄期間實現的平均毛利率得出）。

我們的項目詳情

我們的主要項目

下表載列於往績記錄期間按已確認收入計的五大項目詳情：

截至2023年12月31日止年度

所提供解決方案	開始日期	完成日期	實施地點	獲取項目 的方式	合約金額 (含稅) (人民幣千元)	年度 已確認收入 (人民幣千元)
---------	------	------	------	-------------	-------------------------	------------------------

1. 客戶B，位於四川，主要從事半導體產品的開發和製造，包括集成電路及相關技術。
CIM軟件解決方案 2021年9月 2023年3月 成都 投標 31,080 28,507

業 務

所提供解決方案	開始日期	完成日期	實施地點	獲取項目 的方式	合約金額 (含稅) (人民幣千元)	年度 已確認收入 (人民幣千元)
2. 客戶集團A旗下的一家公司，位於重慶，專門從事半導體顯示設備及相關產品的研發、製造及銷售。 集成自動化平台	2022年3月	2023年10月	重慶	直接磋商	10,170	9,000
3. 客戶集團C旗下的一家公司，位於廣東，提供軟件、自動化、雲服務及光伏技術。 集成自動化平台	2022年2月	2023年6月	廣州	投標	8,162	7,700
4. 客戶集團A旗下的一家公司，位於重慶，專門從事半導體顯示設備及相關產品的研發、製造及銷售。 智控數字平台	2020年12月	2023年8月	重慶	直接磋商	5,800	5,133
5. 客戶集團C旗下的一家公司，位於湖北，專門從事工業自動化設備及元件的研發和銷售，以及計算機硬件及軟件的技術開發和銷售。 生產運營平台	2022年7月	2023年3月	武漢	投標	5,105	4,816

截至2024年12月31日止年度

所提供解決方案	開始日期	完成日期	實施地點	獲取項目 的方式	合約金額 (含稅) (人民幣千元)	年度 已確認收入 (人民幣千元)
1. 廈門天馬顯示科技有限公司，位於福建，主要從事顯示技術的生產和銷售。 智控數字平台	2021年11月	2024年7月	廈門	直接磋商	34,465	30,500
2. 客戶F，位於廣東，主要從事PCB產品的研發、生產及銷售。 集成自動化平台	2023年6月	2024年4月	廣州	投標	18,500	16,372
3. 廈門天馬顯示科技有限公司，位於福建，主要從事顯示技術的生產和銷售。 集成自動化平台	2022年1月	2024年1月	廈門	直接磋商	17,402	15,400
4. 一家位於四川的客戶，提供顯示屏及光子器件製造。 CIM軟件解決方案	2022年3月	2024年12月	綿陽	投標	11,300	10,000
5. 客戶集團A旗下的一家公司，位於北京，提供數字技術服務和工程解決方案。 集成自動化平台	2022年9月	2024年3月	重慶	直接磋商	5,978	5,290

截至2025年12月31日止年度

所提供解決方案	開始日期	完成日期	實施地點	獲取項目 的方式	合約金額 (含稅) (人民幣千元)	年度 已確認收入 (人民幣千元)
1. 客戶G，位於汕頭，主要從事電路板、層壓板及封裝基板的生產。 CIM軟件解決方案	2021年9月	2025年5月	汕頭	直接磋商	14,000	12,389
2. 客戶H，位於濟南，主要從事軟件開發及顯示設備和電子產品的銷售。 智控數字平台	2024年12月	2025年4月	北京	直接磋商	13,135	11,747
3. 客戶I，一家位於中國的科研機構，主要從事半導體設備的設計、開發及生產。						

業 務

所提供解決方案	開始日期	完成日期	實施地點	獲取項目 的方式	合約金額 (含稅) (人民幣千元)	年度 已確認收入 (人民幣千元)
數字化設備平台	2024年12月	2025年12月	長沙	直接磋商	9,600	9,057
4. 客戶集團A旗下的一家公司，位於廣東，專門從事半導體照明裝置及集成電路芯片的研發、生產與銷售。						
CIM軟件解決方案	2024年5月	2025年11月	珠海	直接磋商	8,925	8,400
5. 位於新疆的一名客戶，主要從事硅基新材料的研發、生產及銷售。						
CIM軟件解決方案	2023年12月	2025年3月	新疆	直接磋商	15,000	8,357

我們的未完成項目

下表載列於往績記錄期間按訂單價值及合約數目計算的IMSS未完成合約變動：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
期初未完成訂單⁽¹⁾			
訂單價值(人民幣千元)	366,855	386,997	375,947
合約數目	239	243	228
期內新增訂單⁽¹⁾			
訂單價值(人民幣千元)	199,486	235,056	313,982
合約數目	237	260	298
當期已確認收入－來自期初			
 未完成訂單⁽¹⁾			
已確認收入(人民幣千元)	146,928	224,457	179,438
合約數目	144	166	184
期內已確認收入－來自期內			
 新增訂單⁽¹⁾			
已確認收入(人民幣千元)	16,849	22,141	118,797
合約數目	90	113	170
期末未完成訂單⁽¹⁾			
訂單價值(人民幣千元)	386,997	375,947	378,884
合約數目	243	228	180

附註：

- (1) 年初未完成訂單加年內新增訂單，減去年初未完成訂單的年內已確認收入及期內新增訂單的期內已確認收入(以價值及合約數目計)的總額，不等於期末未完成訂單，主要因為(i)若干訂單橫跨多個財政年度，且未於本年度內悉數執行；(ii)於本年度有若干訂單被取消或終止；及(iii)於本年度的工單和指示有所不同。

截至最後實際可行日期，IMSS未完成合約為186份，未完成訂單總額為人民幣431.3百萬元。

業 務

我們提前終止／虧損及暫停的項目

下表載列於往績記錄期間的提前終止及／或虧損項目數量及其所產生的相關虧損：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	項目數量	虧損金額 ⁽¹⁾ (人民幣千元)	項目數量	虧損金額 (人民幣千元)	項目數量	虧損金額 ⁽³⁾ (人民幣千元)
提前終止 ⁽¹⁾	4	-	-	-	1	-
虧損 ⁽²⁾	58	4,082.4	69	3,800.9	68	15,734.4

附註：

- (1) 提前終止項目是指在項目驗收完成前已簽訂終止協議的項目。
- (2) 虧損項目是指就項目在某一年度確認的收入減該項目於該年度的商品及服務銷售成本為負的已確認收入的已驗收項目。
- (3) 於2023年及2025年提前終止而未造成虧損是由於該等項目尚未實際實施。

我們於2023年及2025年分別有四個及一個提前終止的項目，據董事所知，主要由於(i)客戶的硬件或設備不兼容導致我們的軟件解決方案終止實施；及(ii)客戶的資金問題。於往績記錄期間，我們有虧損的項目，此乃主要由於(i)探索新業務類型的業務策略及具有戰略價值而合同費用相對較低的客戶；及(ii)在項目實施過程中客戶要求或其運營條件發生變化。特別是，於2025年，我們於客戶G的一個項目產生虧損約人民幣3.7百萬元，該項目為國內PCB行業首個實現物聯網集成CIM系統的項目。我們出於戰略業務發展目的提供相對較低的合同費用，以及由於評估首個此類性質項目的初始成本存在實際困難，我們在項目啟動期間產生額外成本。

截至2023年12月31日止年度，我們有四個項目在項目實施過程中因客戶要求或其經營狀況變化而暫停。截至2023年12月31日止年度錄得與該等暫停項目相關的存貨減值虧損為人民幣5.6百萬元。除截至2023年12月31日止年度的四個暫停項目外，於往績記錄期間，並無其他暫停項目。於最後實際可行日期，其中一個已暫停項目已完成最終驗收，一個已暫停項目仍在進行中，另外兩個已暫停項目正進行收回款項程序。

業 務

我們智能製造軟件解決方案內嵌的核心技術

技術是我們業務運營的基石，對我們實現持續業務增長不可或缺。經過多年的自主研發，我們已持續開發出多項核心技術，使我們能夠在先進製造業領域提供解決方案。我們的核心技術包括：

核心技術	軟件解決方案	說明及優勢	目標應用行業
製造工藝 管理	MES	該技術為12寸前道18納米半導體晶圓廠的複雜工藝的製造管理提供支持。其特點包括：(i)採用統一的高性能Framework平台架構，易於擴展及管理，確保與周邊應用系統的無縫集成；及(ii)服務器端採用成熟的J2EE架構。該技術可實現邏輯生產、可追溯性、穩定性、流程整合及精細的批次數據，提供可擴展性、靈活性和可維護性，滿足企業軟件對高可用性、可靠性和可擴展性的要求。	半導體、顯示面板、PCB及光伏行業
AI	GloryIGI及 LOFA-AI/ ADC	該技術主要涉及算法、數據模型及數據處理系統。通過機器學習、深度學習和自然語言處理等技術，它旨在賦予生產設備感知操作環境、解讀指令、執行自主決策和驅動程序創新的能力。這項設計使生產經理能夠解決複雜的運營挑戰，提高工作流程效率並降低總體製造成本。	(i)半導體、顯示面板、PCB及光伏行業，(ii)製造設備軟件
仿真	VM&EHM及 PDS	該技術涉及建模和算法以模擬真實系統的行為，預期為生產過程中的分析、預測和優化提供虛擬實驗環境，從而實現工藝流程的優化和快速迭代。	(i)半導體、顯示面板、PCB及光伏行業，(ii)製造設備軟件
遠程中控....	LOFA-PCC/ RCM及 LOFA-AI/ ADC	該技術通過實時通信、智能決策、集中管理，能夠對去中心化設備實行遠程操作和協同優化，以自主決策代替人工干預，以提高決策效率、實現跨工廠協作、預測故障及降低人工成本。	半導體、顯示面板、PCB及光伏行業

業 務

核心技術	軟件解決方案	說明及優勢	目標應用行業
良率分析....	YMS及FDC	良率分析技術透過數據挖掘、根源辨識及錯誤檢測，提升產品品質及提高良率。	半 導 體 、 顯 示 面 板、PCB及光伏 行業
設備 自動化....	CTF	該技術通過智能控制、傳感和執行技術，實現製造設備的自主運行和優化管理，實現高精度控制、無人生產和實時響應。	製造設備軟件
生產設備 聯網及自 動化控制..	EAP/BC	該技術實現了對整個生產過程的全面監控、製造操作的實時優化及設備的系統化產品參數管理。	半導體前道、 封測、拉晶等 泛半導體行業

研發

我們開發新技術、設計新解決方案及服務，以及改進現有解決方案及服務的能力對維持我們的市場地位至關重要。

我們的研發團隊

我們的研發團隊由擁有專業知識及行業經驗的專門人才組成，專注於開發及商業化我們的IMSS，以維持我們的技術優勢及市場競爭力。截至2023年、2024年及2025年12月31日，我們的研發團隊由136名、108名及148名成員組成，分別佔員工總數的24.1%、22.1%及26.9%。於2023年，我們為12英寸CIM系統的研發項目分配並增聘研發人員。於2024年具體研發項目完成後，部分研發人員被調至項目實施團隊，導致2024年研發團隊成員減少。於2025年，由於2025年的業務擴張計劃（尤其是PDS），我們招募並重新分配了額外的研發成員。截至2025年12月31日止三個年度各年及於最後實際可行日期，我們研發團隊的流失率分別為7.2%、15.8%、14.5%及7.0%。流失率按年／期內離開本集團或調離研發團隊的研發人員數量除以上一年／期末的研發團隊成員總數計算。2024年研發流失率的增加主要由於上述2024年研發人員的調動，其次為因員工人數迅速擴張而帶來的自然人員更替以及為支持我們在2025年的PDS增長計劃而招入新人員。彼等擁有多學科專業知識，如數學、計算機科學、物理學和半導體技術等，共同為研發提供了見解與經驗。截至2025年12月31日，我們的研發團隊成員中有18.9%獲得碩士或以上學位。

核心研發成員

截至最後實際可行日期，我們的核心研發團隊成員在泛半導體行業領域平均擁有約15年的行業經驗。其簡介載於下文：

我們的首席技術官王文瑞先生擁有台灣崑山科技大學電機工程學士學位。王先生在顯示面板行業的生產管理與自動化領域擁有約20年的豐富經驗，並主導本公司多項智能製造轉型計劃。王先生在顯示面板自動化、製造工藝及工廠規劃方面有深厚背景，專門從事數據分析及自動化解決方案。

我們的CIM產品經理陳湘芳女士擁有中國上海海洋大學計算機科學碩士學位。陳女士在計算機集成製造(CIM)領域擁有六年經驗。彼目前負責領導CIM產品業務線，為不同客戶提供專業定制的解決方案。彼曾參與多個大型項目，擔任解決方案專家及技術總監等多個關鍵職務。

業 務

我們的技術總監姜志先生擁有中國武漢大學計算機應用技術碩士學位。姜志先生在製造執行系統(MES)開發、軟件設計方面擁有逾16年經驗，其中12年專注於軟件解決方案及系統架構設計。姜志先生專注於半導體及相關行業的IMSS，且彼精通半導體生產流程及MES整合。姜志先生擅長複雜系統架構設計及跨平台技術整合，致力於推動MESwell®解決方案在半導體及顯示面板製造領域的本地化。

我們的產品總監姜罡先生擁有中國北京工業大學光學碩士學位。姜罡先生在半導體CIM及MES系統領域擁有逾15年專業經驗，兼具客戶端與供應商端的實務背景。彼熟悉MES全流程管理，如需求分析、架構設計及部署，並擅長半導體生產與CIM系統的整合，且在編程方面具備深厚的技術實力。

我們的技術總監鹿才軍先生擁有中國安徽工業大學計算機應用專業學士學位。鹿先生在軟件開發領域擁有逾19年經驗，其中超過十年專注於軟件設計與研發管理。鹿先生專長於工業數字化及數據智能，並精通編程及大數據分析框架，擅長實行AI算法及工業數據挖掘解決方案，具備從金融科技跨足智能製造的跨領域專業能力。

研發能力及中心

我們提供IMSS的自主研發，專注於技術的不斷迭代與創新，提升核心競爭力。自成立以來，我們始終致力於創新，我們的業務里程碑包括交付多個行業首創的項目。值得一提的是，我們於2023年初成功交付國內自研、配備核心MES系統的12寸前道18納米製程CIM系統，標誌著我們在提供12寸晶圓製造全自動化IMSS方面取得突破，並實現全廠生產系統管理。此外，我們於2024年12月加大對PDS精細化開發的投入，並通過自研算法，實現了媲美海外行業領導者所掌握技術的校正技術。我們已取得客戶的產品版圖測試驗收，達到2納米，遠低於電子束光刻機28納米工藝的修改要求。該兩個研發項目已符合客戶技術規格要求，並處於後期測試及維護階段。

此外，本公司於2020年註冊為國際半導體設備與材料協會(SEMI)標準企業會員。我們亦積極參與編製了PCB行業的一項行業標準以及刊發了多份白皮書。於往績記錄期間，我們堅持內部研發，並無參與對我們研發業務而言屬重大的外包研發計劃。然而，我們可能利用設備等外部資源來整合資源及提升我們自身的研發能力。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無獲授權引進任何重大知識產權。於往績記錄期間，我們與中國領先的大學及研究機構合作開展半導體光刻領域仿真軟件及AI報價系統等多項研究計劃。具體而言，我們與深圳大學及西安交通大學各自訂立合作協議，分別為期三個月及一年。根據該等協議，我們聘用對手方提供與PDS研發相關的技術服務以及對電子束光刻進行研究。協議項下的服務費於完成特定里程碑後分期支付或於合約期首月內一次性支付。

業 務

合作協議載列(其中包括)各方的各自責任、保密安排以及研發成果的擁有權與分配。根據該等協議，所有研發成果及由此產生的知識產權均歸我們所有，而研究報告的版權則由各自對手方擁有，惟我們有權免版稅使用該等研究報告。每份該等合作協議將於相關訂約方完全履行所有合約義務後終止。此外，倘因不可抗力或技術風險導致無法履行相關協議，每份協議的任何一方透過向另一方發出書面通知終止協議。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遭遇任何可能對我們IMSS的研發造成重大不利影響的法律申索或訴訟。

於往績記錄期間，我們亦與外部機構就AI大模型產品的多個研發項目進行合作。根據該等協議，所有研發成果以及所有源代碼(包括與由此產生的功能之二次開發相關的源代碼)均歸我們所有。該等協議須於相關各方全面履行所有合約義務後，或根據協議規定的情況終止。

鑒於研發在我們運營中發揮關鍵作用，且各個業務部門需求迥異，故我們將研發職能分配至四個專業職能或領域：

聯合實驗室中心：主要負責開發新軟件解決方案。其主要職責包括：(i)負責監督新軟件解決方案的規劃與管理，確保與我們戰略發展方向及行業趨勢保持一致；(ii)開展市場需求識別與分析，確定擬開發的軟件解決方案類型，以及所採用的技術與商業模式；(iii)招募高端人才進行外部合作，並探索與孵化新的未來場景產品。孵化完成後，相關團隊成員將轉入產品開發中心，或成立獨立中心或業務單位。此類孵化可能涉及與行業顧問、產品經理及／或外部機構的合作；及(iv)與銷售及營銷部門協作，推動相關軟件解決方案的銷售與推廣。一旦開發出軟件解決方案，產品開發中心將負責其進一步的升級及發展；

產品開發中心：主要負責我們現有個別模塊(如MES、YMS和AI報價系統)的升級及進一步研發工作。其主要職責包括：(i)帶領中心開展軟件解決方案的開發與研究工作，並就應用場景的功能要求制定開發計劃；(ii)制定成長路線圖；(iii)通過收集市場資訊並研究分析技術發展與客戶需求資訊，分析技術及市場發展趨勢，為制定軟件解決方案開發計劃及軟件解決方案立項批准提供依據；

核心研發中心：主要負責開發及升級我們的平台。其主要職責包括：(i)建立統一的研發技術平台，以實現可持續積累，並確保該平台的整體開發效率、先進性、可用性、穩定性及可持續發展能力；(ii)確保產品開發中心所開發的模塊功能要求在平台順利執行及納入以及順利交付項目，並協助產品開發中心及時跟進市場反饋，了解客戶的使用情況；及(iii)管理我們的核心技術，組織重大技術決策及技術方案的制定與實施；

解決方案諮詢中心：主要負責根據客戶的需求設計最佳化的軟件解決方案並跟進其實施情況，例如提供系統集成服務、業務單位的售前活動及定義行業解決方案。其

業 務

主要職責包括：(i)設計解決方案、與客戶溝通、監督軟件解決方案研發、引入、推廣及運營；(ii)提供符合不同客戶及應用場景需求的定制化軟件解決方案，並跟進實施情況和管理產品分析、運營及路演；(iii)協調各級資源，促進營銷及商機轉化，支援行業合作夥伴與供應商，構建合作夥伴關係並向其他研發中心反饋客戶需求。

核心研發中心主要由上海總部運營，其他中心人員則分散於不同項目所在地，以便與運營單位及客戶保持密切合作。這種分散架構為技術性響應區域市場需求提供保障，同時實現對基礎研發計劃的集中監管。

產品研發流程

我們基於技術、市場趨勢及客戶需求，進行了IMSS的研發。我們的研發項目遵循標準化軟件開發流程，並通過嚴格的內部測試及發佈程序產出。該流程包括五個主要階段：客戶需求分析、架構設計、編碼開發、軟件測試，以及部署與迭代。

客戶需求分析：進行市場與行業研究，識別並驗證軟件解決方案需求，確保其符合客戶期望及新興趨勢。

架構設計：設計並制定系統架構、模組化組件及接口規範，建立可擴展且具互操作性的框架。

編碼開發：開發員根據結構化編碼規範推進開發，將設計藍圖轉化為具備功能性的軟件。

軟件測試：採用嚴格的品質保證流程，包括單元測試、整合測試及系統測試，以驗證功能性、效能及穩定性。

部署與迭代：經最終審查及批准後，將解決方案部署至生產環境。我們部署解決方案後持續進行監控、維護及迭代優化，確保持續優化和操作問題的及時解決。

研發團隊內部政策

我們優先吸引及挽留頂尖人才，彼等為未來成功及可持續增長的關鍵。我們通過具有競爭力的薪酬待遇、購股權激勵及多項福利津貼挽留主要管理層及技術人員。此外，我們竭力通過培訓系統提升團隊的技術專長、項目管理技能及服務質量。該系統包括面向全體員工的行業基礎知識培訓、幫助新員工理解業務的培訓，以及協助工程師提升知識及技能水平的持續技術培訓。

為支持業務擴張，我們招聘及培養具備領先公司工作經驗及相關領域專長的人才。我們亦已制定計劃，以優惠的上海落戶政策吸引中國各地的高級管理層及經驗豐富的技術人員加入我們。

儘管我們努力吸引和留住人才，但無法保證我們的主要管理層或主要技術人員不會離職。為了減輕主要管理層和技術人員的潛在離職影響，我們已採取以下措施：(i)我們與該等人員簽訂的所有協議均包含關於轉讓發明和發現的承諾，並包含相關條

業 務

款，明確員工在受僱期間為履行我們的任務而創作的任何作品均歸我們所有，從而確保專利和版權歸我們所有；(ii)保密條款和競業禁止承諾也已納入員工的僱傭協議中，以保護本集團的機密資料，無論是在員工受僱期間還是離職之後。此外，我們也可以根據具體情況評估是否執行競業禁止承諾。

與管理層及技術人員所訂協議的主要條款如下：

不衝突：在受僱期間，除員工事先向我們作出的書面披露外，員工不得以任何形式直接或間接在其他實體擔任任何職務（包括擔任顧問或提供顧問服務）。

發明創造安排：員工在完成任務的過程中創作的任何作品，均歸我們獨家所有，員工保留署名權。

保密：在受僱期間及其後，員工應對我們的機密信息嚴格保密，未經我們事先書面同意，不得將該等信息透露給任何未經授權第三方，或出於自身或任何第三方的利益而使用該等信息，直至該等信息為公眾所知或可通過公共渠道獲取為止。

不競爭：在受僱期間及僱傭終止後若干期間內，通常為24個月，員工及其近親屬不得在中國境內進行競爭行為。

研發成本

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們的研發成本分別為人民幣66.4百萬元、人民幣59.0百萬元及人民幣66.2百萬元，分別佔我們同年經營開支總額的48.5%、43.6%及42.0%。請參閱「財務資料－研發成本及經營開支總額」。於往績記錄期間，我們絕大部分研發開支乃就IMSS而產生。我們不按平台分配研發開支，且截至最後實際可行日期概無發生重大意外或不利變動。

知識產權及行業特定標準

我們依靠我們的專利及軟件著作權、商業機密、保密技術及持續技術創新，發展、鞏固及維持我們的競爭優勢。我們設法保護並優化對業務發展具有重要商業價值的技術、發明及改良，方式為尋求、維護及捍衛專利權。

以下各項對我們未來的商業成功至關重要：我們能夠獲得、維護、捍衛及執行與業務相關且具有重要商業價值的技術、發明及專有技術的專利及其他保護；維護我們商業機密的保密性；以及在不侵犯或盜用第三方專利及權利的情況下運營。我們保護知識產權的方式為：(i)在與我們的員工簽訂的全職僱傭協議中訂明與知識產權的所有權及保護相關的全部權利及義務；及(ii)積極追蹤知識產權的註冊及授權狀態，並在得悉任何可能侵犯我們知識產權的行為時及時採取行動。我們十分重視知識產權管理，於往績記錄期間，我們分別於2022年3月及2024年12月獲頒企業知識產權管理體系認證(GB/T 29490-2013及GB/T 29490-2023)。於2022年，我們亦因通過專家對我們資質、專利佈局及策略的評估而獲上海知識產權局評為上海市專利工作試點企業之一。

業 務

截至最後實際可行日期，我們於中國境內取得36項專利、18項商標及173項軟件著作權。我們在中國境內獲准的專利包括30項發明專利及1項設計專利。此外，截至最後實際可行日期，我們亦已申請11項海外專利。我們的專利及著作權構成了技術基礎架構的核心，令我們得以開發創新產品及服務，從而提升競爭優勢。

我們亦擁有眾多中國註冊商標，彼等對我們的聲譽、品牌知名度及市場推廣活動而言至關重要。有關我們知識產權的詳情，請參閱「附錄六－法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－B.我們的知識產權」。

於往績記錄期間，我們已付知識產權相關費用總額為人民幣8.5百萬元，包括(i)專利相關費用人民幣1.7百萬元；(ii)商標相關費用約人民幣30,000元；(iii)軟件著作權相關費用約人民幣30,000元；(iv)知識產權協議相關費用人民幣6.7百萬元；及(v)向僱員發放專利授權補貼人民幣27,000元。

截至最後實際可行日期，我們的特專科技產品相關的所有專利、商標及著作權均由我們獨家擁有及自主開發，概無與第三方共同擁有或共享的安排。請參閱「附錄六－法定及一般資料－有關我們業務的進一步資料－B.我們的知識產權」。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據我們中國法律顧問所告知，我們的董事認為，我們概無涉及任何針對我們或由我們提告的有關知識產權侵權索賠的重大訴訟。董事確認，截至最後實際可行日期，彼等並無發現有關我們侵犯任何第三方知識產權的任何法律、仲裁或行政程序。根據聯席保薦人的盡職調查，聯席保薦人未發現任何與以上所述相反的情況。然而，如果我們日後未能保護自己的知識產權，則會存在相關風險。有關詳情，請參閱「風險因素－與我們解決方案的研發及知識產權有關的風險」。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團在知識產權申請方面遇到若干障礙，包括專利申請遭拒、專利審查意見、商標駁回及商標駁回複審程序。然而，誠如我們的中國法律顧問所告知，該等申請與涉及我們特專科技產品的核心專利或商標無關，且並無對本公司的業務及營運造成重大不利影響。

根據弗若斯特沙利文的資料，由於先進製造的複雜性及泛半導體行業的廣泛性，泛半導體行業適用多項行業特定標準。下文列出與我們的特專科技產品尤為相關的若干標準，該等產品協助客戶遵守相關標準並提升客戶的先進製造能力：

- 《印製電路板製造設備通訊協議語義規範》(T/CPCA 8001 – 2022)，一項由中國電子電路行業協會於2022年11月出台的公認行業標準，填補了中國缺乏PCB製造設備標準化通訊協議這一空白。該標準解決了當時整個行業所採用的通訊協議分散及無序的問題，簡化了PCB製造設備產業鏈不同層級通訊層之間的互操作性，從而降低企業的基礎設施基線及整合成本。我們作為起草委員會成員參與其中。

業 務

- 《智能製造能力成熟度模型》(GB/T 39116-2020)，由中國電子技術標準化研究院、中國軟件評測中心及中國信息通信研究院聯合起草。該標準代表了行業內的另一個重要基準，提出了五個級別的智能製造發展、20個能力要素及統一的評估方法。本集團根據該標準獲得的產品認證不僅表明我們符合現行行業標準，亦反映我們獲得權威行業機構的認可。

我們的董事確認，我們的特專科技產品已符合上述各項標準。

競爭

根據弗若斯特沙利文報告，按產生的收入計，2025年，我們在中國泛半導體IMSS市場排名第三，且為國內第二大的泛半導體IMSS提供商，於2025年佔總市場份額約12%，亦為首家實現泛半導體行業價值鏈各個環節的軟件解決方案覆蓋的中國公司，提供從生產初始階段至最終產出的材料、加工到元器件、組裝、下游應用的綜合解決方案，覆蓋泛半導體所有行業。中國泛半導體IMSS市場為中國IMSS市場的細分市場，按銷售收入計，於2025年約佔整體市場的4.4%。根據弗若斯特沙利文的資料，中國IMSS市場相對分散，於2025年，前五大參與者佔據25.8%的市場份額。於2025年，按IMSS收入計，我們在中國IMSS市場排名第16位，市場份額為0.5%。

有關我們競爭優勢、所處行業及所面臨的風險詳情，請參閱本文件「行業概覽」及「風險因素－與我們一般營運及行業有關的風險」各節。

銷售及市場推廣

我們的銷售團隊旨在滿足用戶群的多樣化需求及廣泛的地理分佈，確保為所有客戶群體提供優質服務與支持。截至2025年12月31日，我們的銷售及售前團隊由50名員工組成，並在上海、深圳、合肥、蘇州、西安及成都等中國城市中設立當地辦事處。

我們已制定並落實銷售管理制度作為我們的內部政策，以標準化正式銷售及項目交付前的售前流程。該制度主要涵蓋：(i)客戶准入及背景調查；(ii)客戶資料收集及維護；(iii)產品及服務報價與定價、報價審批及合約談判；及(iv)合約審批及印章管理。

就客戶准入及背景調查而言，銷售人員須對潛在客戶進行背景調查，並定期於客戶關係管理（「CRM」）系統中錄入、更新及維護客戶資料。

客戶資料乃根據CRM系統的管理要求進行收集，包括客戶公司資料、資質及風險狀況。相關客戶資料必須根據內部程序及時申報及更新，並由總經理審閱。經批准的客戶資料須於CRM系統內予以維護。

業 務

就產品及服務報價與定價管理而言，銷售部、交付部及研發部人員將協同制定新產品及技術服務的定價標準。個別項目的報價由銷售人員通過CRM系統發起。倘報價的毛利率符合我們的報價標準，報價將由交付部、業務部總經理及財務部審議並批准，隨後方可進入合約及蓋章程序。倘報價的毛利率未達我們的報價標準，則必須進一步提交予首席技術官、交付部及總裁進行審批。銷售人員僅可在報價獲批准後，方可開始與客戶進行合約談判及簽約。

就合約審批及簽約管理而言，銷售人員須與客戶協商並落實銷售價格及主要合約條款，並透過CRM系統推進合約及蓋章審批申請。該申請需經過多級審批－涵蓋項目經理、項目總監、業務部總經理、首席技術官、法務部及財務部。原則上，銷售合約優先採用我們的內部標準合約範本。於合約獲審批後，我們會將已蓋章合約的電子版本及紙質版本交予銷售部，隨後由銷售部安排客戶簽約及蓋章。經蓋章並交回的合約將由行政部存檔。

銷售模式

我們通常通過直接談判和投標兩種方式來獲取客戶和新項目。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，通過投標獲取的項目產生的收入分別佔各年度約27.2%、17.5%及6.5%。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們分別提交44項、34項及43項標書，其中有15項、10項及13項中標，中標率分別約為34.1%、29.4%及30.2%。於2025年所提交的投標數量有所增加主要由於我們擴大新客戶基礎的策略以及我們的業務增長。截至2024年12月31日止年度，我們的中標率下降，主要是由於顯示面板行業客戶的招標需求減少，從而導致我們就該行業項目的投標數量減少。由於過往顯示面板項目的中標率較高，因此，該行業投標減少致使我們的整體中標率下降。於往績記錄期間，我們向客戶銷售產品通常不涉及招標程序。

定價

我們的產品並無對標的政府機構參考價格。通常情況下，我們的定價方法和關鍵定價考量因素可能會因不同的解決方案平台而有所不同。對於定制化解決方案和服務，我們主要按項目制模式收費，其中軟件解決方案價格或服務費用是固定的，定價時會考慮各項因素，包括我們產品部門的研發投資、成本及開支分析、可比產品的現行價格、目標利潤率、行業政策、我們的戰略市場定位、項目的複雜程度、工作量和人力投入、涉及的軟件產品以及客戶提出的定制化要求等因素。

基於該等參數，我們銷售、交付及研發部門的人員會進行協調，以制定我們產品及服務的基準定價標準。我們的財務部門亦會定期監控及更新主要產品類別的標準毛利率，以確保我們的收費報價在成本變動的情況下仍維持切實可行。我們維持報價標準及指定的戰略客戶名單，使我們能夠按個別情況提供靈活的戰略定價，以確保與主要客戶建立長期關係。

業 務

於往績記錄期間，本公司錄得若干虧損項目。該等項目層面的虧損主要是由我們的戰略定價慣例，以及在項目實施過程中客戶需求或其營運狀況的變動共同導致。我們並未對所有該等虧損項目採用戰略定價。我們的固定價格定價模式依賴以下關鍵假設：客戶的製造工藝規格、設備接口的數量及類型以及整體部署時間表將維持在售前階段預先界定的穩定範圍內。然而，項目實施期間可能會出現泛半導體行業的技術複雜性，以及客戶需求或營運狀況的意外變動。由於我們的合約價格固定，為完成該等系統集成及驗證過程而調配預算外的額外研發及交付工程工時，影響了我們的利潤率並導致虧損結果。

為減輕未來的項目虧損並保障我們的毛利率，我們已加強我們的項目全生命週期風險管理及成本控制框架：

1. **產品及服務報價與定價管理：**我們已建立強制售前客戶背景調查程序。在銷售人員透過CRM系統對個別項目發起報價前，須根據CRM系統的管理要求收集客戶資料（包括客戶公司資料、資質及風險狀況），以評估應收款項回收風險。有關我們CRM系統的詳情，請參閱本文件「一 銷售及市場推廣」。此外，我們將對客戶的技術要求進行評估，並對我們的產品與客戶的技術要求之間的功能差距進行分析，從而減少因低估技術複雜性而導致的定價不準確。為確保我們的收費報價反映最新市場趨勢並確保我們的利潤率，我們的財務部門將定期根據銷售利潤數據更新我們的報價標準，並及時將有關變更通知銷售部門。戰略定價僅在獲得銷售團隊負責人、首席執行官等多名高級管理層批准後方會提供。有關戰略定價審批所涉及程序的詳情，請參閱本文件「一 銷售及市場推廣」。
2. **預算差異控制：**我們的項目管理辦公室定期追蹤實際工時消耗與人力消耗預算的對比情況，從而觸發即時的糾正上報。

對於我們的數字化設備平台，我們通常會收取設備專用軟件包的預付許可費以及首台設備開發合作費，之後根據產量收取每台設備的許可費和技術服務費。根據弗若斯特沙利文的資料，該等定價基準乃符合市場慣例。此外，我們通常就運維服務向客戶收取年費。於往績記錄期間，我們(i)已確認收入的IMSS項目的平均合約金額約為人民幣1.0百萬元；及(ii)已確認收入的維護服務的平均合約金額約為人民幣0.3百萬元。

市場推廣

我們致力於為旗下解決方案的企業級客戶創造價值，並最終實現共贏，我們同時能夠通過現有客戶及商業合作夥伴的口碑推薦，以具成本效益的方式實現客戶自然增長，並擴大市場份額。此外，我們亦積極參加會議及展覽以吸引新客戶。

業 務

我們進入市場的戰略始於與就若干目標終端客戶行業的領先客戶的合作，通過一個或數個入門項目，積累行業專業知識並印證我們解決方案的價值。我們的價值得到實證後，便能憑藉我們深耕的行業認知及與首發客戶合作建立的聲譽，迅速擴大業務範圍，覆蓋其他優質客戶，並進一步滲透終端客戶行業，而無需承擔高昂的銷售及市場推廣支出。同時，藉助我們首發客戶的當地及全球佈局，我們得以進軍其運營所在的各地理市場。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的銷售及營銷開支分別為人民幣37.6百萬元、人民幣45.9百萬元及人民幣43.7百萬元。

我們的客戶

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括位於中國的半導體製造商。於往績記錄期間各年度，來自五大客戶的收入分別為人民幣89.7百萬元、人民幣116.2百萬元及人民幣69.4百萬元，分別佔我們收入的54.2%、46.7%及23.1%。於往績記錄期間各年度，來自最大客戶的收入分別為人民幣33.1百萬元、人民幣49.2百萬元及人民幣23.6百萬元，分別佔我們收入的20.0%、19.8%及7.9%。

下文載列與客戶所訂一般協議的關鍵條款概要：

產品或服務。我們根據客戶合約的規定向客戶提供軟硬件設備、軟件開發服務及維護服務。

期限。合約於訂約方履行合約項下義務後完成。

保修、退貨政策及產品責任。我們將提供介乎12個月至36個月的免費產品保修期。如果使用我們的產品侵犯了第三方的知識產權，我們將確保客戶保留使用我們產品的權利，並對產品進行修改以消除知識產權缺陷，或接受彼等退貨並全額退款。此外，我們保證我們的產品不包含任何電腦病毒或可能損害、侵犯或非法收集客戶資料的惡意程序。

定價與付款。不同客戶的合約價值可能存在顯著差異。解決方案的定價取決於具體的服務範圍和所涉及的解決方案。請參閱本節「銷售及市場推廣—定價」一節。客戶需按照約定的付款時間表向我們付款。客戶須根據協定的里程碑分期付款，包括於簽訂協議時支付協議總價值的一定比例作為首付款，隨後在系統交付或推出後及交付成果驗收合格後支付與實現關鍵里程碑相關的後續分期付款。剩餘結餘將作為保修金保留，並於保修期悉數屆滿時支付。

保密性。客戶須對與合約相關的所有機密資料保密，包括合約本身。

知識產權。我們通常擁有合約項下軟件解決方案的全部知識產權。客戶享有在授權範圍內永久使用該等軟件解決方案的權利，但不得從事任何侵犯我們知識產權的行為，例如轉讓、銷售或提供該軟件予第三方。

終止。一旦所有訂約方已履行彼等各自的義務，合約將自動終止。倘對手方違反合約條款，另一方有權以書面通知單方面終止合約。倘發生超過一定時間的不可抗力事件，由雙方協商決定是否終止合約。

業 務										
客戶	經營規模 ⁽¹⁾	上市情況	下游行業	業務模式	合作 開始時間	客戶背景 及主營業務	所售產品 或服務	典型信貸期	收入金額 ⁽²⁾ (人民幣千元)	總收入佔比 (%)
客戶集團A	人民幣374億元	是	半導體顯示及智能終端	垂直集成製造模式	2015年	位於北京及主要從事機電產品的研 發及生產	生產運營平台、智能 大數據引擎平台下的 系統模塊	最多30天	33,079	20.0
客戶B	人民幣41億元	否	半導體行業	集成設備製造模式	2021年	位於四川成都及主要從事半導體產 品 (包括集成電路及相關技術) 的 開發及製造	CIM軟件解決方案下 的系統模塊	四周	29,308	17.7
客戶集團C ⁽³⁾	人民幣165.9 百萬元	否	半導體行業	綜合服務模式	2019年	位於武漢及主要專注於開發軟件及 提供信息系統集成服務	CIM軟件解決方案下 的系統模塊	最多10天	13,478	8.1
客戶集團D	人民幣255億元	否	光伏組件、光伏新材料 及儲能產品	垂直集成製造模式	2020年	位於河北邢台及主要從事太陽能光 伏產品的研發、生產及銷售	集成自動化平台下的 系統模塊	最多40天	8,335	5.0
客戶E	133.4百萬美元	否	高端處理器芯片的 封裝及測試	半導體封裝及測試 服務模式	2021年	位於江蘇蘇州及主要從事半導體生 產	生產運營平台下的系 統模塊	最多15天	5,509	3.4
總計									89,709	54.2

下表載列往績記錄期間各年度的五大客戶詳情。

截至2023年12月31日止年度

業 務										
客戶	經營規模 ⁽¹⁾	上市情況	下游行業	業務模式	合作 開始時間	客戶背景 及主營業務	所售產品 或服務	典型信貸期	收入金額 ⁽²⁾ (人民幣千元)	總收入佔比 (%)
廈門天馬顯示科技 有限公司	人民幣270億元	否	移動智能終端顯示屏及 專業顯示屏	垂直集成製造模式	2021年	位於福建廈門及主要從事顯示技 術的生產及銷售	生產運營平台、智能 大數據引擎平台下的 系統模塊	最多30天	49,161	19.8
客戶集團A	人民幣374億元	是	半導體顯示及智能終端	垂直集成製造模式	2015年	位於北京及主要從事機電產品的 研發及生產	生產運營平台、智能 大數據引擎平台下的 系統模塊	最多90天	22,322	9.0
惠科股份有限公司及 其附屬公司	人民幣66億元	否	半導體顯示面板及智能 顯示終端	半導體顯示領域垂直集 成製造模式	2019年	位於廣東深圳及主要從事半導體 顯示技術的研發及相關產品的 生產及銷售	CIM軟件解決方案及 智能大數據引擎平台 下的系統模塊	最多30天	19,229	7.7
客戶F	人民幣15億元	否	封裝基板	半導體上游領域封裝基 板垂直集成製造模式	2023年	位於廣東廣州及主要從事PCB產 品的研發、生產及銷售	生產運營平台下的系 統模塊	最多三個月	16,372	6.6
天馬微電子股份 有限公司	人民幣25億元	是	移動顯示屏及車載顯示 屏	垂直集成製造模式	2017年	位於廣東深圳及專業從事顯示面 板的研發、生產及銷售	生產運營平台下的系 統模塊	最多30天	9,157	3.6
總計									116,241	46.7

截至2024年12月31日止年度

業 務										
客戶	經營規模 ⁽¹⁾	上市情況	下游行業	業務模式	合作 開始時間	客戶背景 及主營業務	所售產品 或服務	典型信貸期	收入金額 ⁽²⁾ (人民幣千元)	總收入佔比 (%)
客戶集團A.	人民幣374 億元	是	半導體顯示及智能終端	垂直集成製造模式	2015年	位於北京及主要從事機電產品 的研發及生產	CIM軟件解決方案、智能大數據 引擎平台及智控數字平台下的 系統模塊	最多90天	23,600	7.9
客戶G.	人民幣5億元	否	通信、汽車電子及醫療設 備	垂直集成製造模式	2021年	位於汕頭及主要從事電路板、 層壓板及封裝基板的生產	CIM軟件解決方案下的系統模塊	最多15個工作日	13,363	4.4
客戶H.	人民幣18.0 百萬元	否	計算設備、雲計算服務、 新一代通信及大數據	軟件及集成模式	2024年	位於山東濟南及主要從事軟件 開發及顯示設備和電子產品 的銷售	智控數字平台下的系統模塊	45個工作日	11,747	3.9
客戶I.	不適用 ⁽⁴⁾	否	半導體設備	垂直集成製造模式	2023年	一家位於中國的科學研究機 構，主要從事半導體設備的 設計、開發及生產	數字化設備平台下的系統模塊	最多30天	10,754	3.6
客戶J.	人民幣80 百萬元	否	金融、醫療健康及教育	軟件及集成模式	2025年	位於北京及主要從事軟件開發 及提供技術服務	生產運營平台及智控數字平台下 的系統模塊	最多60天	9,922	3.3
									69,386	23.1

截至2025年12月31日止年度

業 務

附註：

- (1) 經營規模指客戶在公開可得資料中的註冊資本。
- (2) 集團客戶產生的收入包括其本身及其附屬公司所產生的收入。
- (3) 於截至2023年12月31日止年度後，客戶集團C與我們之間並無發生任何交易。我們與客戶集團C就償還未償還貿易應收款項已達成還款協議，在扣除我們應付客戶集團C的款項後，所有款項已根據協議向我們償還。因此，除會計政策規定的預期信貸虧損外，並無確認其他特定撥備。
- (4) 客戶I為一家科研機構，有關其註冊資本的資料並非公開可得。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無董事、彼等各自的聯繫人或本公司股東（據董事所知，擁有本公司已發行股本5%以上）於往績記錄期間各年度於五大客戶中擁有任何權益。

除了客戶集團A外，我們的五大客戶於往績記錄期間各年度有所不同，主要是由於我們努力擴大客戶基礎及不同領域的客戶對我們產品的需求，尤其是我們於2024年的部分前五大客戶從事顯示面板行業；而我們於2025年的部分前五大客戶從事半導體顯示面板及PCB行業。

業 務

我們的供應商

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括來自中國的硬件供應商及技術服務供應商。於往績記錄期間，我們主要採購(i)硬件、設備及網絡佈線以及(ii)技術服務。我們亦會不時根據需要向其他軟件解決方案供應商採購，以提高靈活性及成本效益。

下文載列我們向供應商採購的詳情：

- **硬件、設備及網絡佈線：**我們採購硬件（如服務器、控制器、KVM、自動導引車及倉儲設備等）。該等設備主要用於與我們的解決方案系統對接，並作為輔助載體促進項目實施。網絡佈線亦作為我們項目的配套材料進行採購，主要用於協助我們構建核心產品的數據傳輸通道。
- **技術服務：**技術服務主要包括非核心軟件模塊的外包、上門技術服務以及技術諮詢服務。該等非核心模塊包括ERP及倉儲物流系統。外包人員主要負責項目測試、安裝及調試等機械工作。

我們主要通過內部研發實現技術創新及突破，並不依賴第三方提供商。為使我們的核心技術及管理人員更加專注於設計及現場實施我們的產品，我們將若干非核心軟件模塊（如ERP、倉庫管理系統及數據庫管理系統）外包予相關領域具有豐富經驗的公司以進行協作。我們擁有使用該等非核心軟件模塊（包括但不限於軟件源代碼及應用程序）的權利。我們亦嚴格監督及評估項目執行過程中外包人員的工作質量和實施效果，以確保我們的產品及時、穩定、高效地交付予客戶。

由於我們不從事硬件製造，我們從外部供應商採購硬件及網絡佈線。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，設備及網絡佈線成本（即我們從外部供應商採購的硬件）分別為人民幣42.2百萬元、人民幣70.0百萬元及人民幣55.8百萬元，分別佔貨品及服務銷售成本的約31.8%、36.5%及22.5%。

我們將非核心軟件模塊及現場技術服務外包予外部供應商，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，就該等技術服務產生的服務費分別為人民幣16.5百萬元、人民幣27.9百萬元及人民幣47.3百萬元，分別佔貨品及服務銷售成本的約12.5%、14.6%及19.0%。由於我們主要依賴自身的技術團隊及項目實施人員進行項目開發及實施，於往績記錄期間各年度彼等的薪金佔我們貨品及服務銷售成本總額（不包括虧損合約撥備／（撥回）及存貨減值虧損）的大部分（於往績記錄期間各年度為46.9%、42.1%及51.7%），故我們在項目開發及實施方面並無依賴外部硬件供應商及技術服務供應商（其並無佔銷售成本的大部分）。

於往績記錄期間各年度，向五大供應商的採購額分別為人民幣21.5百萬元、人民幣20.1百萬元及人民幣27.3百萬元，分別佔我們同年採購總額的30.8%、28.0%及21.4%。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年度，向最大供應商的採購額分別為人民幣9.3百萬元、人民幣6.9百萬元及人民幣7.1百萬元，分別佔我們同年採購總額的13.3%、9.7%及5.6%。於往績記錄期間各年度，本集團五大供應商及最大供應商的身份及採購額的變動主要是由於各年度的項目執行要求不同及由此產生的對該等項目的不同採購需求。

業 務

據董事所深知，我們於往績記錄期間各年度的五大供應商均為獨立第三方。於往績記錄期間各年度，概無董事、彼等緊密聯繫人或任何股東（據董事所知，擁有已發行股份總數5.0%以上）於任何五大供應商中擁有任何權益。董事確認，於往績記錄期間，我們的供應商設定的價格並無出現任何重大波動，供應商的供應亦無短缺或延遲。

下文載列與硬件設備及網絡佈線供應商所訂一般協議的關鍵條款概要：

產品或服務。供應商根據協議中所載的規格、數量及價格，向我們提供硬件設備或網絡佈線或相關設備。

交付。可能由供應商承擔運輸費用。

定價。定價乃根據協議中協定的價格計算。

付款。我們須根據協定的付款進度付款，或通常授予我們交貨後60至90天的信貸期。

保修、退貨政策及產品責任。供應商應確保產品符合原製造商標準及相關主管機關現行規定所列的品質、規格及性能要求。若所交付產品為偽造產品，我們有權要求全額退款。供應商通常提供一年保修期。於維護期間，供應商負責軟件更新、重新安裝及提供運營指導服務。供應商提供上門維護或遠程控制維護。如在協定保修期內因非人為因素導致故障，供應商應於收到本公司通知後免費完成維修。

終止。如果產品存在嚴重質量問題或供應商未能按照規定的規格或協議載列的其他方式交付產品且未能糾正錯誤，我們有權終止合約。

保密性。供應商與我們均應對在討論及執行合同過程中獲得的機密信息保密。因違反保密義務對另一方造成損失的，應當予以賠償。

以下載列我們與技術服務供應商簽訂的一般協議的關鍵條款摘要：

產品或服務。供應商根據協議中所載的規格、數量、交付時間表及價格向我們提供技術服務。

定價。定價乃根據協議中協定的價格計算。

付款。我們須根據協定的付款進度付款。

保修、退貨政策及產品責任。由於技術服務大多為一次性服務，因此不提供保修服務。然而，供應商應確保軟件系統的穩定運行。如果出現影響軟件系統運行的問題，供應商應安排現場維護。

終止。如果供應商未能按照規定的規格或協議載列的其他方式交付技術服務且未能糾正錯誤，我們有權終止合約。

保密性。供應商與我們均應對在討論及執行合同過程中獲得的機密信息保密。因違反保密義務對另一方造成損失的，應當予以賠償。

業 務									
供應商	經營規模	上市情況	合作 開始時間	供應商背景 及主營業務	所購產品 或服務	典型信貸期	採購額 (人民幣千元)	採購總額佔比 (%)	
成川科技 (蘇州) 有限公司	人民幣50百萬元	否	2023年	位於江蘇蘇州及主要從事物料搬運自動化設備的生產及銷售	提供設備	最多	9,285	13.3	
供應商A	人民幣5百萬元	否	2021年	位於四川成都及主要從事軟件開發及提供信息系統集成服務	提供硬件	12個月 ⁽¹⁾ 60天	4,121	5.9	
供應商B	人民幣2百萬元	否	2023年	位於江蘇南通及主要從事勞務派遣服務 ⁽²⁾	提供勞務派遣服務	兩個月	2,846	4.1	
供應商C	人民幣2百萬元	否	2023年	位於江蘇南京及主要從事勞務派遣服務 ⁽²⁾	提供勞務派遣服務	五天	2,781	4.0	
供應商D	人民幣11百萬元	否	2021年	位於江蘇南京及主要從事軟件研發及計算機硬件銷售	提供技術服務	最多	2,466	3.5	
總計						12個月 ⁽¹⁾	21,499	30.8	

下表載列往績記錄期間各年度的五大供應商詳情。

截至2023年12月31日止年度

業 務									
供應商	經營規模	上市情況	合作 開始時間	供應商背景 及主營業務	所購產品 或服務	典型信貸期	採購額 (人民幣千元)	採購總額佔比 (%)	
成川科技（蘇州）有限公司……	人民幣50百萬元	否	2023年	位於江蘇蘇州及主要從事物料搬運 自動化設備的生產及銷售	提供設備	最多 12個月 ⁽ⁱ⁾	6,946	9.7	
上海鑠沁信息科技有限公司……	人民幣10百萬元	否	2023年	位於上海及主要從事軟件開發及 數字解決方案	提供硬件	最多90天	3,941	5.5	
江蘇永嘉信息科技 有限公司 ⁽ⁱ⁾ ……………	人民幣20.8百萬元	否	2024年	位於江蘇蘇州及主要從事企業IT服務、 智能系統集成及數據管理	提供技術服務	最多10天	3,637	5.1	
深圳未遠科技有限公司 ………	人民幣0.1百萬元	否	2022年	位於廣東深圳及主要從事智能硬件開發、 物聯網解決方案	提供技術服務	15天	2,878	4.0	
供應商D ……………	人民幣11百萬元	否	2021年	位於江蘇南京及主要從事軟件研發及 計算機硬件銷售	提供技術服務	15天	2,679	3.7	
總計 ……………							20,081	28.0	

截至2025年12月31日止年度						業 務	
供應商	經營規模	上市情況	合作 開始時間	供應商背景 及主營業務	所購產品 或服務	典型信貸期	採購額 採購總額佔比
							(人民幣千元) (%)
供應商D	人民幣11百萬元	否	2021年	位於江蘇南京及主要從事軟件研發及 計算機硬件銷售	提供技術服務	最多30天	7,133 5.6
供應商E	人民幣10百萬元	否	2024年	位於江蘇無錫及主要從事信息技術 的開發	提供硬件	最多6個月	6,209 4.9
供應商F	人民幣0.5百萬元	否	2020年	位於河南鄭州及主要從事軟件開發及 計算機硬件、軟件及輔助設備批發	提供硬件	最多180天	4,955 3.9
供應商G	人民幣0.2百萬元	否	2024年	位於河北石家莊及主要從事電子設備 及金屬製品的銷售	提供網絡佈線	最多15天	4,615 3.6
供應商H	人民幣5百萬元	否	2025年	位於江蘇無錫及主要從事軟件開發 及提供技術服務	提供技術服務	最多30天	4,340 3.4
總計							27,252 21.4
附註：							
(1)	供應商提供的相對較長信貸期與供應商合約的付款條款一致，其規定合約金額的10%須於我們接受產品一年後支付。						
(2)	據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的勞務派遣一直符合中國法律及法規。						
(3)	前稱為蘇州市永嘉信息科技有限公司。						

業 務

物流及存貨管理

物流

我們的硬件部件通常直接從我們的供應商倉庫交付到客戶指定的地點。我們的軟件部件通常透過線上分銷及實體物流交付予客戶。在若干情況下，開發亦直接在客戶所在地進行。我們亦委聘第三方物流服務提供商向客戶交付貨物。據我們所深知，該等物流服務提供商為獨立第三方。

存貨管理

我們的存貨主要包括服務器及其他硬件產品以及員工成本。截至2023年、2024年及2025年12月31日，我們的存貨及其他合約成本分別為人民幣160.7百萬元、人民幣109.0百萬元及人民幣47.1百萬元。我們定期追蹤存貨，以維持足以滿足客戶訂單的水平。我們亦積極評估市場狀況的變化，並預先儲備戰略原材料以應對潛在的供應短缺。我們的供應管理團隊定期與業務營運團隊討論並採取必要行動以將過時的風險降至最低。

客戶與供應商重疊

客戶集團A於2023年、2024年及2025年為我們的五大客戶之一，於往績記錄期間亦為我們的供應商。客戶集團A採購我們的CIM軟件解決方案以及智能大數據引擎平台及智控數字平台的系統模塊，我們於2023年、2024年及2025年自客戶集團A產生的收入分別為人民幣33.1百萬元、人民幣22.3百萬元及人民幣23.6百萬元，佔相關年度我們總收入的20.0%、9.0%及7.9%。於2023年、2024年及2025年，我們從與客戶集團A進行的交易中產生的毛利分別為人民幣9.7百萬元、人民幣7.4百萬元及人民幣6.3百萬元，毛利率分別為29.3%、33.1%及26.6%。於往績記錄期間，我們按需要向客戶集團A（以其作為供應商的身份）採購技術服務（包括在客戶工廠現場實施項目期間提供、調試、安裝及測試非核心解決方案模塊）。我們向客戶集團A（以其作為供應商的身份）採購該等服務，因為其在泛半導體行業內具備與我們不同的軟件專長（有關軟件並非我們核心及自主開發的軟件產品），並在我們需要額外人手以促進項目按項目時間表實施及交付時，可按項目基準向我們提供現場作業流程及機械作業服務。於往績記錄期間，我們僅於2023年及2025年自客戶集團A採購，總採購額為人民幣0.4百萬元及人民幣2.2百萬元，分別佔我們於2023年及2025年總採購額的0.6%及1.7%。

客戶集團C於2023年為我們的五大客戶之一，於往績記錄期間亦為我們的供應商。客戶集團C主要採購我們的CIM軟件解決方案的系統模塊，我們於2023年、2024年及2025年自客戶集團C產生的收入分別為人民幣13.5百萬元、零及零，佔相關年度我們總收入的8.1%、零及零。於2023年、2024年及2025年，我們從與客戶集團C進行的交易中產生的毛利分別為人民幣4.5百萬元、零及零及毛利率分別為33.5%、零及零。於往績記錄期間，我們按需要向客戶集團C的一家附屬公司（以其作為供應商的身份）採購技術服務（包括在客戶工廠現場實施項目期間提供、調試、安裝及測試非核心解決方案模塊）。我們向客戶集團C（以其作為供應商的身份）採購該等服務，因為其在泛半導體行業內具備與我們不同的軟件專長（有關軟件並非我們核心及自主開發的軟件產品），並在我們需要額外人手以促進項目按項目時間表實施及交付時，可按項目基準向我們提供現場作業流程及機械作業服務。於往績記錄期間，我們僅於2023年自客戶集團C採購，總採購額為人民幣1.3百萬元，佔我們於該年度採購總額的1.8%。

業 務

除上述向客戶集團A及客戶集團C採購的軟件及服務外，於往績記錄期間，本公司概無向任何該等客戶兼供應商採購硬件、設備及網絡佈線。此外，客戶集團A及客戶集團C各自向我們購買的軟件產品，與客戶集團A及客戶集團C各自向本公司提供的軟件及服務性質不同。向客戶集團A及客戶集團C採購的軟件及服務，概無用於及應用於我們與相關客戶（即上述集團公司的同一實體）訂立的相同項目。我們與該等客戶兼供應商的銷售及採購條款乃按個別基準進行磋商，且銷售及採購並非互為條件。就各重疊客戶兼供應商而言，我們向該等客戶銷售產品及我們向該等供應商採購產品的關鍵條款通常與我們的其他客戶及供應商的關鍵條款一致。該等交易乃按正常商業條款及在公平磋商基準下進行。根據弗若斯特沙利文的資料，在我們所從事的行業中，向同一實體或集團購買及出售的情況並不少見。除上文所披露者外，據我們所深知，於往績記錄期間各年，我們的五大客戶中沒有我們的供應商；於往績記錄期間各年，我們的五大供應商中亦沒有我們的客戶。

盈利途徑

過去，我們不斷開發並商業化我們的解決方案與服務，並且擴大品牌知名度，並就此在研發活動及銷售工作中作出大量投資。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們的研發成本分別為人民幣66.4百萬元、人民幣59.0百萬元及人民幣66.2百萬元，分別佔同年經營開支總額的48.5%、43.6%及42.0%。由於「財務資料」一節「綜合損益表的主要組成部分」及「經營業績的期間比較」一段所載的理由，特別是研發成本較高，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們的淨虧損分別為人民幣127.2百萬元、人民幣103.1百萬元及人民幣104.4百萬元。於不久的將來，我們可能持續產生淨虧損，主要由於我們正處於在快速增長的泛半導體IMSS市場中擴展業務及營運階段且持續投資於研發，預期將產生高額的運營成本及開支。然而，隨著我們擴大業務規模及範圍，我們預期將持續改善我們的運營效率及我們旨在通過(i)豐富我們的IMSS；(ii)擴大客戶群；及(iii)提升運營效率來增強盈利能力。

豐富我們的智能製造軟件解決方案

我們旨在豐富我們的IMSS，從而透過加強研發力度將技術創新及產品迭代轉化為可持續的收入及利潤。

將技術創新及產品迭代轉化為可持續的收入及利潤

我們對軟件解決方案組合採用以項目為基礎的模式。我們的平台由一系列專業軟件模塊組成，旨在優化各類生產與運營管理流程。客戶可選擇性地在各平台下部署個別模塊以升級現有廠房，或採用多平台集成模塊套件進行新廠建設。我們致力於創新及積極響應市場需求，此乃我們的核心戰略。而飛速發展的技術水平促使我們不斷改進並豐富軟件解決方案組合，我們日後的盈利能力主要取決於進一步將我們的核心技術變現，並開拓新應用場景及商業化機遇。

我們的收入由2023年至2024年增加50.4%，並於2025年進一步增加20.7%。我們已證明我們有成功商業化我們的解決方案及服務的能力。我們預期，隨著進一步滲透及發展泛半導體IMSS市場並推出新軟件模塊及解決方案，以及升級現有軟件模塊及解決方案，我們將把握行業增長趨勢並實現收入再創新高。

業 務

自2007年註冊成立以來，我們一直專注於為泛半導體行業提供智能軟件解決方案。我們於2023年成功交付驗收了國產12寸前道CIM系統。於2023年，本集團推出自主研發的AI產品，即LOFA產品，並於2023年7月完成經國家信息科技創新工作委員會認證的MESwell®8.0版本開發。本集團再次取得行業突破：於2024年9月，順利研發半導體行業首批多物理光刻工藝仿真系統，同時發佈符合標準的EAPwell®7.0平台。

就我們平台或軟件解決方案產品的近期發展而言，內部開發的AI智能檢測算法及全模態大模型已完成內部測試和良率提升，於2025年下半年在LOFA場景（屬於智控數字平台）中實現商業化部署，並持續建立訓練框架，以不斷優化模型推理效率。截至最後實際可行日期，我們的工藝設計及模擬系統（屬於數字化設備平台）已獲得四期訂單，首期將於2025年底前交付並商用。VM&EHM（屬於智能大數據引擎平台）及Glory IGI（屬於智控數字平台）預期將分別於2026年年中及2026年底商用。

於往績記錄期間，我們共進行了218個研發項目，其中210個由我們內部進行，而8個則與第三方合作進行。在該等項目中，184個成功推向市場，應用於我們銷售給客戶的軟件組合中，研發商業化成功率達84%。184個成功研發項目的成果被採納並整合至我們向客戶提供的軟件組合中，涉及我們與客戶簽訂的合計約680份合約中，其中約60%的項目已完成交付並確認收入，20%的項目正處於啟動階段，預計將確認收入。

為提高我們將技術創新及產品迭代轉化為可持續收入及利潤的能力，我們旨在加強與現有及潛在客戶及行業顧問的協調及合作，以設計、開發及實施因應客戶所處行業的特定特徵而量身定制的解決方案。在產品概念階段，我們將加強銷售和研發團隊的協調，確保實時驗證客戶痛點，並確保將研發成本和精力投入到客戶願意付費的技術升級及其他功能上。我們的解決方案諮詢中心（核心研發專業職能之一）主要負責根據客戶的需要設計最佳的軟件解決方案並跟蹤其實施，如提供系統集成服務、業務單位的售前活動及定義行業解決方案。有關我們產品研發流程的詳細討論，請參閱本節上文「產品研發流程」段落；有關解決方案諮詢中心的職能和職責，請參閱本節上文「研發能力及中心」。

如下所述，我們加強研發工作進一步支持及推動我們將技術創新及產品迭代轉化為可持續收入及利潤的能力。

加強研發力度

在計劃提高將技術創新轉化為可持續收入及利潤的能力的同時，我們計劃使用[編纂][編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，以持續提升我們的研發能力及IMSS產品解決方案供應，其中(i)約[編纂]%或[編纂]港元將用於強化我們的CIM產品功能及解決方

業 務

案，旨在打造適用於國內外客戶的國內開發的12寸前道CIM系統及確保我們的CIM系統穩定運行及廣泛採用；(ii)約[編纂]%或[編纂]港元將用於建設我們在泛半導體行業的AI應用能力，專注於我們的LOFA AI產品；及(iii)約[編纂]%或[編纂]港元將用作建立高端工藝設計及仿真解決方案的研發能力。有關我們分配[編纂][編纂]淨額以提升研發能力的詳細討論，請參閱「未來計劃及[編纂]用途－[編纂]用途」。

我們加強研發的計劃符合業務發展策略且旨在鞏固業務發展策略，具體而言，我們旨在加強以客戶為導向的市場影響力，進一步推進12寸MES解決方案+AI的CIM開發，並推進及加速我們解決方案及服務中人工智能驅動的開發。詳情請參閱上文「我們的策略」。我們的策略專注於通過額外研發投入提升IMSS，乃基於良好的歷史往績記錄及良好的行業趨勢，兩者共同證明該等策略在提升財務表現方面的有效性。

在數量上，我們的收入已由2023年的人民幣165.5百萬元大幅上升至2024年的人民幣248.9百萬元，並進一步增加至2025年的人民幣300.3百萬元。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們分別錄得毛利人民幣5.7百萬元、人民幣32.8百萬元及人民幣42.6百萬元以及毛利率3.4%、13.2%及14.2%。我們的客戶數量已由2023年的約130名增加至2025年的約200名，我們擴展客戶群的能力進一步突顯了該上升趨勢，顯示我們以客戶為導向的解決方案取得成功。我們的策略受到行業向智能製造轉變的支持，中國泛半導體IMSS市場規模由2021年的人民幣13億元增加至2025年的人民幣25億元，複合年增長率為17.2%，並預計2030年在中國達到人民幣72億元，反映2026年至2030年的複合年增長率為25.0%。按參與者來源劃分，預計中國泛半導體IMSS面向國內參與者的市場規模將由2025年的人民幣15億元增至2030年的人民幣55億元，2026年至2030年的複合年增長率為29.7%。根據弗若斯特沙利文報告，中國泛半導體IMSS市場受到數據驅動AI大模型廣泛深入的趨勢驅動，從單一模組解決方案逐漸過渡到平台型解決方案，即國內服務供應商逐漸及不可避免地會取代全球業界參與者。

憑藉[編纂][編纂]淨額的資金支持，我們將人工智能技術整合到我們的IMSS（特別是CIM系統）中的研發工作，預計將提供高度適應性、數據驅動且高效的生產管理系統，以滿足半導體製造的嚴格和複雜要求，且開發LOFA、GloryIGI等新型人工智能產品以及工藝設計及仿真技術，預計將為我們的客戶提升運營效率及降低成本，從而推動客戶對我們解決方案的需求，並進一步促進收入增長。

此外，我們預期未來數年的毛利率將有所增加，是由於以下各項的綜合影響：(i)如下文「提升我們的運營效率」所進一步詳述持續改善成本管理；(ii)憑藉我們的自主研發技術、專業知識及行業知識，我們未來將邁向高端製造及人工智能驅動服務升級；及(iii)我們加強研發工作，預期將改進及升級我們的解決方案。除上述措施及計劃外，作為我們建立客戶關係、累積成功案例及推動業務成長的業務策略的一部分，我們通常會為具有策略價值的新型業務和客戶的首個或前幾個項目提供相對較低的合約費用。隨著業務的成長和發展，我們預計對後續類似業務和老客戶收取相對更高的費用，從而提高毛利率。

業 務

因此，通過不斷增強平台並推出迎合市場需求演變的新型解決方案，我們將能夠推動可持續增長，憑藉我們的過往成就及更廣泛的行業趨勢，將我們的技術創新及升級轉化為可持續的收入及利潤，從而改善我們的財務表現。

於往績記錄期間，我們與兩所國內大學分別就半導體光刻領域仿真軟件的研究計劃及AI報價系統的研究計劃展開合作。截至最後實際可行日期，本公司正與深圳大學就高端工藝設計及仿真解決方案開發的研發項目進行磋商，預計將於2026年下半年正式啟動該研究及學習工作。我們持續進行自主研發工作，並就我們的部分研發課題與外部大學及研究機構合作，我們期望擴大我們對更深入專業知識的獲取、分擔風險和成本、加速創新以及培養未來的人才及建立聲譽，目標是實現較高的收入及利潤增長。

擴大客戶群

多元化且不斷擴大的客戶群對我們的增長至關重要。我們廣泛的客戶群涵蓋多個泛半導體行業的市場參與者。於往績記錄期間各年度，我們已為採購我們的IMSS產品的134家、147家及198家客戶提供服務。我們堅實的業內聲譽及客戶的高度認可足以證明我們產品的質量及可靠性。

主要營運數據

下表載列我們解決方案平台在客戶開發及留存方面的關鍵指標，這是我們早期商業化階段的重中之重（投資者應同時根據淨收入留存率及所有營運數據衡量我們的整體表現，各項數據應被視為同等重要）。下列營運數據涉及僅購買我們IMSS產品的客戶：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
IMSS總收入(人民幣千元).....	163,777	246,598	298,235
客戶數量 ⁽¹⁾	134	147	198
新客戶數量 ⁽²⁾	不適用	90	127
平均客戶價值 ⁽³⁾ (人民幣千元).....	1,222	1,678	1,506
與客戶的項目數量.....	225	271	346
平均客戶項目價值 ⁽⁴⁾ (人民幣千元).....	728	910	862
客戶留存率 ⁽⁵⁾	不適用	42.5%	46.9%
客戶獲取成本 ⁽⁶⁾ (人民幣千元).....	281	312	221
新銷售訂單價值(人民幣千元).....	199,486	237,547	313,982
年度經常性收入 ⁽⁷⁾ (人民幣千元).....	不適用	70,713	80,187
每名客戶年度經常性收入 ⁽⁸⁾ (人民幣千元).....	不適用	1,241	1,162
淨收入客戶留存率 ⁽⁹⁾	不適用	121.3%	55.1%

附註：

- (1) 各特定年度的客戶數目，乃根據於同年確認收入的客戶釐定。就跨越多個年度分批驗收交付里程碑及確認收入的進行中項目而言，有關客戶於確認該等收入的各個相關財政年度均被計為一名客戶。
- (2) 指上一年度末向我們購買產品或解決方案的客戶。
- (3) 按特定年度產生的收入除以該年度客戶數量計算。

業 務

- (4) 按特定年度產生的收入除以該年度項目數量計算。
- (5) 按特定年度的留存客戶數量除以上一年度的客戶總數，再乘以100%計算。就本計算而言，倘本集團連續於本年度及上一年度均自該客戶確認收入，則該客戶會被確認為「留存客戶」，不包括來自跨越多個財政年度分批交付及驗收里程碑的進行中項目的收入。
- (6) 計算方法為當年銷售開支除以當年客戶數量。
- (7) 指我們在上一年度自其錄得收入之客戶所產生的收入。
- (8) 按年度經常性收入除以該年度經常性客戶數量計算。
- (9) 本年度確認的來自留存客戶的收入除以上年度確認的收入。有關「留存客戶」的涵義，請參閱上文附註4。

於往績記錄期間，我們主要項目的存續期介乎約4個月至約44個月不等，而我們主要項目的平均存續期約為20個月。

由於我們致力研發以推動技術進步以及在服務及銷售方面努力取得突破，客戶數目由2024年的147名增加至2025年的198名，其中90名及127名為於相關年度的新客戶。我們於2024年的客戶留存率為42.5%，而2025年增加至48.3%。此外，我們的新銷售訂單金額由2023年的人民幣199.5百萬元增至2024年的人民幣237.5百萬元，並進一步增至2025年的人民幣314.0百萬元。

截至最後實際可行日期，在186份IMSS未完成合約中，我們就IMSS產品與144名客戶訂立了合約，其中93名為新客戶（即已與我們訂立合約但於2025年並未向我們購買產品或解決方案的客戶），我們亦就IMSS產品與約380名客戶／潛在客戶進行磋商，其中約310名為新客戶。

為吸引新客戶，我們將加強市場推廣計劃以吸引新客戶，並通過擴大線上營銷力度以提高品牌知名度及獲取更多客戶以獲得更多項目。我們亦利用投標工作、口碑推廣、業內聲譽以及積極參與會議及展覽，例如，我們已參與年度展覽「SEMICON China」，而下一屆2026年展覽定於2026年3月在上海舉行。我們亦參加了有關中國泛半導體行業的各種大型會議和展覽。於往績記錄期間，我們從參加的會議和展覽中收集了約1,500名人員的聯繫信息，隨後對其中大部分人員進行了跟進，彼等表示有興趣與我們開展潛在的業務合作。就我們透過投標開拓新客戶的努力而言，我們的銷售人員通過下述方式定期及積極尋找潛在投標機會：(i)瀏覽官方及第三方採購及招標網站（包括行業特定投標平台），以篩選與本公司業務相匹配的投標公告並迅速抓住潛在客戶及項目機會；(ii)利用行業人脈、現有客戶推薦及業務合作資源，我們的銷售團隊與有採購需求的潛在客戶聯繫。在溝通過程中，若我們了解到客戶通過公開招標和邀請招標的採購計劃，我們將進行招標相關的談判，以爭取可能的投標機會；(iii)定期回訪和深入分析現有客戶的需求，以發現需要通過招標採購的新業務或擴展需求，並及時物色招標機會進行後續合作。

通過上述努力，我們不斷積累潛在客戶群，我們相信既有客戶基礎加上不斷擴大的潛在客戶群將成為我們的有力支持，吸引新客戶並提升我們的市場地位。

業 務

留住現有客戶與吸納新客戶同等重要。我們專注於為現有客戶提供持續支持及維護服務，以維持客戶的高滿意度及忠誠度。我們多元化的解決方案組合能夠滿足不同的客戶需求，促成長期合作關係。為鞏固與現有客戶的關係，我們已與部分客戶訂立長期合作或戰略協議。例如，於2026年1月，我們亦與客戶I（一家半導體設備科研機構）就電子束及半導體設備的研發及迭代改進訂立五年合作框架協議。根據該協議，我們將向客戶I就其電子束設備提供軟件開發、測試及驗證服務，雙方將通過項目合作、培訓服務及其他方式促進人才交流、合作及共享。

除國內客戶擴張計劃外，我們計劃擴大在全球市場的版圖，首先將東南亞市場作為重點。根據弗若斯特沙利文的資料，東南亞及印度的工業軟件市場目前由國際供應商主導，其特點是成本相對較高且交付週期長。預計東南亞泛半導體IMSS市場增長強勁，市場總規模按銷售收入計由2021年的人民幣2億元擴大至2030年的估計金額人民幣13億元。該增長受到2021年至2025年15.1%的複合年增長率的支持，預計2026年至2030年複合年增長率將加速至26.1%。

基於行業研究，我們看到了市場機會並已將越南、馬來西亞、泰國、新加坡、印度及中東確定為我們的主要海外目標市場，根據弗若斯特沙利文的資料，該等市場對光伏、PCB及半導體產業的全球轉移至關重要。為引領我們的海外擴張，我們已在新加坡成立了一個海外業務部門及附屬公司，為我們的全球業務奠定基礎。設立海外附屬公司對我們的全球營運在商業上已變得至關重要，因為若干重大客戶機遇僅能透過海外實體訂立合約。此外，若干尋求於海外市場開展業務的客戶已要求我們設立本地代表辦事處，以支持持續提供服務，這突顯了於當地市場設立據點的重要性。

為支持我們的海外增長路徑，我們已完成對目標市場的區域產業結構、客戶分佈及競爭格局的全面評估。我們已採用系統化的實施模式，優先將資源投放於印度、越南及馬來西亞的半導體、PCB及光伏製造等板塊。我們獲取海外客戶訂單並與本地市場參與者競爭的策略乃由以下四大支柱推動：

- (1) **客戶主導的擴張**：我們利用與PCB及光伏板塊國內行業領軍企業的既有關係，把握彼等拓展全球版圖的機遇。透過為該等長期戰略客戶的海外製造基地提供支持，我們獲取的項目成為了客戶的重要參考據點。
- (2) **戰略渠道夥伴關係**：我們利用穩健的行業資源網絡及渠道夥伴關係，以推動市場進入及區域本地化。
- (3) **高影響力產品進入**：鑒於機器人應用在東南亞先進製造業的滲透率依然顯著偏低，我們利用標誌性產品LOFA瞄準勞動力替代細分市場，其後再將業務擴展至中央控制室系統。
- (4) **品牌知名度**：我們開展營銷活動以吸引更多出海企業，包括發佈雙語專業內容、專門的行業論文，以及在各社交媒體平台上進行數字化互動。

研究顯示東南亞市場對光伏、PCB及半導體封裝／測試解決方案的需求穩步增長，當地客戶優先考慮成本效益及本地服務能力。

業 務

- **印度**受國家產業政策支持及客戶對自動化解決方案的活躍需求所推動。根據印度半導體使命，截至2025年12月，已批准10個總投資額為1.60萬億盧比（約190億美元）的半導體項目，並獲得高達項目成本50%的政府財政激勵支持。截至最後實際可行日期，我們已物色並正積極爭取該地區至少兩個關於製造系統自動化的機遇。
- **越南**目前擁有近60家芯片設計公司及不斷壯大的半導體行業人才庫。截至最後實際可行日期，我們已獲得至少兩個關於電子製造及光伏項目的合作機遇。
- **馬來西亞**提供完善的半導體工業基礎，並有高素質的工程人才庫及英語商業環境作為支持。根據馬來西亞政府於2024年5月發佈的國家半導體戰略，馬來西亞政府已撥款至少53億美元的財政支持，以實施國家半導體戰略。
- **泰國及新加坡**在先進電子及半導體供應鏈方面展現增長潛力。在泰國，根據泰國投資促進委員會的資料，在先進電子領域的外國直接投資帶動下，2024年投資促進申請的價值飆升35%至約1.14萬億泰銖（約310億美元）。同時，根據新加坡經濟發展局的資料，新加坡已承諾向半導體研發投入約800百萬新加坡元（約590百萬美元），以保持其在具高影響力技術領域的領導地位。我們將位於新加坡的附屬公司定位為我們的區域前端，以把握該等高價值諮詢及系統集成機遇。
- **中東**對工業數字化及本地化數據治理的需求日益增長。然而，鑒於2026年伊朗戰爭引發的地緣政治不穩定，以及隨之而來對區域物流、能源基礎設施及供應鏈連續性的風險，我們已採取審慎策略來開拓該市場。

自2026年1月1日起及直至最後實際可行日期，本公司已在泛半導體行業內物色到39個海外潛在商業機遇，包括PCB領域19個、半導體領域11個、光伏領域6個及顯示面板領域3個，涵蓋MCS、CIM及MES軟件產品，並分佈於不同國家，包括印度7個潛在項目、越南7個潛在項目、馬來西亞3個潛在項目、泰國11個潛在項目、韓國4個潛在項目及其他國家7個潛在項目。截至最後實際可行日期，本公司已就上述9個項目與客戶簽訂合約，涵蓋泛半導體行業的各個領域，而關於其餘潛在業務機遇，我們正與潛在客戶進行磋商。

於往績記錄期間，我們已在南亞及東南亞市場（包括馬來西亞、泰國及印度）實施14個項目，標誌著我們邁向更廣泛的全球影響力的初始步伐。我們來自海外市場的收入由2023年的人民幣0.9百萬元增加至2024年的人民幣2.3百萬元，並進一步增加至2025年的人民幣4.0百萬元。

於2025年8月，我們於東南亞訂立了我們的首個海外項目，合約總額約6.7百萬元，涵蓋跨平台系統模組。該項目不僅展示了我們承接複雜跨境項目的能力，也為我們拓展全球業務奠定了堅實的基礎。於2025年，我們與海外客戶訂立若干合約，包括執行印度整廠CIM項目的工單、印度尼西亞、印度、越南及埃及太陽能生產線項目、

業 務

台灣客戶MCS項目。於最後實際可行日期，在186份IMSS未完成合約中，我們有11份IMSS未完成合約來自東南亞客戶，積壓訂單總額為人民幣67.2百萬元。

此外，截至最後實際可行日期，我們正在與東南亞市場的七名潛在客戶及四名現有客戶就13個IMSS項目進行洽談，涉及PCB、半導體及顯示面板。我們也在與海外半導體封裝／測試客戶洽談，並探索台灣地區市場的設施數字化項目，其中一些項目已進入合約最終敲定和實施階段，這證實了海外市場存在明確且可行的需求。

我們相信，憑藉在中國IMSS市場的豐富經驗及穩固的客戶基礎，我們有能力將業務版圖擴展至目標地區。有關我們的海外擴張計劃的詳情，請參閱上文「－我們的策略－利用我們的智能製造技術加速海外佈局」。

我們計劃將[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元（相當於約[編纂]%）用於銷售及推廣用途，旨在通過擴大國內及海外銷售及服務網絡，結合提升客戶服務質量以維持及深化現有客戶關係，提高我們的商業化能力。

我們有意通過戰略性地豐富解決方案並擴大客戶群，以獲取穩定且不斷增長的收入來源。此外，我們致力於推出新智能製造軟件模塊及升級現有模塊，以此吸引並迎合同國內半導體行業參與者，並為日後在泛半導體市場進行商業化做好準備。

提升我們的運營效率

運營效率對盈利能力而言至關重要。有效的成本管理及資源優化能夠提升我們的盈利能力。

成本及開支管理

我們的銷售成本包括僱員福利開支、設備和網路佈線成本。於往績記錄期間，我們截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的毛利率分別為3.4%、13.2%及14.2%。有關我們於往績記錄期間的毛利率波動的詳情，請參閱本文件「財務資料－綜合損益表的主要組成部分－收入、毛利及毛利率」一節。我們相信，經過我們知識產權及技術知識的不斷積累，我們未來將能夠有效控制開發成本。

於往績記錄期間，我們於2023年、2024年及2025年的銷售及營銷開支分別為人民幣37.6百萬元、人民幣45.9百萬元及人民幣43.7百萬元，佔各年度總收入的22.7%、18.4%及14.5%；我們的行政開支（不包括[編纂]）分別為人民幣32.8百萬元、人民幣30.6百萬元及人民幣30.1百萬元，佔各年度總收入的19.8%、12.3%及10.0%。我們擬將[編纂][編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元用作銷售及推廣用途，包括擴展國內及海外銷售與服務網絡，以及為我們的銷售及服務團隊招聘人員。我們預期在可見未來，隨著業務增長，我們的總營運開支（包括但不限於銷售及營銷開支與行政開支）在絕對金額上將繼續增加，而主要由於業務持續增長所帶來的規模經濟效應及成本效益改善，相應的營運開支佔收入百分比預計將會於2027年及之後下降。

業 務

本公司已實施或計劃實施以下節省成本措施，以提高項目實施效率及改善項目毛利率：

1. 自2024年下半年起，我們已實施以下措施，以提高我們與泛半導體客戶在若干項目中的交付效率：
 - 加強關鍵項目里程碑（包括項目啟動、項目藍圖、測試、驗收及項目總結等）的執行，以避免可能導致項目實施成本增加的重複工作或延誤。高級銷售或管理層的專責人員通過定期與項目實施團隊舉行檢討會議來進行跟進及監督，以確保嚴格執行有關項目里程碑；
 - 作為各項目實施團隊主管的指定人員將每週與團隊成員組織項目會議，以及早發現項目問題，指導項目經理，並將未解決的問題上報予更高級別的管理人員以及時解決；
 - 標準化政策於三個主要範疇實施，即產品特點、項目交付方式及輸出文件。實施標準化將提高可重用性（如文件範本及物流安排），從而提高交付效率。
2. 自2025年下半年起，我們開始就我們的MES軟件產品實施低代碼開發工具，使我們能夠縮短項目開發週期、降低維護成本並提高項目實施效率。該開發工具將全面應用於我們的MES軟件產品，從而降低我們未來提供MES服務的開發成本。基於上述措施，我們的CIM系統毛利率預期於2026財政年度將提高約3.1%。
3. 我們目標於2026年底或前後引入AI編程，預期將進一步提高項目實施效率及／或減少項目實施人員數量。根據我們的內部管理層估計，我們預期項目開發效率將提高10%。

在實施上述首兩項措施的影響下，我們的毛利率由截至2024年12月31日止年度的13.2%提高至截至2025年12月31日止年度的14.2%，而我們的經營開支佔收入的百分比由截至2024年12月31日止年度的約54.4%減少至截至2025年12月31日止年度的52.5%。預期我們的整體毛利率將由2025財政年度的14.2%提高至2026財政年度的約19.4%。

此外，計及項目總價值的預期增長及透過實施以下措施，預期每名銷售人員的平均年度銷售額將由2026財政年度的預測金額約人民幣5.5百萬元增加至2029財政年度的約人民幣15.5百萬元，從而實現銷售人員生產力的優化。該等措施包括：

1. 採用全行業銷售加區域銷售模式，由本地銷售人員在本地服務客戶並培養客戶忠誠度。
2. 實施大客戶戰略，以深入發掘行業前十大客戶。
3. 加速優化及裁減表現不佳的銷售團隊成員，確保新人才源源不斷地加入。

業 務

4. 建立全方位客戶溝通方法，使我們不同層級（上、中、下層）的銷售及管理人員負責為每名客戶各企業層級的員工制定具針對性的策略並與之溝通。
5. 專注於開發涉及完整工廠規劃的更全面、大規模及成套項目及系統集成項目，我們旨在為該等項目提供全方位及持續的規劃及諮詢服務，以取得商機及大價值訂單。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們於往績記錄期間確認的存貨減值虧損分別為人民幣24.3百萬元、人民幣15.2百萬元及人民幣7.3百萬元。由於我們持續努力且有能力將解決方案商業化及提高供應鏈管理效率，我們預期存貨減值虧損將進一步減少。

團隊協同優化

我們注重公司內部團隊合作精神，並將員工組織成專注於特定領域業務的產銷研一體化團隊，並在跨職能業務小組層面制定及執行我們的預算，薪酬方案（包括基本工資、獎金及戰略補貼）與整個單位的業績和預定義的關鍵績效指標直接相關。這使團隊之間的激勵措施保持一致，以推動目標統一化和資源優先化。

內部運作流程改善

為了促進項目問責的可追溯性及／或消除任務錯配，我們按團隊或項目類型配置人員，透過我們的研發中心、標準化項目交付範本和自動化開發工具，提升勞動效率並縮短交付週期。我們亦將完善產品孵化標準，以訂單量和溢利貢獻為衡量標準，強調規模化的商業影響。於2024年，我們成立了由總部集中管理的專項項目交付團隊。團隊成員包括項目交付職能的銷售人員、跨業務單位的人員及管理層，以實現對每個項目的項目進度及交付時間表的集中管理，從而旨在優化項目管理及營運效率。

此外，我們的存貨周轉天數由2023年的465天減少至2024年的257天，並進一步減少至2025年的115天。我們預期將實現進一步減少的趨勢，乃由於我們旨在通過特定項目交付團隊增強項目進度管理來優化交付。

數字化轉型

我們將升級項目管理辦公室運營儀表板，以整合生產、銷售和研發流程。端到端的內部流程整合和主要KPI監控提高了從商機到現金回報的轉化效率。我們將部署勞動力分析儀表板以優化人力資本分配及加強對利潤率、成本和訂單狀態的實時監控。我們亦將建立集中知識庫，將運營專業知識制度化並減少重複工作。

開發特定行業組件平台以降低交付成本

我們計劃運用[編纂][編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]港元，用於為現有產品開發特定行業組件平台，以降低交付成本。特別是，我們將建立產品發佈中心以管理產品迭代及實施自動化產品測試以降低用戶驗收測試成本及人力，且我們將建立一個涵蓋產品設計、開發、用戶驗收測試及發佈的一體化研發管理平台以簡化整個設計－研發－發佈流程。

業 務

通過上述措施加上我們持續降低成本及提高營運效率之努力，我們致力實現可持續增長及提升盈利能力。基於上文所述，董事相信我們的業務具備可持續性。

員工

截至2025年12月31日，我們擁有550名員工，其中合共369名員工擁有本科、碩士或博士學位，佔我們員工總數約67.1%。我們的絕大部分員工均在中國。下表載列截至2025年12月31日我們按職能劃分的員工明細。

職能	員工數量	佔總數百分比 (%)
行政管理.....	28	5.1
研發	148	26.9
銷售及售前.....	50	9.1
項目實施.....	324	58.9
總計	550	100.0

我們的成功取決於我們吸引、激勵、培訓及留住合資格人員的能力。我們相信，我們為員工提供了具競爭力的薪酬待遇及能促進事業發展的環境。我們採用各種方式招聘新人才，如線上招聘、同事推薦及獵頭服務中介。我們挽留人才的措施包括高管指導、培訓及發展、員工福利、激勵計劃薪酬及獎勵。憑藉該等措施，我們相信，我們已組建一支穩定的核心管理團隊。

我們與員工簽訂個人僱傭合同，其中通常包含服務期限、職位、薪金、花紅、員工福利、工作場所安全、保密義務、工作成果轉讓及終止理由。我們亦與全體全職員工簽訂保密及知識產權所有權協議以及不競爭協議，規定員工在受僱期間創造的任何發明均轉讓予我們。

為維持員工的質量、知識及技能水平，我們持續提供內部及外部的教育及培訓計劃，以提升員工的技術、專業或管理技能及確保彼等了解並遵守我們的政策及程序。

我們相信，我們與員工維持良好的工作關係。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無與僱員發生任何重大糾紛。

社會保險及住房公積金

根據中國法律法規，我們須透過中國政府強制性福利供款計劃為僱員參加由地方政府管理的各種僱員社會保障計劃，包括住房、養老金、醫療保險、生育保險、工傷保險、失業保險及住房公積金。

業 務

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無根據相關中國法律法規為部分僱員足額繳納社會保險及住房公積金供款。於往績記錄期間，社會保險供款及住房公積金欠繳數額分別約為人民幣12.1百萬元、人民幣10.5百萬元及人民幣14.0百萬元。控股股東孫先生向我們承諾，若相關監管機構或僱員日後要求本公司或我們的任何附屬公司補足未繳社會保險或住房公積金供款，或本公司或我們的任何附屬公司受到有關機構的處罰或以其他方式蒙受任何財務損失或因此而產生開支，孫先生須悉數支付所有該等成本或損失，並確保我們不會因此蒙受任何不利影響或損失。基於上文所述，我們並無就社會保險及住房公積金供款欠繳數額計提撥備。

根據《社會保險法》，僱主未足額繳納社會保險的，有關部門可以責令僱主限期繳納或者補足，並按日加收萬分之五的滯納金；僱主逾期仍不繳納的，處欠繳數額一倍以上三倍以下的罰款。此外，根據《住房公積金管理條例》，僱主不辦理住房公積金賬戶設立手續的，有關部門可責令僱主限期辦理；逾期不辦理的，可以處以人民幣10,000元以上人民幣50,000元以下的罰款。倘僱主逾期不繳存或者少繳住房公積金的，由主管機關責令限期繳存；逾期仍不繳存的，可以申請中國人民法院強制執行。

2025年7月31日，中國最高人民法院發佈《最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》（「解釋二」），自2025年9月1日起施行。根據解釋二，用人單位與勞動者約定或者勞動者向用人單位承諾無需繳納社會保險費的，人民法院應當認定該約定或者承諾無效。用人單位未依法繳納社會保險費，勞動者根據勞動合同法第三十八條第三項規定請求解除勞動合同、由用人單位支付經濟補償的，人民法院依法予以支持。鑒於(i)本公司與我們的僱員先前並無訂立排除社會保險付款的協議；及(ii)中國法律顧問認為解釋二並無訂明罰款風險或廢除現行法律，董事認為，解釋二將不會對我們的業務或財務業績產生重大不利影響。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們委託兩家第三方人力資源機構代為繳納部分員工在其工作地點的社會保險和住房公積金。此項安排的主要原因是我們在相關城市沒有註冊運營實體。根據與各第三方代理訂立的協議條款，代理承擔為相關僱員繳納社會保險及／或住房公積金的義務。根據代理機構提供的書面確認，彼等並未因在其獲委託期間未能及時為該等僱員繳納規定的社會保險或住房公積金而受到有關中國監管機構的調查或行政處罰。

董事認為，鑒於：(i)我們已獲得相關機構出具的書面確認，表示我們在往績記錄期間並未受到行政處罰；(ii)截至最後實際可行日期，我們並未收到相關中國監管機構的任何通知，要求我們補足社會保險及住房公積金的重大欠繳數額；及(iii)我們並不知悉因社會保險及住房公積金收到任何重大員工投訴或與員工發生任何勞動糾紛，上

業 務

述事件不會對我們的業務及經營業績造成重大不利影響。此外，根據人力資源和社會保障部於2018年9月21日頒佈的《關於貫徹落實國務院常務會議精神切實做好穩定社保費徵收工作的緊急通知》，行政執法機關不得組織或進行對企業歷史社保欠費的集中清繳。此外，據我們的中國法律顧問告知，相關地方社會保險及住房公積金主管部門要求我們支付社會保險及住房公積金欠繳款項，或對我們處以行政處罰的風險甚微。

為監察我們遵守社會保險及住房公積金供款相關法律及法規的情況，我們已採取以下內部控制措施：(i)人力資源部須每月審閱及監察社會保險及住房公積金的申報及供款；(ii)我們一直在提高社會保險及住房公積金供款的繳存基數至符合相關法律及法規的水平；(iii)我們將持續關注與社會保險及住房公積金有關的中國法律及法規的最新發展；及(iv)我們將定期就相關中國法律及法規諮詢我們的中國法律顧問的意見，以及時了解相關監管發展，並將為相關僱員提供與之相關的法律合規培訓。我們將全面遵守[編纂]前生效的有關社會保險及住房公積金供款的相關法律及規定，以全面糾正該不合規事項。

為防止日後再次發生類似事件，我們已審閱我們的常規並已採取相關內部控制措施，包括：

- 我們已採納薪酬管理政策，該政策要求本集團根據適用的中國國家及地方法規繳納社會保險及住房公積金；
- 我們的人力資源部獲指定負責社會保險及住房公積金事宜的日常管理，並將持續監察本集團遵守社會保險及住房公積金規定的情況，以及及時實施任何必要的糾正或改善措施；
- 我們亦將就相關中國法律法規向我們的中國法律顧問尋求建議，以確保我們掌握最新的監管動態，並了解其具體規定及相關規則的官方解釋。我們將與相關當局保持定期及緊密的溝通，並根據其指引及時繳納社會保險及住房公積金。

日後，我們將繼續實施上述措施，並承諾按適用法律法規的要求，以我們本身的賬戶及時為本集團繳納社會保險及住房公積金。

業 務

保險

我們按照中國法律法規的規定並根據對運營需求的評估及行業慣例投保。根據中國法規的規定，我們參與由省市級政府組織的各項員工社會保障計劃，包括養老保險、失業保險、生育保險、工傷保險、醫療保險及住房公積金。此外，於往績記錄期間，我們亦為若干員工投購補充醫療保險。未來，倘上述任何保險類別因法律變更或其他原因而成為強制性保險，我們將投購此類保險，以確保持續的法律合規。董事認為，我們現有的保險範圍足以滿足目前的運營需求，且符合中國行業慣例。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未提出任何重大保險索償，亦無於續保方面遇到任何重大困難。

物業

自有物業

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無擁有任何房地產。

租賃物業

我們的主要營業地點位於中國上海。截至最後實際可行日期，我們在中國租賃183項物業，總建築面積約為22,313平方米。相關租賃協議期限一般為三個月至九年。

我們的租賃物業主要用作業務運營辦公場所、員工宿舍及倉庫，屬於上市規則第5.01(2)條界定的非物業業務。我們相信，現有設施大致能夠滿足我們的目前需求，但預期將視乎未來的發展需要增添額外空間。

根據中國適用法律法規，租賃協議須向相關中國政府部門登記。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們尚未完成所有租賃協議的登記。詳見「風險因素－與我們一般營運及行業有關的風險－我們於租賃物業的租賃權益未根據中國相關法律的規定向中國相關政府部門登記。未能登記租賃權益可能會令我們面臨潛在罰款」。我們尚未因租賃登記事宜受到政府部門的任何處罰或收到任何整改通知。倘我們接獲有關中國政府部門的通知，要求我們於規定時限內完成租賃協議的登記及備案，而我們逾期不辦理的，則我們可能受到的最高行政處罰總額為人民幣1.62百萬元。據我們的中國法律顧問告知，若能在主管政府部門規定的期限內完成租賃登記，則政府部門就這些租賃物業對我們施加處罰的風險極低。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未在續簽租賃協議或物色新物業作為員工宿舍方面遇到任何重大困難。

業 務

法律程序及合規

法律程序

我們可能在正常業務過程中不時成為各項法律、仲裁或行政訴訟的一方。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據我們的中國法律顧問告知且就董事所知，概無針對本公司或任何董事的訴訟、仲裁或行政訴訟對我們的業務、經營業績或財務表現造成重大不利影響。聯席保薦人並不知悉任何與上文所述者相反的情況。

合規

我們須遵守中國監管機構頒佈的多項監管規定及指引。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，就董事所知，我們並無作出任何違反法律及法規的重大不合規行為，而整體而言，該等行為可能會對我們造成重大不利影響。據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已在所有重大方面遵守中國相關法律及法規。

貿易限制及關稅

若干國家或組織（包括相關司法權區）已對被制裁國家或對目標行業、公司、個人及／或組織實施經濟制裁。於往績記錄期間，我們向位於中國、印度、馬來西亞、越南及泰國的未被制裁客戶出售產品（「**相關活動**」）。據Ashurst Tokyo告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團一直遵守相關司法權區所有適用的制裁及出口管制法律及法規。尤其是，Ashurst Tokyo表示，本集團並未從事一級被制裁活動或次級被制裁活動，且概無集團實體被指定為被制裁目標或在任何被制裁國家經營或涉及任何被制裁國家。因此，相關活動並不代表違反於相關司法權區適用的國際制裁，而可能導致相關人士面臨任何重大制裁風險。此外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團主要在中國經營業務。據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團一直遵守中國所有適用的進口管制法律及法規。

此外，於往績記錄期間，我們採購了部分美國原產零件及軟件，並將其整合到我們售予中國客戶的一小部分產品中。Ashurst Tokyo認為，該等銷售活動不應引致適用美國出口管制法律項下的重大風險，原因是(i)我們的產品均非美國出口管制法規規定的特定「技術」及「軟件」的「直接產品」，(ii)我們採購的美國原產商品並非「受管制」出口，因此，我們向中國客戶銷售的產品（包含該等商品）無須遵守許可證規定，及(iii)我們概無違反美國出口管制法規將任何產品售予BIS實體清單上的任何實體。於往績記錄期間，我們並無直接或間接從美國進口任何貨物。誠如我們的中國法律顧問所告知，我們的進口活動並無受到美國關稅或出口管制措施的直接影響。由於我們的採購主要來自韓國，董事已確認我們預期中美貿易緊張局勢不會產生任何重大的短期風險或直接影響。

2024年10月28日，美國財政部發佈了《對外投資規則》，該規則於2025年1月2日生效。《對外投資規則》針對涉及與「受關注國家」（目前包括中國（包括香港和澳門））有關個人和實體的投資，並對投資從事某些行業（包括半導體和微電子、量子信息技術或人工智能）活動的人士的廣泛投資施加要求（例如禁止或通知要求）。《對外投資規則》將相關活動定義為「受管制活動」，從事受管制活動的來自受關注國家的人士被定義為「受管制外國人」。美國人士受限於《對外投資規則》的投資被定義為「受管制交易」，其中包括但不限於收購股權（包括購買首次公開發售中的股份或有股權）。

業 務

董事經考慮Ashurst Tokyo的意見後認為，本公司並非《對外投資規則》下的受管制外國人，因我們並無從事涉及上述領域的任何受管制活動。具體而言，誠如Ashurst Tokyo所告知：

- 我們並無從事與半導體及微電子領域相關的任何受管制活動。具體而言，在《對外投資規則》所界定的各情況下，我們並無參與(a)開發或生產用於集成電路（「**集成電路**」）設計或先進封裝的電子設計自動化軟件；(b)開發或生產半導體製造或先進封裝設備；或(c)若干先進集成電路的設計、製造或封裝，因我們並無從事任何集成電路設計、製造或封裝活動，亦無開發或生產任何用於此目的的自動化軟件或設備；
- 我們並無從事量子信息技術方面的任何受管制活動，其通常涵蓋的活動包括(a)開發超級計算機；(b)開發量子計算機或若干量子平台或網絡；(c)開發最終用於軍事、政府情報或大規模監控的若干AI系統；
- 我們並無從事與人工智能領域相關的任何受管制活動。儘管我們已開發若干具備AI功能的軟件（如我們的LOFA平台），但該等技術並非旨在用於與《對外投資規則》下「被禁止」或「須通報」交易相關的任何受限制最終用途；
- 概無本集團實體於任何受管制外國人中擁有投票權或股權、董事會席位或若干權力，我們亦無超過50%的年度收入、淨收入、資本開支或營運開支（單獨及在該等實體中匯總計算）來源於受管制外國人；且概無本集團實體參與從事「受管制活動」的任何合營企業。

此外，《對外投資規則》包含多項例外交易，包括投資於在任何司法權區的證券交易所或場外交易市場買賣、以任何貨幣計價的公開交易證券（「**公開交易證券例外情況**」）。即使我們被美國財政部視為受管制外國人，於[**編纂**]完成後，預期美國人士將能夠依賴公開交易證券例外情況投資我們的H股，惟前提是該等投資不會賦予美國人士超出標準少數股東保障的權利。

於2025年12月23日，美國財政部就《對外投資規則》發佈了額外的常見問題解答（「**常見問題解答**」）。其中，常見問題解答X.4澄清，在沒有額外事實的情況下，倘美國人士收購受管制外國人的股權，且該股權於收購時為公開交易性質，則該股權屬於31 C.F.R.第850部項下「公開交易證券」的描述範圍，不論訂立進行該等投資之任何協議的時間為何。因此，常見問題解答就公開交易證券例外情況的範圍及應用提供了額外指引。誠如Ashurst Tokyo所告知，發佈常見問題解答並不改變公開交易證券例外情況就投資我們H股的適用性或運作，是由於我們並非「受管制外國人」。因此，公開交易證券例外情況對美國人士投資我們H股的影響在常見問題解答發佈前後維持不變。為求全面，無論是《對外投資規則》或常見問題解答均無界定被視為發生收購的確切時間。誠如Ashurst Tokyo所告知，可合理認定投資者收購H股乃於結算時（即投資者收取H股時）發生。倘美國人士購買的H股於[**編纂**]上午九時正之後結算，該等H股於收購時將為公開[**編纂**]及[**編纂**]。然而，倘結算於[**編纂**]上午九時正之前（當時H股尚未公開[**編**

業 務

纂]及[編纂]) 發生(包括例如[編纂]的結算)，則尚不明確《對外投資規則》下的公開交易證券例外情況是否仍適用。

美國目前對原產於中國的商品加徵的關稅(「美國關稅」)包括根據(i)美國1974年貿易法案第301條(對涵蓋電子產品和機器在內的產品清單普遍徵收7.5%至25%的關稅)；(ii)美國1962年貿易擴展法案第232條；及(iii)貿易法案第122條(目前對全球徵收10%的關稅)所徵收的關稅。誠如Ashurst Tokyo告知，鑒於據我們所知我們並無直接或間接向美國出口產品，且我們亦無意於[編纂]後如此行事，故對中國或其他司法權區徵收的美國關稅不會對本集團的業務、營運或財務狀況有直接重大不利影響。據Ashurst Tokyo告知，如果我們的下游客戶出口產品到美國，則可能對彼等徵收美國關稅。針對下游產品徵收的美國關稅最終可能導致對上游產品(包括我們的軟件及相關服務等服務)的需求減少。然而，由於我們的銷售集中於越南、新加坡、馬來西亞、泰國及印度，且產品亦主要最終用於該等司法權區，故董事認為該等潛在間接風險有限(如有)且對我們的業務、營運或財務狀況而言並不重大。

內部控制及風險管理

我們已建立並有效實施一系列我們認為適合業務運營、財務報告及人力資源的風險管理措施以及內部控制政策及程序，且我們致力於不斷改進該等政策。此外，我們不斷檢討風險管理政策及措施的落實情況，以確保我們的政策與實施充分有效。

運營風險管理

我們面臨與日常運營有關的運營風險，該等風險主要來自內部流程不足或失效、人為失誤、IT系統故障或外部事件。為確保產品及服務質量，我們與客戶召開會議，及時收集反饋，並定期跟進客戶，以評估自身表現。

財務報告風險管理

我們已建立財務報告風險管理政策、程序及內部控制，以確保財務數據的準確性、完整性及合規性。

我們進行多層次的審查程序，以確保財務報表的準確性。內部控制嵌入稅務計算、預算執行及資產生命週期管理等關鍵流程中。

人力資源風險管理

我們人力資源管理的內部控制及風險管理政策涵蓋招聘、培訓、晉升及部門調動管理。我們在招聘中堅持高標準，通過嚴格的程序確保新聘人員質量，並根據不同部門員工的需求提供針對性的專業培訓。我們亦會定期審視員工績效及內部風險管理政策的落實情況。

業 務

環境、社會及管治(「ESG」)

董事會負責監察及管理關鍵的ESG風險，而ESG戰略落實則由ESG專業工作組及相關部門負責。我們舉行季度會議，討論我們的ESG指標和規劃。我們的ESG工作組監督ESG戰略落實的有效性，監察監管及行業ESG趨勢，確保我們遵守ESG相關規定。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據我們的中國法律顧問告知，我們在所有重大方面均已遵守與社會、健康、安全及環境事宜相關的所有適用中國法律法規，且我們並無因違反社會、健康、安全或環境法律法規而遭受任何罰款或其他處罰。

ESG管治架構

我們計劃成立一個專門的ESG工作小組，由兩名聯席總裁李適先生及陳蒙先生領導。該工作小組將由研發生產、供應鏈、合規等核心部門負責人組成，負責統籌協調ESG策略的制定及執行。我們預期通過高效穩定的管治架構確保ESG管治策略的長期有效實施。

我們制定了短期、中期、長期的ESG管理體系建設和實施方案：

短期：我們計劃開展管理層ESG專題研討會，開展內部調研，開展全業務鏈風險識別，建立ESG管理的基本框架。

中期：我們將逐步推進ESG與核心業務的融合，設定階段性的ESG目標，推行動態管理機制，強化員工的ESG意識及文化。

長期：我們計劃進一步升級治理體系，拓展ESG價值，推動全產業鏈協調發展。

內部控制制度

我們建立了內部控制制度，在採購流程、供應商管理、僱員報酬、法律合規及發展目標等重點領域制定了明確的政策。通過問題解決清單，我們針對ESG績效有效地監控潛在風險並規範內部管理。通過該系統制度框架，我們建立了完善且有效的內部控制管理體系。

環境指標與管理

我們高度重視運營過程中對環境的影響，並嚴格遵守運營所在地的環境相關法律及法規。我們將環境治理納入公司戰略發展的核心，積極構建覆蓋全運營場景的綠色價值鏈，促進公司整體綠色發展。

在踐行綠色低碳運營方面，我們實施了多項有效的環境管理措施。首先，在辦公場所的日常運作中，我們全面推行綠色管理，建立並嚴格執行細化的能源使用標準，例如推廣數字辦公模式，廣泛應用電子文檔工作流程，已基本上實現無紙化辦公。我們實施綠色採購，優先選擇持有環境管理體系認證、節能認證的供應商。

業 務

排放

我們並無自己的生產工廠，亦無直接參與製造過程。因此，我們的運營並無直接產生大量工業廢棄物、廢水或廢氣。

在日常運營中，我們嚴格管理所產生的排放物。目前廢氣排放的主要來源是車輛廢氣排放。我們正努力透過優化車輛調度，盡量減少此影響。廢棄物主要包括員工日常產生的辦公室廢棄物。我們設立分類垃圾桶，對有害和無害廢棄物進行分類，推廣可回收材料的回收利用。廢水主要來自員工日常用水。鑒於我們已採取廢棄物管理措施，上述廢棄物及排放物對環境的影響有限。

我們於往績記錄期間產生的廢氣、廢水及廢棄物的排放數據如下：

		截至12月31日止年度		
類別	單位	2023年	2024年	2025年
廢氣 ⁽¹⁾				
氮氧化物.....	千克	2.33	2.64	2.20
顆粒物	千克	0.17	0.19	0.19
廢水				
生活污水 ⁽²⁾	我們的廢水主要包括辦公生活污水。			
廢棄物				
生活廢棄物 ⁽²⁾	我們的廢棄物主要為辦公室生活廢棄物。			

附註：

- (1) 2024年的廢氣排放增加是由於我們業務的擴展導致用於業務目的的公務用車增加。於2025年，我們通過減少公務差旅用車，以線上會議代替線下會議，降低了車輛行駛里程，從而減少廢氣及範圍1的排放。
- (2) 廢水及廢棄物由物業管理處統一處理。

資源消耗

我們的日常資源消耗主要來自辦公場所及倉庫儲存期間的電、水使用。

我們推行節能計劃，包括嚴格控制照明及燃料。我們亦開展節能活動，推動綠色發展和節約能源。

我們加強用水管理，建立用水記錄及統計制度，及時進行檢查及維修，消除長流水或漏水現象。

以數字化為依托，推行辦公系統無紙化，採用辦公自動化系統，推進會議資料數字化、審批線上化。我們亦倡導使用公共交通和其他低碳出行方式。

業 務

我們於往績記錄期間的資源消耗數據如下^{附註：}

資源分類	單位	截至12月31日止年度		
		2023年	2024年	2025年
電	MWh	58.47	70.29	47.21
水資源	噸	322.00	313.00	302.00

附註：

- (1) 2023年及2025年的用電量基本一致，而2025年的用電量有所減少，這是由於我們致力實現節能。於2024年，我們增加了IT服務器的容量並增加了5台空調，以優化辦公環境，我們亦進行了辦公場所的裝修，導致電費開支相應增加。
- (2) 由於水費已計入大廈的物業管理費，故不能單獨列示過往用水量。用水量乃根據我們的辦公面積佔大廈總面積的比例估算。

基於目前的業務運營及行業慣例，為積極推動可持續轉型，我們制定了能源管理目標，即到2030年，我們計劃將人均水電消耗量在現有水平的基礎上降低3%。

為確保該等目標的實現，我們將逐步將高耗能設備替換為節能電器。我們將持續進行員工綠色行為引導，並通過內部溝通、培訓及活動等方式進行宣導，引導員工實施「綠色辦公」。

碳管理

由於我們的業務主要圍繞軟件開發，與其他半導體相關公司相比，我們的ESG指標（人均碳排放量）相對低於行業的平均水平，如下所示。

公司	每位僱員的溫室氣體排放量（範圍1+範圍2）	2024年
本公司	二氧化碳總排放量（公噸）／僱員總人數	0.1
公司A	二氧化碳總排放量（公噸）／僱員總人數	3.3
公司B	二氧化碳總排放量（公噸）／僱員總人數	1.3

我們於往績記錄期間的具體碳排放數據如下^{附註：}

類別	單位	截至12月31日止年度		
		2023年	2024年	2025年
範圍1	公噸二氧化碳當量	5.51	9.62	3.68
範圍2	公噸二氧化碳當量	33.34	40.09	26.93
範圍3	公噸二氧化碳當量	0.13	0.13	0.12

附註：

- (1) 範圍1排放主要來自車輛的燃料消耗。範圍2排放主要來自電力使用。有關其於往績記錄期間內的各自波動，請參閱上文「－排放」及「－資源消耗」。
- (2) 範圍3排放包括淡水相關的碳排放；其他排放類別不適用於本公司。

業 務

基於當前的業務運營及行業慣例，為響應國家碳達峰和碳中和目標，我們制定了以下碳排放目標：到2030年，我們計劃將年度每輛車的二氧化碳排放強度較當前水平降低5%。我們將逐步實現新能源汽車替代，目標是於2030年實現全面替代。

識別氣候相關風險及機遇

在應對氣候風險的過程中，我們識別了急性、慢性物理風險和轉型風險，並對其對本公司的潛在影響進行分析，具體如下：

物理氣候風險

急性風險：氣候變化引發的極端天氣事件，可能對我們的財產及資產造成損壞，影響我們的運營及增加僱員受傷率。

慢性風險：長期氣候變化造成的系統性壓力將增加業務中斷及資產價值貶值的可能性，從而導致財務虧損。

轉型氣候風險

政策及合規風險：我們需要滿足更嚴格的環境控制要求，否則可能會導致罰款，增加合規成本及損害品牌形象。

市場風險：消費者對可持續發展產品的需求不斷增長，推動業務的綠色轉型，否則我們可能面臨市場份額下降的風險。

聲譽風險：政府及各利益相關方日益期望我們的企業履行氣候治理責任及提高環境披露透明度，否則可能導致聲譽受損。

在應對氣候變化挑戰的同時，我們亦探索氣候相關機遇，以推動我們的長期可持續發展。具體的氣候機遇包括：

品牌形象：隨著市場對綠色生產的日益重視，優化半導體生產設備能源消耗的技術將為我們帶來市場機遇。通過改進綠色製造技術，我們能夠在滿足消費者性能需求的同時建立強大的綠色品牌形象，緊跟市場趨勢，並推進可持續發展目標。

競爭優勢：隨著新能源汽車和消費電子等領域的半導體應用不斷增長，我們的綠色供應鏈轉型為增強我們的競爭優勢提供了機會。

社會指標與管理

我們旨在通過以下社會管理實踐，提升企業的社會責任意識，創造共享價值。

僱傭及勞務慣例

我們嚴格遵守勞動相關法規和《員工手冊》，充分保障員工合法權益。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無發生強迫勞動，未聘用低於法定最低就業年齡的未成年人。我們制定了基於績效的員工獎懲及晉升政策。我們建立了積極的遞進式薪酬體系，制定基於崗位和績效的薪酬標準。以上所有措施旨在為員工營造積極進取的工作氛圍。

業 務

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，我們的員工流失率分別為21.0%、31.3%及20.1%。截至2023年、2024年及2025年12月31日，女性員工人數佔我們員工總數的12%、11%及12%。

職業安全

我們為服務超過兩年的員工提供年度體檢。我們亦通過團隊聚餐和績效面談來關心員工的心理健康和個人福利。公司嚴格遵守勞工安全相關法律，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，公司概無出現因工死亡事件或損失工作日數。

員工發展與培訓

為規範員工培訓，確保全體員工具備其崗位所需的知識及技能，同時提供明確的職業發展方向，我們組織各種培訓項目，如**雛鷹計劃**及**銷售培訓**。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們合共開展超過700節培訓課程，總培訓時長超過128,000個小時。

在我們的培訓系統下，每年年初，人力資源部門根據我們的經營目標和上一年的培訓成果，制定年度培訓計劃。培訓主題涵蓋企業層面及具體崗位知識。內容的廣度和深度針對不同的角色量身定制，以幫助員工不斷提高技能。

我們於年終進行年度績效評估，而部門主管則進行年中評估。符合資格要求的員工可能會被晉升或調動。

可持續供應鏈

在供應商導入階段，我們實施嚴格的准入標準，包括對資質、聲譽、環境或社會風險評估及商業條款進行評估。通過這個過程，一個可靠且具有競爭力的供應商網絡得以建立。我們亦每年對供應商進行審查、評級，選擇表現最佳的供應商以優化供應商結構，確保採購效率。

產品責任

我們提供高性能及高質量的產品。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無發生因安全或健康問題導致的大型產品召回事件。此外，我們截至最後實際可行日期亦未接獲任何有關產品質量的重大投訴。

產品管理

我們通過質量管理和客戶保護政策確保產品的功能性、安全性和耐用性。我們根據ISO 9001:2015實施質量管理手冊，以證明我們有能力持續提供滿足客戶及監管要求的產品和服務。我們亦與客戶保持直接溝通，以獲取反饋及信任，透過及時解決問題提高滿意度。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無任何與我們的特專科技產品有關的重大投訴、產品責任申索或產品退貨。

業 務

知識產權保護

知識產權是我們創新能力和競爭力的核心資產。我們建立及實施了知識產權管理體系。

反貪污

誠信是我們業務運營的核心原則。我們已實施涵蓋反貪污、反賄賂、反洗錢及反欺詐措施的政策，明確禁止賄賂、回扣或不道德行為。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無收到任何關於貪污事件的報告。

重大安全數據

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，如我們的董事所確認，我們的特專科技產品並無重大安全數據，亦無與特專科技產品安全數據相關的嚴重不良事件。

數據隱私及安全

我們遵守數據隱私法律及保護客戶數據安全。我們已建立內部信息中心，用以監督網絡運營及確保系統及數據安全。

結合相關法律法規的具體規定，我們已建立數據安全管理制度，包括：

- 信息系統風險防範規則降低及監測與信息系統相關的風險，以加強風險管理工作的操作性及相關性。
- 網絡安全及防護管理規則是落實網絡安全及業務數據安全的管理基礎，旨在防止數據丟失、損壞、篡改及洩露，同時提高網絡及相關業務系統的安全性。
- 數據安全管理規則規範各類數據的備份及存儲流程，確保數據在我們控制範圍內。我們就內部信息系統數據安全以及外部和內部項目數據安全管理提供了指引。
- 科學數據管理規則覆蓋科學數據分類分級、全生命週期安全管理。我們已建立科學數據公開或對外的安全及保密審查制度。對於對外共享數據，我們亦採取安全管控措施，做到數據共享可追溯、責任可追究。

我們已獲得包括ISO9001質量管理體系認證、ISO20000信息技術服務管理體系認證及ISO27001信息安全管理体系認證在內的相關認證。我們建立的信息安全管理體系符合相關國際及國內標準的規範要求。

業 務

目前，我們收集的個人信息主要用於產品開發及項目合作用途，有關用途需要收集的個人信息包括客戶及供應商的聯繫信息等。以下載列本公司收集／獲取、使用／處理或共享數據（包括個人信息）的詳情：

數據來源	數據類型	數據範圍
由客戶通過公司官網、 微信公眾號、 第三方營銷機構提供 或通過展會主辦方 或承辦方收集.....	客戶聯繫人信息	個人或公司名稱、電話、電郵地址、通訊地址、身份證號碼等（如適用）
通過社交媒體平台獲取 客戶聯繫資料.....	社交平台用戶信息	社交平台用戶信息，包括社交平台用戶id、頭像、個人簡介等信息
直接向客戶收集.....	• 產品／項目需求信息 • 產品演示測試數據 • 項目二次開發需求信息 • 運維需求信息	• 軟件產品定制需求信息，包括系統架構、產品功能及規格 • 包括虛構的測試數據或脫敏後的真實生產環境數據 • 包括項目目標、實施策略、具體需求描述、配置文件及參數要求 • 包括軟件系統報錯信息
內部產生.....	研發數據 (附註1)	包括產生的產品或項目開發代碼（包括產品或項目包含的模型數據）及相關邏輯描述文件（如流程圖）
內部產生.....	項目數據 (附註2)	設計於客戶環境中運行的項目軟件代碼（部分項目可能包含模型代碼）
內部產生.....	研發需求數據、技術問題數據 (附註3)	包括提供給其他公司的開發需求數據和提供給外部公司和合作機構的技術問題數據
直接從外部合作夥伴收集...	合作研發數據	根據本公司提供的研發需求數據產生的合作研發成果數據
直接從外部公司及 合作機構收集.....	技術諮詢數據、技術解決方案數據及其他研發相關數據	包括根據本公司提供的技術問題數據產生的技術諮詢報告、課題研究報告及技術解決方案等

業 務

附註：

1. 本公司在開發標準化產品的研發活動，以及為響應客戶特定需求而進行的二次開發活動期間所產生，且尚未納入最終交付成果的中間研發數據。
2. 本公司完成上述研發活動後交付予客戶的項目數據。項目數據及本公司的解決方案部署於客戶自有的本地基礎設施上，所有數據處理均在客戶自有的環境及系統內進行。
3. 本公司內部研發活動期間產生的研發需求及技術問題數據。

我們已取得數據主體的同意。本公司已透過其隱私政策以及社交平台與展覽的現有規則及安排，就收集、持有及使用相關個人資料取得數據主體的有效授權。就客戶提供的特定產品或項目數據而言，在產品研發階段，客戶自願為本公司的定制化開發提供研發需求數據及測試數據。此外，在項目二次開發、實施及運維服務階段，我們收集上述由客戶自願提供的二次開發或運維相應需求數據，我們按合約約定或應要求，於客戶的本地環境及系統內提供現場維護，或透過使用客戶提供的路徑進行遠程維護，而並無收集任何其他客戶數據（例如與客戶特定產品／項目數據運作相關的數據）。客戶自願提供該等數據，即構成其授權本公司為完成相關定制化開發之目的而收集、持有及使用該等數據。我們的中國法律顧問表示，由於中國法律尚未對該等數據的權屬作出明確規定，根據數據來源、我們與客戶的合同約定以及司法實踐，我們有權持有和使用上述數據。

我們制定了內部管理制度，並嚴格按照法律、監管規定和內部管理制度存儲數據（包括個人信息）。個人信息的保存期間，應以達到授權使用目的所需最短時間為準，法律及法規另有規定或經所有者授權的除外。信息系統處理的業務相關數據均存儲在中國境內。我們不會出於我們業務和產品運營的目的向任何第三方提供或轉讓個人信息。我們的數據傳輸僅限於我們開展業務活動所必需的場景。我們不涉及因合併、重組、分立、解散或宣佈破產等情況引起的任何數據傳輸。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未出現任何重大數據洩漏或數據丟失，亦未收到任何第三方因我們侵犯其任何適用法律法規所規定的數據保護權而對我們提出的任何索賠。此外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何個人信息和重要數據的跨境傳輸。根據相關中國法律法規，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據我們的中國法律顧問告知，我們於中國境內的業務及產品運營在網絡安全、數據安全及個人信息保護方面不存在任何重大風險，且我們已在所有重大方面遵守中國有關法律法規。董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團並不涉及在境外的司法權區收集、使用、處理及／或共享數據（包括受數據保護及隱私規限的個人信息）。概無因嚴重違反網絡安全、數據安全及個人信息保護領域的相關法律或監管規定，而阻礙我們繼續開展業務的根本性問題。

業 務

獎項及認證

於往績記錄期間，我們已獲頒多項重要獎項，並取得若干重要認證，以表彰我們的技術及創新成就，其中主要獎項及認證詳情載列如下：

獲獎年份	獎項／認證	頒發組織／機構
2023年	專精特新「小巨人」企業	工信部
2023年	2023中國智能製造創新技術應用TOP20	世界創新者年會
2024年	2023-2024半導體市場技術創新企業獎	中國電子信息產業發展研究院
2024年	2024中國半導體製造技術創新TOP20	世界創新者年會
2024年	2024年度上海閔行區50強企業	上海市閔行區人民政府
2024年	高新技術企業證書	上海市科學技術委員會、上海市財政局及國家稅務總局上海市稅務局
2025年	上海市認定企業技術中心	上海市經濟和信息化委員會及其他四家機構

業 務

執照、批准及許可

根據我們中國法律顧問的意見，董事已確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已在所有重大方面遵守所有相關中國法律及法規，並已從相關監管機構取得在中國開展業務所需的所有重大執照、批准及許可。該等營業執照仍然完全有效。本集團的主要牌照及證書概述如下：

持有人	執照／許可	頒發機構	頒發日期	到期日
本公司	軟件企業證書	中國軟件行業協會(CSIA)	2025年7月31日	2026年7月30日
本公司	軟件產品證書	中國軟件行業協會(CSIA)	2023年9月30日	2028年9月29日
本公司	海關報關單位 註冊登記證書	中國莘莊海關	2014年12月26日	長期
上海紅岩.....	軟件產品證書	中國軟件行業協會(CSIA)	2023年2月7日	2028年2月6日

COVID-19爆發和季節性的影響

自2020年初以來，COVID-19疫情已促使全球各國政府採取措施遏制其蔓延，包括封鎖、出行限制及業務運營限制，對經濟活動造成重大干擾。董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，COVID-19爆發並無對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。我們已實施遠程工作方案、數字項目管理系統，並靈活部署我們的專業人員，以減少潛在的干擾。並未發生任何已確認合約取消的情況，亦無任何可直接歸因於疫情的未來訂單重大損失。我們將繼續密切關注情況，並根據需要調整業務連續性措施。

我們的業務歷來受季節性波動的影響，主要受客戶的預算週期及項目實施時間表驅動。每日曆年第一季度通常是我們業績最淡的季度，因為中國及海外市場的許多客戶將新項目開工延遲至春節假期後及年度預算最終確定後。董事確認，雖然季節性因素於往績記錄期間影響了我們收入的季度分配及營運資金需求，但並未對我們的整體年度業務、經營業績或財務狀況造成重大不利影響。我們通過靈活的資源配置、與主要客戶提前進行項目規劃以及維持充足的信貸融資以應對暫時的營運資金波動，從而積極管理該等季節性影響。